

股票代號：5443

年報查詢網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<http://www.gpmcorp.com.tw>

GPM

均豪精密工業股份有限公司

Gallant Precision Machining Co., Ltd.

民國一百一十四年度年報

中華民國一百一十五年三月三十一日刊印

一、本公司發言人及代理發言人之姓名、職稱、電話及電子郵件信箱：

	發言人	代理發言人
姓名	梁又文	黃盛宏
職稱	執行長	處長
電話	(03) 563-9999	(03) 563-9999
電子郵件信箱	frankjr@gpmcorp.com.tw	michaelhuang@gpmcorp.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

單位	地址	電話
總公司	新竹縣科學園區創新一路 5-1 號 4 樓	(03) 563-9999
中 科 廠	台中市大雅區科雅西路 28 號	(04) 2565-8866

三、辦理股票過戶機構：

名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市東興路 8 號 B1
網址：www.pscnet.com.tw
電話：(02) 2746-3797

四、最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
姓名：吳偉豪、江采燕
地址：新竹市科學工業園區工業東三路 2 號 5 樓
網址：www.pwc.tw
電話：(03) 578-0205

五、海外有價證券相關資訊：無。

六、本公司網址：www.gpmcorp.com.tw。

目 錄

壹.致股東報告書.....	1
貳.公司治理報告.....	7
一.董事、監察人及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
二.最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	18
三.公司治理運作情形.....	24
四.簽證會計師公費資訊.....	59
五.更換會計師資訊.....	59
六.公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	60
七.最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	60
八.持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	61
九.公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	62
參.募資情形.....	63
一.資本及股份.....	63
二.公司債辦理情形.....	66
三.特別股之辦理情形.....	66
四.海外存託憑證之辦理情形.....	66
五.員工認股權憑證辦理情形.....	66
六.限制員工權利新股辦理情形.....	67
七.併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	68
八.資金運用計畫執行情形應記載下列事項.....	69
肆.營運概況.....	70
一.業務內容.....	70
二.市場及產銷概況.....	86
三.從業員工最近兩年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡與學歷分布比率.....	94
四.環保支出資訊.....	95
五.勞資關係資訊.....	95
六.資通安全管理.....	102
七.重要契約.....	107

伍.財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	108
一.財務狀況	108
二.財務績效	109
三.現金流量	110
四.最近年度重大資本支出對財務業務之影響	110
五.最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一 年投資計畫.....	110
六.風險管理分析評估事項	111
七.其他重要事項	112
陸. 特別記載事項.....	113
一.關係企業相關資料	113
二.最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	116
三.其他必要補充說明事項	116
柒.重大影響事項.....	117

壹. 致股東報告書

一、民國一百一十四年營業報告書

民國一百一十四年度均豪個體營業收入為 1,963,447 仟元，較前一年度增加 5.90%；集團合併營業收入為 4,669,827 仟元，較前一年度增加 5.30%。在獲利方面，均豪個體稅後淨利為 416,948 仟元，較前一年度增加 40.51%，毛利率較前一年增加 18.40%，每股純益為 2.59 元。

(一)均豪集團年度財務收支及獲利能力之概況：

財務分析資料		民國 114 年度
負債佔資產比率	(%)	41.03
長期資金佔固定資產比率	(%)	831.30
資產報酬率	(%)	3.92
股東權益報酬率	(%)	6.03
佔實收資本比率 (%)	營業利益	29.16
	稅前純益	39.07
純益率	(%)	11.25
每股盈餘	(元)	2.59

(二) 民國一百一十四年度均豪集團已開發完成之新產品：

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	● High Speed 3D Metrology for Advanced Package (先進封裝高速 3D 形貌量測機)
	● Glass Substrate Grinder (玻璃基板研磨設備)
	● Intelligent Quality Prediction System for Grinder Process Control(研磨品質智慧預測系統)
	● Die Bonder with Laser Assisted (晶片雷射接合機)
	● Panel Level Face Down Die Bonder (面板級面朝下黏晶機)
	● High Accuracy & Cleanliness Chip Sorter 高精度&高潔淨晶片挑檢機
	● Wafer to Wafer Chip Sorter with STLP (具多料盒晶圓至晶圓挑檢機)
	● Wafer to Wafer Chip Sorter with 6S AOI for Large Die (大晶片晶粒外觀檢查挑揀機)
	● High-Precision Die Shift Measurement Machine for 3um Die Bond (3um 固晶量測應用之 IR 固晶精度量測機)
● High-Precision Die Bonder (Face Down) (高精度覆晶固晶機)	

二、民國一百一十五年度計畫概要

(一)當年度經營方針

1.營業方面：

- 精實、聯結、聚焦、創新 半導體產業
- 差異化、多元化、拓展次世代顯示產業
- 擴大、推廣、品牌 智動化產業

- (1) 本公司以「誠信」為核心，秉持「團隊、創新、責任、學習」的企業文化，以不斷精進、持續創新的態度，長期深耕自動光學檢測、量測、研磨及拋光等核心技術，提供半導體產業先進封裝及再生晶圓智慧解決方案，以顧客導向為理念，提供高品質設備與卓越服務，幫助顧客創造價值。
- (2) 精實半導體核心技術，創新聯結國際研發資源，貼近半導體市場，提供客戶製程解決方案，聚焦深耕品質優先，提升總體競爭力並掌握市場動向，以精進客戶競爭力及差異化。
- (3) 為了提供客戶高品質的設備與服務，增加機台資安防護能力，從產品設計階段開始導入 SEMI E187 合規開發，於 2023 年順利通過第三方公證單位 Bureau Veritas 認證，並擴展應用到半導體相關之設備，於 2023 年榮獲數位產業署表揚，透過標竿學習，推動產業供應鏈之資訊安全意識。
- (4) 透過技術引進/合作，連結夥伴客戶需求，強力切入高附加價值之半導體前段先進檢測技術開發創新，及發展中後段封裝製程之檢測、量測、研磨及拋光等製程設備。以及精進既有先進封裝、晶圓再生及 IC 載板領域之產品性能，以聚焦產品線及擴大客戶群。
- (5) 公司現有顯示器設備以研發科技為本，搭配國外技術合作，聚焦及深耕次世代顯示產業之高附加價值設備，驅使公司多元化永續經營，以拓展次世代顯示產業不斷創新與進步。
- (6) 將既有產品持續進行差異化(如導入 AI 及節能技術)及優化成本策略，增加產品競爭力及獲利，以既有核心技術持續升級並拓展次世代顯示市場(如 Micro/Mini-LED)，延伸次世代顯示器市場利基。
- (7) 獲利優先，掌握當前重點前瞻技術，在智慧工廠、智慧物流與智動化製程設備，運用公司機電及軟體整合技術、QDTCSS 為根基，智慧生產管理系統為中樞所建構優質生產體系。延續智能自動化拓展成果，集中資源提供策略合作夥伴及重點產業代表性客戶之智能自動化整合方案，協助實現其智慧製造目標。
- (8) 智慧物流擴大開發潛在客戶，推廣至客戶其他站別需求，強化推廣 AI 應用系統產品至各產業，搭配產業重點設備導入，AOI+AI 服務解決方案提供，提升品牌形象與客戶價值。
- (9) 本公司陸續通過 ISO 9001(品質管理系統)、ISO 45001(職業安全衛生管理系統)、ISO 27001(資訊安全管理系統)及 ISO 14064 (溫室氣體管理系統)認證，能提供更精確實在的國際管理流程標準，為公司在各項工作之品質管理、工廠整體安全衛生管理及資安管理上面邁向更高的標準來保障客戶權益，規範員工紀律和執行力，及要

求供應商之整體品質。

- (10)運用本公司專業製造品牌形象及知名度，並透過有效管理，發展 OEM/ODM 服務，爭取國際訂單，降低產業景氣循環影響，推廣與客戶結盟至其他產業領域合作，擴大營收來源。
- (11)善用既有之售後服務機制，深耕與客戶關係，協助提升工廠生產效率，做到以服務加值創造長期性商機，謀求客戶與公司雙贏策略。
- (12)持續拓展與世界性一流公司進行異業結盟合作，成為長期合作夥伴，加速新產品的研發，協助客戶新產品即時上市並跨進新市場，建構長期穩定、獲利的體系。
- (13)企業永續發展(ESG) 由環境、社會及公司治理之三大面向進行發展，本公司秉持永續經營理念，將企業永續經營，與客戶及社會群體建立長期夥伴關係，善盡企業公民責任，建置太陽能發電系統，使用綠色能源節能減碳，並通過 ISO 14064 (溫室氣體管理系統)認證，朝向「碳中和、淨零排放」目標努力邁進。同時成立企業永續委員會，負責推動企業社會責任(CSR)及誠信經營相關事宜，持續深化永續經營並善盡企業公民責任，以人為本，與員工一起成長，共同創造公司、客戶及股東最大價值。
- (14)公司內部加強資訊安全，成立資安委員會宣導及落實資安運作，並通過 ISO 27001(2022 年版本)國際資安認證以及國際半導體協會 SEMI E187 資安認證，有效防範外部駭客入侵風險以及內部資料不法竊取行為，保障公司全體利益，守護員工研發成果不外流。

2.研發方面：

核心技術(設備&製程)深根發展 (1)自動光學檢測技術 (2)自動光學量測技術 (3)研磨技術 (4)拋光技術 (5)智能自動化技術 (6)人工智慧技術等核心技術。

擴展核心技術於跨域產品整合應用發展，於半導體製程暨檢測設備、IC 載板、次世代顯示器製程設備、智慧工廠及智慧物流等產業領域之加值應用。

民國一百一十五年度均豪集團計畫開發之產品技術如下：

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	● Co-Packaged Optics Test Equipment Development (共同封裝光學測試機台開發)
	● Panel Polisher (基板拋光設備)
	● Development of Digital Twin for Process Equipment (製程設備數位孿生開發)
	● Panel to Wafer Chip Sorter with 6S AOI (方板至圓板晶粒外觀檢查挑揀機)
	● CPO Chip Sorter (矽光子元件挑檢機)
	● Hybrid Die Bonder (3D IC 黏晶機)
	● Chip Sorter with 6S AOI for Probe Tester inline (與電性測試設備串接之外觀檢查挑揀機)

● CPO Module Sorter (共封光學元件挑揀機)
● High-Precision Die Bonder (Face Up) (高精度盲打固晶機)
● Ultra High-Precision Die Shift Measurement Machine for 1um Die Bonder (1um 固晶量測應用之 IR 固晶精度量測機)
● Sorter with High Resolution 6S Inspection (高精度六面外觀檢查機)
● Thermo-Compression Die Bonder (熱壓合黏晶機)

(二) 民國一百一十五年度均豪集團預期銷售數量及其依據：

單位：套

主要產品	民國 115 年度預算
半導體製程設備	714
顯示器製程設備	14
智能自動化設備	-
其他設備	5

註：依據客戶對未來之預估及綜合市場情況做成預期資料。

(三)重要之產銷政策：

- 1.整合兩岸營運系統、人才及資源，強化客戶管理、銷售與效能整合，發揮最大綜效，擴展大陸、美國、日本及東南亞市場。
- 2.與產、學、研單位及終端客戶進行策略聯盟，持續系統整合能力及開發半導體、顯示器與智能自動化等新領域之新產品、技術，提升行銷效能以獲得差異化的利基。
- 3.強化產品成本管控機制，搭配設計改善、效能提升及供應鏈管理，有效掌控上游供應商價格、產能預測與交貨資訊以提高競爭力，並確保產品合理利潤。
- 4.持續推動主要產品智慧化、模組化及標準化，簡化生產製造流程、提昇產品功能與可靠度，降低成本。
- 5.收集公司各項即時生產數據，並以內部系統分析整合，提供各項資訊予決策主管作為執行參考依據。
- 6.因應客戶需求快速交貨，有效控制原物料與存貨數量及金額，降低存貨週轉天數並降低存貨跌價損失。
- 7.加速裝機及驗收效能、提升售後服務品質確保客戶滿意度，建立與客戶的雙贏售服體系並持續強化應收帳款及現金流管理。
- 8.導入綠能減碳能源政策，建置廠區太陽能電廠，不僅可將產生的電力售予台電，同時建立公司節能環保形象，為地球永續再生盡一份力量。

三、未來公司發展策略：

- (1) 以創新轉型，觸角延伸，永續發展為發展策略指導原則。
- (2) 營業面向

- 半導體產業、顯示器產業及智能自動化產業深化推廣。
 - 延伸相關產品至其他國外市場業務推展。
 - 加強台廠與國際大廠分散生產之商機。
 - 深耕設備及零組件售後服務市場，與客戶共同合作成長。
- (3) 產品面向
- 核心技術(設備&製程)深根發展。
 - 擴展核心技術於跨域產品整合應用發展。
- (4) 多元人才培育的國際化策略。
- (5) 均豪與合作夥伴公司志聖、均華成立 G2C 營運策略聯盟，提供智慧製造一站式服務，整合多家公司人力、物力、技術資源，建立強大供應鏈體系和客服體系，串整上下游製程設備，協助客戶創造最大價值，達成強本創價，合力共創，和諧共享，同行致遠之共同信念。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

1. 外部競爭環境之影響：

受到國際局勢、整體產業景氣循環變化、匯率及地緣政治演變...等因素，產業經營環境瞬息萬變，市場與產品應用趨勢變化多元，面對全世界顯示器產業景氣擴廠減緩、外部激烈競爭及大陸政府推動設備國產化，本公司過往主要業務來源之顯示器產業競爭日趨激烈及艱困，不斷考驗公司經營團隊的應變能力。均豪將持續強化自有產品技術，配合國外先進技術引進，以提昇產品功能品質與層次，擺脫低價競爭。另開拓半導體、Micro/Mini LED 及智慧製造等不同產業及拓展國際市場。面對所屬產業及經營環境之變化亦將兼具穩定、精準之快速反應能力，並確立了多角化經營佈局及產業的發展目標。

2. 法規環境：

誠信為本公司核心文化，經營面向以遵行法律規範、誠信守紀為基本前提。除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。

3. 總體經營環境：

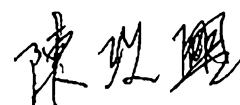
(1) 臺灣機械產業在全球半導體設備市場中占有一席之地，近年在智慧機器人、無人載具、數位孿生 (Digital Twin)、生成式 AI 技術快速發展下，帶來新興驅動力。工研院產業科技國際策略發展所指出，半導體設備產業方面，在 AI 運算、高頻寬記憶體 (HBM) 和中國設備需求提振之下，全球半導體市場可望連續 2 年暢旺。國際半導體協會 (SEMI) 估計，受惠 AI 與先進技術發展，2025 年全球半導體設備市場估計成長 7.4%，產值達 1,255 億美元；在先進邏輯、記憶體和技術轉型帶動下，2026 年會再成長，來產值預估達 1,381 億美元。各國政府鼓勵晶片自主，晶圓廠蓋不停，5 成以上廠址位於中國、臺灣、美國；其中，中國一方面擴大成熟製程投資，一方面又遭遇先進設備出口管制的限制，未來一年美中貿易政策變化，攸關設備市場榮枯。工研院產業科技國際策略發展所指出，AI 將是未來 10 年半導體市場成長的關鍵推力，相關應用同時帶動前段晶圓製造以及後段異質整合，如 CoWoS 製程與矽穿孔 (TSV)、重分佈線層 (RDL) 等先進封裝之設備需求。預估至 2028 年，先進封裝市場將達 786 億美元，具高速、低能耗特性的矽光子技術將逐漸嶄露頭角，卻也帶

來製造和封裝的挑戰，本公司留意相關設備需求，掌握相關商機將，以多元的業務接單，更彈性的製造速度，結合內部強大的產銷機能與外部長期合作的供應鏈體系，迎接挑戰，創造未來。

- (2)根據台灣綜合研究院「2026年台灣經濟展望」，回顧台灣2025年的經濟表現，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮持續擴散，資通訊與電子相關產品需求強勁，帶動外需出口表現明顯優於原先預期。在內需方面，國內企業同樣受到AI與新興科技應用需求帶動，持續擴充產能並加碼投資，使民間投資維持穩健成長。台灣作為全球半導體、伺服器與AI硬體供應鏈的關鍵節點，國際貿易環境的變動及地緣政治風險，均將直接影響我國出口結構與產業發展方向。展望2026年，台灣能否延續以AI科技與半導體出口為核心、並由民間投資承接的成長模式，將面臨挑戰與機會並存的關鍵轉折，主要產業景氣走向及整體經濟動能是否能持續改善，仍需密切關注。本公司在近年來，透過不斷積極研發與夥伴公司合力共創，預期今年在半導體產業、顯示器產業及自動化產業仍將有所斬獲，面對這一波的變化，順勢加大本公司在高科技設備的成長發展，擔任起客戶設備供應鏈的重要角色。
- (3)地緣政治及美中貿易摩擦更加速中國大陸部份企業選擇外移、遷回台灣或選擇到東南亞國家設廠分散風險，但東南亞國家技術人員不足，人工成本高漲已成區域性不可逆的狀況。當地製造工廠為追求整體品質不斷提升之需要，唯有自動化系統設備取代人工生產，才有機會達成。均豪憑藉長期耕耘之設備製造領域，及台灣在這波供應鏈再調整所處之特殊優勢地位，將吸引台商和國際大廠選擇均豪成為共同合作夥伴。
- (4)均豪（GPM）、志聖（CSUN）及均華（GMM）三家公司於2020年攜手共同組成G2C聯盟，合力共創。三家公司在半導體製程設備的各自專長，透過技術串聯整合，成為推升晶圓製造持續精進的重要力量，也為公司營運營收再創佳績。
- (5)此外，人工智慧、5G、AR/VR、元宇宙、物聯網、大數據等，對智能自動化應用更為全面。均豪具備橫跨多元科技產業的自動化設備應用製程解決方案的技術，近年更與重點產業之世界知名製造商充份合作，在整合智能自動化解決方案獲致相當成果。
- (6)均豪秉持企業永續的精神，逐步邁入ESG的領域，並分別於Environment(環境)、Social(社會)、Governance(治理)類別下，依據聯合國SDGs設立均豪未來的永續目標。均豪完成ISO14064-1:2018查證，期望於溫室氣體及碳管理等關鍵議題上，與世界各夥伴攜手面對氣候變遷的挑戰。展望未來，均豪憑藉優秀經營團隊以專業的技術能力及全體同仁戮力以赴，定可達成公司目標，獲得最佳的營運成果。

最後，敬祝各位股東女士、先生
身體健康、萬事如意

董事長：



貳. 公司治理報告

一、董事、監察人及總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事會成員介紹：

民國 115 年 3 月 22 日 (停止過戶日)

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人		備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
董事長	中 華 民 國	駿 朋 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 ： 陳 政 興	男 62 歲	112.6.19	三年	112.6.19	500,000	0.3%	500,000	0.3%	0	0%	0	0%	中山大學機械所碩士 華映精密設計處 處長 均豪精密工業(股)公司 副 總經理 均華精密工業(股)公司 法 人 董事代表人 志聖工業(股)公司 董事	本公司董事長暨總經理 軒豐(股)公司 董事 均碩國際(股)公司 董事 長 Gallant-Rapid Corporation Limited 法人 董事代表人 均強機械(蘇州)有限公司 董事長及總經理 駿朋投資股份有限公司 董事長 ESG 世界公民數位治理 基金會(ESGWD)副董事 長 台灣電子製造設備工業 同業公會(TEEIA)副理事 長 社團法人台灣智慧自動 化與機器人協會 (TAIROA)副理事長 東台精密股份有限公司 獨立董事	無	無	註 1

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人		備 註	
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名		關 係
副 董 事 長	中 華 民 國	志 聖 工 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 梁 文	男 49 歲	112.6.19	三年	103.6.20	44,758,827	27.1%	44,697,827	27.13%	0	0%	0	0%	政大企家班 第40屆 美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢 美國西北大學法律碩士 畢 美國西北大學商學程結業 均華精密工業(股)公司 董事 長、董事 志聖工業(股)公司 顧問、董 事長特助 蘇州創峰光電科技有限公司 董事長 華聖智能科技(股)公司 董事 長 視動自動化科技(股)公司 董 事、監察人 和昌股份有限公司 董事	本公司副董事長暨執行 長 均華精密工業(股)公司董 事長暨執行長 志聖工業(股)公司 總經 理 台灣電路板協會 理事 廣信創業投資股份有限 公司 監察人 創峰光電科技(股)公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限 公司 董事長 蘇州創峰光電科技有限 公司 董事 福盟國際企業(股)公司 董事長 南通創峰光電設備有限 公司 董事 昇陽國際半導體股份有 限公司法人董事代表人 樂林科技(股)公司法人董 事代表人 宇辰系統科技股份有限 公司 獨立董事 敦品壹號創新投資股份 有限公司法人董事代表 人 台大校友創業投資管理 顧問(股)公司 法人董 事代表人	無	無	無	無

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人		備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
董事	中 華 民 國	許鴻銘 (註2)	男 58歲	112.6.19	三年	106.06.16	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0%	0	0%	台灣科技大學電子工程技術系 畢業 均豪精密工業(股)公司 品保 處處長、工程處處長 均華精密工業(股)公司 總經 理 均華精密工業(股)公司 董事 祁昌股份有限公司 董事長 蘇州均華精密機械有限公司 董事 Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd. 董事	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	馬堅勇	男 68歲	112.6.19	三年	112.6.19	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	德國斯圖加特大學冶金博士 中科院材料豐光電所 組長 探微科技 總經理 光洋應用材料科技(股)公司 總經理/董事長 德揚科技(股)公司 董事/ 董事 長 光洋應用材料科技(股)公司 董事 千太股份有限公司 董事 宏捷科技股份有限公司獨立董 事	台灣精材(股)公司 董事 日揚科技(股)公司 董事 中美砂晶製品股份有限 公司獨立董事 易發精機股份有限公司 董事	無	無	無

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人		備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
獨立 董事	中 華 民 國	曾國華	男 65歲	112.6.19	三年	112.6.19	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立政治大學會計系學士 國立交通大學高階經營管理碩 士 資誠聯合會計師事務所審計部 門聯合會計師	睿杰聯合會計師事務所 合夥會計師 矽格股份有限公司獨立 董事 華經資訊企業股份有限 公司獨立董事 北極星藥業集團股份有 限公司獨立董事	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	陳依梅	女 76歲	112.6.19	三年	109.6.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國奧勒岡大學 電子計算機 系碩士 美國貴芬國際企業股份有限公 司 總裁 美國德州雙贏信託經紀公司與 迅安信託核文件審理公司 總裁 美國富國銀行德州奧斯汀市信 貸分公司 執行長 清華大學兼任講師 StarFab Accelerator 豪寬管 理顧問有限公司共同創辦人 董事長 大量科技 獨立董事	工業技術研究院 特約研 究	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	選(就)任日期	選任日期	初次選任日期	選任時持有股份		現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之董事或監察人		備註	
								股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名		關係
獨立董事	中華民國	羅偉	男	68歲	112.6.19	三年	109.6.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	無	無	無	

註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊；

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運狀況與計畫方針以落實公司治理。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任四席獨立董事分別在產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
2. 每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
4. 董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

註2：許鴻銘董事於民國114年8月11日辭任。

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
志聖工業股份有限公司	均豪精密工業股份有限公司(12.73%) 海杏投資股份有限公司(11.37%) 品志投資股份有限公司(7.91%) 梁茂忠(4.39%) 梁茂生(2.92%) 志聖工業股份有限公司庫藏股專戶(2.81%) 花旗託管挪威中央銀行投資專戶(2.30%) 渣打託管 S P D R 組合新興市場 E T F 專戶(2.19%) 匯豐(台灣)銀行託管高盛國際公司投資專戶(1.90%) 簡進土(1.79%) 朕昇股份有限公司(1.63%)

資料來源為該公司民國 115 年 3 月 24 日停止過戶之資料。

主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
海杏投資(股)公司	朕昇有限公司 代表人梁碧真(19.53%)、 鄒淳美(16.67%)、 梁茂生(16.67%)、 品志投資股份有限公司 代表人梁碧茹(12.79%)、 梁茂忠(9.68%)、 梁葉金枝(9.68%)、 張梁秀節(5.22%)、 傅梁秀鴻(5.22%)、 梁又文(1.35%)、 陳梁金絨(1.18%)
品志投資(股)公司	梁碧茹(33.33%) 梁碧茵(33.33%) 梁又文(33.33%)
朕昇(股)有限公司	梁碧真(25.00%) 梁淨閔(25.00%) 梁又元(25.00%) 梁又丰(25.00%)

(二)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公司 董事 數
姓名	<p>董事專業資格與經驗請參閱本報「董事會成員簡介」(第7-11頁)。 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。</p>	<p>所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額</p>	1
董事長 陳政興			2
副董事長 梁又文			無。
董事 許鴻銘 (註1)			1
獨立董事 馬堅勇			3
獨立董事 曾國華			無。
獨立董事 羅偉 獨立董事 陳依梅			無。

註1：許鴻銘董事已於民國114年08月11日辭任。

董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司除依公司章程外，另訂有「受理股東提案暨董事提名審查標準作業流程」明確規定董事選任資格審查，並由董事會決議通過後呈股東會選任之；本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司目前董事會成員專業領域涵蓋財務會計、法律、電子電機、化學等。董事會成員中有 1 名女性董事，佔所有董事比率 14%；1 名董事年齡在 50 歲以下，5 名董事年齡在 50-70 歲，1 名董事年齡在 70 歲以上。

姓名	多元化核心項目				性別	年齡 50 以下	年齡 50-70	年齡 70 以上	營運判斷	財務會計	經營理念	危機處理	產業知識	國際 市場觀	領導決策	法律
	多元化核 心項目	性 別	年 齡	年 齡												
駿朋投資股份有限公司 法人代表：陳政興		男	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓		
志聖工業股份有限公司 法人代表：梁又文		男	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
許鴻銘		男		✓				✓			✓	✓	✓	✓		
馬堅勇		男		✓				✓			✓	✓	✓	✓		
曾國華		男		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓		
羅偉		男		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓		
陳依梅		女					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

C. 本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

(a) 獨立董事席次不低於三分之一且連續任期不超過三屆。

(b) 董事至少含有一名不同性別董事。

(c) 著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，董事成員具備相關核心項目之能力達 2/3 以上。

D. 若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：本公司目前女性董事 1 席，尚未達三分之一之比例，係因產業特性人才尋覓不易，未來將持續透過多元管道延攬女性專業人才，以逐步提升女性董事席次，落實董事會多元化。

(2) 董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共有 7 名，其中包含 4 名獨立董事(佔全體董事成員比例 57.14%)，獨立董事席次超過 1/2) 及 3 名具員工身份董事(佔全體董事比例 42.86%)；4 名獨立董事任期年資在 6 年以下。獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情形，且無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(三) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

民國 115 年 3 月 22 日 (停止過戶日)

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要(學)經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳政興	男	95.10.01	786,146	0.48%	173,000	0.11%	500,000	0.3%	中山大學機械所碩士 華映精機廠設計處處長 均豪精密工業(股)公司副總經理 均華精密工業(股)公司法人代表 志聖工業(股)公司董事長	本公司董事長暨總經理 軒豐(股)公司董事長 均碩國際(股)公司董事長 Gallant-Rapid Corporation Limited 董事長 均強機械(蘇州)有限公司董事長及總經理 駿朋投資股份有限公司董事長 ESG 世界公民數位治理基金會(ESGWD) 副董事長 台灣電子製造設備工業同業公會 (TEEIA) 副理事長 社團法人台灣智慧自動化與機器人協會 (TAIROA) 副理事長 東台精機股份有限公司獨立董事	無	無	無	
執行長	中華民國	梁又文	男	114.10.10	0	0%	0	0%	0	0%	政大企家班 第 40 屆 美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢 美國西北大學法律碩士畢業 美國西北大學商學學程結業 均華精密工業(股)公司董事長、董事 長、董事 志聖工業(股)公司顧問、董事長特助 蘇州創峰光電科技有限公司董事長 華聖智能科技(股)公司董事長 長 視動自動化科技(股)公司董事、監察人 祁昌股份有限公司 董事	本公司副董事長暨執行長 均華精密工業(股)公司董事長暨執行長 志聖工業(股)公司總經理 台灣電路板協會 理事 廣信創業投資股份有限公司 監察人 創峰光電科技(股)公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限公司 董事長 蘇州創峰光電科技(股)公司 董事長 福盟國際企業(股)公司 董事長 南通創峰光電設備有限公司 董事長 昇陽國際半導體股份有限公司 法人代表人 樂林科技(股)公司 法人代表人 宇辰系統科技股份有限公司 獨立董事 敦品壹號創新投資股份有限公司 法人代表人 事代表人 台大校友創業投資管理顧問(股)公司 董事長代表人	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	遷(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要(學)經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
資深協理	中華民國	簡木發(註1)	男	102.07.01	38,105	0.02%	11,000	0.01%	0	0%	碩士 華映精機廠 高級工程師 均豪精密 協理 蘇州均晟豪智能科技有限公 司 總經理 均華精密工業(股)公司 法人 董事代表人	無	無	無	無	
資深協理	中華民國	李洪明(註1)	男	102.07.01	447	0%	0	0%	0	0%	碩士 中華映管 工程師 均豪精密 協理 均碩國際股份有限公司董事 均強機械(蘇州)有限公司董 事 芯聖科技(股)公司 法人董事 代表人	無	無	無	無	
協理	中華民國	徐鎮順	男	107.07.01	100,000	0.06%	0	0%	0	0%	碩士 菱生精密 組長	無	無	無	無	
協理	中華民國	張書省(註1)	男	110.07.01	0	0%	0	0%	0	0%	國立中央大學 碩士 均豪精密 資深處長 鈺晶科技 副理 弘塑科技 研發工程師	無	無	無	無	
財會主管	中華民國	黃盛宏	男	113.08.07	1,000	0%	0	0%	0	0%	東海大學財務會計系 資誠聯合會計師事務所 協理 旭源包裝科技股份有限公司 總經理特助 均豪精密工業股份有限公司 特別助理	歐姆佳科技(股)公司 法人董事代表人 本公司之公司治理主管	無	無	無	無

註1：李洪明資深協理於民國114年06月30日退休；簡木發資深協理與張書省協理於民國114年11月30日退休。

二. 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金：

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例%(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註12)	
		報酬(A)(註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)		本公司	財務報告內所有公司(註7)		
						本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額				現金金額
董事長	駿明投資股份有限公司法人代表：陳政興	1,579	0	3,145	108	162	5,021	18	1,288	0	1,788	11,159	19,035	0	
副董事長	志聖工業股份有限公司法人代表：梁又文	0	0	6,427	162	162	0	0	0	0	0	6,589	6,589	0	
董事	許鴻銘														
獨立董事	羅偉														
獨立董事	陳依梅														
獨立董事	馬堅勇														
獨立董事	曾國華														

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

(1)本公司由薪資報酬委員會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構後，提交董事會討論。

(2)支付董事、獨立董事之酬金依循公司章程及公司規定，與經營績效成正向相關，並考量未來風險作適度調整。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名		
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8) 財務報告內所有公司(註9)I
低於 1,000,000 元	陳政興、許鴻銘	陳政興、許鴻銘	許鴻銘
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	梁又文、志聖工業(股)公司、駿朋投資(股)公司、羅偉、陳依梅、馬堅勇、曾國華	志聖工業(股)公司、駿朋投資(股)公司、羅偉、陳依梅、馬堅勇、曾國華	志聖工業(股)公司、駿朋投資(股)公司、羅偉、陳依梅、馬堅勇、曾國華
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)			
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		梁又文	
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)			陳政興
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)			
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)			
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)			
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)			
100,000,000 元以上			
總計	9(內含法人 2 位)	9(內含法人 2 位)	9(內含法人 2 位)

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、獎勵金等等)。

註 3：係指最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特

支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過過派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：民國 114 年公司稅後純益 416,948 仟元；稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 12：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級 I 欄，

b. 公司董事如有領取來自子公司及所有轉投資事業，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例 (%) (註 8)		領取來自 子公司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金 (註 10)			
		本公司	財務報告內 所有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所 有公司 (註 5)	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	
董事長兼任總經理	陳政興																
副董事長兼任 執行長(註 11)	梁又文	5,153	7,779	176	176	3,112	3,646	1,830	0	2,330	0	10,271	13,931	2.46%	3.34%	0	
資深協理(註 11)	簡木發																
資深協理(註 11)	李洪明																

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)
低於 1,000,000 元	李洪明	李洪明
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	梁又文、簡木發	簡木發
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		梁又文
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳政興	陳政興
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	4	4

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註 2：總填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：徐填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：徐填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：民國 114 年公司稅後純益 416,948 仟元，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表巨欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 11：梁又文執行長於民國 114 年 01 月 10 日任職；李洪明資深協理於 民國 114 年 06 月 30 日退休；簡木發資深協理於民國 114 年 11 月 30 日退休。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

民國 115 年 3 月 31 日

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例 (%)
經 理 人	董事長兼任 總經理	陳政興	0	2,419	2,419	0.58%
	副董事長兼 任執行長	梁又文				
	協理	徐鎮順				
	財會主管	黃盛宏				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

新台幣仟元

項目	年度	
	民國 113 年度	民國 114 年度
本公司個體財報稅後純益(損)	296,749 仟元	416,948 仟元
本公司支付董事酬金所佔比率	2.79%	2.74%
本公司支付總經理及副總經理酬金所佔比率	3.86%	2.46%
合併報告所有公司支付董事酬金所佔比率	4.49%	3.75%
合併報告所有公司支付總經理及副總經理酬金所佔比率	4.10%	3.34%

註 1：上述董事酬金包含報酬、董事酬勞及業務執行費用(不含兼任員工領取相關酬金)；總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及特支費、退職退休金、員工酬勞金額。

1. 本公司依公司章程第三十條之一，應以當年度獲利狀況不低於百分之一且不高於百分之十二分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。前述員工酬勞中以不低於 20% 提撥為分派予基層員工之酬勞。第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本公司董事酬金，依「薪資報酬委員會組織規程」與「董事酬勞與報酬給付辦法」作為評核之依循。其績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。相關績效考核及薪酬合理性均經由薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況、未來風險及相關法令適時檢討酬金制度、標準與結構，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
3. 本公司支付予總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工酬勞及中長期留才獎勵措施等。其中，薪資之議定係由薪酬委員會參酌其所擔任之職稱、職級、職責等職位權責範圍以及對公司營運目標之貢獻度，並參考公司年度經營績效、未來風險及同業水準審議合理薪資。獎金與酬勞主要連結經理人之績效評估項目，包含財務性指標（如獲利能力、營業利益及年度策略等達成率等）與企業 ESG 永續經營相關指標（如公司治理、風險管理建構、環境資源、供應鏈管理及人才發展與關懷等）。並隨時視實際經營狀況、未來風險及相關法令適時檢討酬金制度。本公司經理人酬金經薪資報酬委員會審議後，提報董事會決議。

高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策

為激勵高階經理人重視長期綜合績效表現達到永續經營，自民國 111 年將永續議題鑑別出九項重大主題與董事長兼任總經理的長期激勵薪酬掛鉤。永續發展績效指標權重如下：

績效指標(權重)	執行方式
財務績效(30%)	公司財務績效及相較同業表現水準，如預算達成率、總資產、營收表現等
策略與管理(40%)	1. 依據未來中長期策略展開之目標，如數位轉型、永續承諾達成情形、重大主題因應調適作為等 2. 人才發展及職業安全衛生推動作為
永續與內控(30%)	致力實踐三大永續承諾，重視誠信經營、法令遵循及風險控管，實踐 ESG 各項重點工作(含關注氣候風險並推動淨零具體作為指標占比 10%)

三. 公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊：

1. 最近年度董事會開會 7 次(A)，董事及獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	駿朋投資股份有限公司 法人代表：陳政興	7	0	100%	
董事	志聖工業(股)公司 代表人：梁又文	7	0	100%	
董事	許鴻銘	4	1	80%	已於 114 年 8 月 11 日辭任
獨立董事	羅偉	6	1	86%	
獨立董事	陳依梅	7	0	100%	
獨立董事	馬堅勇	7	0	100%	
獨立董事	曾國華	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱本年報第 26 頁審計委員會運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	董事姓名	議案內容	應迴避利益原因	參與表決情形	決議情形
114.01.10	梁又文	本公司委任執行長案	兼任本公司經理人	不參與表決	其餘出席董事決議照案通過
114.05.02	陳政興	董事酬勞及經理人員工酬勞分派案	兼任本公司經理人	不參與表決	其餘出席董事決議照案通過
114.08.07	陳政興	經理人調薪案	兼任本公司經理人	不參與表決	其餘出席董事決議照案通過
114.12.10	陳政興	經理人年終獎金分配案	兼任本公司經理人	不參與表決	其餘出席董事決議照案通過
114.12.10	梁又文	經理人年終獎金分配案	兼任本公司經理人	不參與表決	其餘出席董事決議照案通過
114.12.10	陳政興	限制員工權利新股配發案	兼任本公司經理人	不參與表決	其餘出席董事決議照案通過
114.12.10	梁又文	限制員工權利新股配發案	兼任本公司經理人	不參與表決	其餘出席董事決議照案通過

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，本公司董事會評鑑執行情形如附表一。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (1)本公司致力提升資訊透明度，相關資訊皆於公開資訊觀測站公告，以維護股東權益。
- (2)本公司於民國100年12月22日設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估及檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，薪資報酬委員會運作情形請參閱本年報第37頁。
- (3)本公司於董事會設置董事7人，其中含獨立董事4人，獨立董事成員皆具不同產業背景之專長，落實董事會成員多元化。
- (4)本公司自願設置審計委員會，審計委員會主以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。
- (5)本公司於民國105年8月成立企業永續委員會，負責推動企業社會責任、誠信經營及公司治理相關事宜，每年定期向董事會報告執行情形。

附表一：董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年1月~114年12月	董事會及個別董事成員之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評	董事會績效評估內容：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等 個別董事成員績效評估內容：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等
每三年執行一次		董事會外部績效評核	委任外部專業獨立機構，向全體董事填具評估問卷，並擇定董事會成員進行訪談。	包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面。 依以下四大構面進行董事會效能評估：董事會專業職能、董事會對內部控制之重視程度與監督、董事會決策效能、董事會對永續經營之態度

附表二：民國114年度各次董事會獨立董事出席狀況

V：親自出席

◎：委託出席

114年度	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次
羅偉	◎	V	V	V	V	V	V
陳依梅	V	V	V	V	V	V	V

馬堅勇	V	V	V	V	V	V	V
曾國華	V	V	V	V	V	V	V

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊：

1.審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會 7 次 (A)，獨立董事出列情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	羅偉	6	1	86%	
獨立董事	陳依梅	7	0	100%	
獨立董事	馬堅勇	7	0	100%	
獨立董事	曾國華	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：審計委員會對重大議案之意見或決議結果如下附表一。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(1)本公司定期召開審計委員會並視需要邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。

(2)稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會報告。

(3)審計委員會委員每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核以及其他相關法令要求溝通事項進行溝通，並就簽證會計師之選任及獨立性進行審核。

(4)歷次審計委員會與簽證會計師及稽核主管溝通情形：

歷次審計委員會與會計師溝通情形摘要

審計委員會與會計師至少每季一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核向審計委員會報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

屆次	會議日期	溝通事項	建議及結果
第四屆第 12 次 (審計委員會)	114/02/26	1. 會計師就民國 113 年財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。 2. 會計師與公司治理單位溝通(關鍵查核事項討論)。	本次會議無意見
第四屆第 14 次 (審計委員會)	114/05/02	1. 會計師就民國 114 年第一季財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。 2. 會計師與公司治理單位溝通。	本次會議無意見

第四屆第 15 次 (審計委員會)	114/08/07	1.會計師就民國 114 年第二季財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。 2.會計師與公司治理單位溝通。	本次會議無意見
第四屆第 16 次 (審計委員會)	114/11/06	1.會計師就民國 114 年第三季財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。 2.會計師與公司治理單位溝通。	本次會議無意見

歷次審計委員會與內部稽核溝通情形摘要

內部稽核主管與審計委員會至少每季一次定期會議及每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

屆次	會議日期	溝通事項	建議及指正
第四屆第 12 次 (審計委員會)	114/02/26	1.民國 114 年 Q1 內部稽核執行報告。 2.民國 113 年度內控制度聲明書。 3.修訂薪工循環案。	本次會議無意見
第四屆第 14 次 (審計委員會)	114/05/02	1.民國 114 年 Q1~Q2 內部稽核執行報告。	本次會議無意見
第四屆第 15 次 (審計委員會)	114/08/07	1.民國 114 年 Q3 內部稽核執行報告。	本次會議無意見
第四屆第 16 次 (審計委員會)	114/11/06	1.民國 114 年 Q3~Q4 內部稽核執行報告。 2.增訂關係人相互間財務業務管理辦法及風險管理政策與程序案。	本次會議無意見。
第四屆第 17 次 (審計委員會)	114/12/10	1.民國 114 年 Q4 內部稽核執行報告。 2.民國 115 年度稽核計畫。	本次會議無意見。

四、年度工作重點：

- (1)依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- (2)審閱財務報告。
- (3)考核內部控制制度之有效性。
- (4)簽證會計師獨立性評估。
- (5)審議本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業資程序」、「資金貸與他人作業資程序」之修訂。
- (6)法規遵循。

附表一：證券交易法第 14 條之 5 所列事項，審計委員會對重大議案之意見或決議結果：

114 年審計委員會開會屆次	議案內容及後續處理	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
第四屆第十一次	1.本公司新任執行長委任案。 2.本公司投資有價證券案。 決議結果：經審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：經提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。	無

114 年審計 委員會開會 屆次	議案內容及後續處理	未經審計委員會通 過，而經全體董事 三分之二以上同意 之議決事項
第四屆 第十二次	1.民國一百一十三年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 2.本公司民國一百一十三年度財務報告案。 3.本公司民國一百一十三年度營業報告書案。 4.定義本公司基層員工及薪工循環修正案。 5.修正本公司「公司章程」案。 6.修正本公司 109 年第一次買回股份轉讓員工辦法案。 7.修正本公司 113 年第一次買回股份轉讓員工辦法案。 決議結果：經審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：經提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。	無
第四屆 第十三次	1.本公司民國一百一十三年度盈餘分派議案。 2.本公司資本公積配發現金案。 3.發行限制員工權利新股予員工案。 決議結果：經審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：經提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。	無
第四屆 第十四次	1.本公司 109 年第一次買回普通股股份轉讓予員工案。 2.本公司註銷 109 年第一次買回本公司股份暨訂定庫藏股減資註 銷基準日案。 3.民國 114 年第一季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通 事項。 決議結果：經審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：經提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。	無
第四屆 第十五次	1.民國 114 年第二季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通 事項。 決議結果：經審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：經提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。	無
第四屆 第十六次	1.民國 114 年第三季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通 事項。 2.轉投資公司「均碩國際股份有限公司」(以下簡稱均碩公司)提供 背書保證案。 3.「關係人相互間財務業務管理辦法」新增案。 4.「風險管理政策與程序」新增案。 5.修正民國 114 年度限制員工權利新股發行辦法案。 決議結果：經審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：經提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。	無
第四屆 第十七次	1.本公司民國 114 年限制員工權利新股第一次發行新股案。 2.本公司民國 115 年稽核計畫。 3.會計師獨立性及適任性評估(含審計品質指標 AQIs)及委任案。 決議結果：經審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：經提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。	無

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目		運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
		是	否		摘要情形
公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		√		本公司已於民國104年6月17日訂定公司治理實務守則，並揭露於本公司網站： https://www.gpmcorp.com.tw/about_governance_regulations.php	無差異
公司股權結構及股東權益	公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並依規定建立發言人制度，由股務單位及股務代理機構處理相關事宜，並於公司網站揭示聯絡窗口。	無差異
	公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		本公司每月依規定公告內部人持股情形，並隨時了解其異動情形，以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無差異
	公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司訂有「關係人交易作業程序」、「對子公司經營管理之監理作業辦法」等內部控制辦法，建立與關係企業之風險控管及防火牆機制，每年稽核單位依稽核計畫查核其執行情形。	無差異
	公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並可至本公司內部網站及公司網站查詢，每年視需要辦理宣導課程。	無差異
董事會之組成及職責	董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		本公司訂有「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考慮多元化，目前本公司董事會成員皆具備營運判斷能力、經營管理、領導及決策能力、會計及財務分析能力、國際市場觀及產業知識，具不同產業背景之專長(如：羅偉獨立董事擔任合勤科技公司財務會計主管，並具博士學位；陳依梅獨立董事曾受工研院特聘；馬堅勇獨立董事具產業董事/董事長經歷，並具博士學位；曾國華獨立董事具會計師資歷等，落實董事會成員多元化，董事成員學經歷參閱本年報附表第7~11頁。 https://www.gpmcorp.com.tw/about_governance_boardofdirectors.php 。	無差異
	公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		本公司除依法設置薪資報酬委員會外，並設置審計委員會，且該二委員會皆由全體獨立董事所組成。另本公司設有由經營團隊所組成之企業永續委員會，不定期向董事會報告執行狀況及成果。企業永續委員會之權責請參閱本年報第111頁。 其他功能性委員會未來將視需要評估設置。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
公司是否訂定董事會績效評估辦法及其估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√	<p>本公司訂有「董事會績效評估辦法」及「董事酬勞與報酬給付辦法」，每年定期對董事會之績效進行評估，每年年度結束後，以問卷自我評量方式進行績效評估。</p> <p>本公司董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 <p>本公司個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 <p>本公司審計委員會績效評估之衡量項目，包含下列四大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.內部控制 <p>本公司薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 5.其他項目 <p>評估程序於評年度結束後至最近一次召開之董事會開會前完成，並將評分結果報告董事會且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，以提升董事會運作之功能。本公司已於民國115年2月完成董事會、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估，並報告民國115年2月26日董事會。</p> <p>外部評估內容之衡量項目：董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監度、董事會對永續經營之態度等四大面向，民國113年度外部評估報告於民國113年12</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要情形	
			<p>月31日由社團法人臺灣誠正經營學會執行後出具，並報告於民國114年2月26日董事會。</p> <p>https://www.gpmcorp.com.tw/about_governance_boardofdirectors.php</p>	
董事會之組成及職責		√	<p>本公司訂有「簽證會計師選任審查辦法」，每年由審計委員會及董事會評核現任會計師之獨立性及適任性；於選任會計師前，由會計師出具「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，經本公司財會單位確認簽證會計師除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，並函請本公司股務代理機構確認其持股情形，經本公司財會單位審查確認符合獨立性及適任性後，送請審計委員會進行審議，提報董事會決議；最近一期會計師審查評核表業已於民國114年12月10日提報審計委員會及董事會通過。本公司評估會計師獨立性要件審查、運作及適任性檢查重要標準項目列舉如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。 ➤ 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。 ➤ 會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。 ➤ 會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 ➤ 對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。 ➤ 會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 ➤ 會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。 ➤ 會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 ➤ 卸任一年以內之共同執業會計師 	無差異

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要情形	
				並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 ▶ 會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。 ▶ 會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。 ▶ 會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	
	上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	√		董事會任命本公司財務暨會計主管擔任公司治理主管，並設置企業永續委員會公司治理小組負責推動公司治理相關事務及督導，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司登記及變更登記、安排董事進修課程等。公司治理主管民國114年進修情形請參閱附表二。 本公司訂有「處理董事所提出要求之標準作業程序」，協助董事遵循相關法令及回應董事問題。	無差異
	公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	√		本公司於公司網站設置利害關係人專區，並於公司網站上依不同利害關係人(員工、客戶、供應商、投資人、政府及社會等)揭露列述其溝通方式與企業社會責任的執行議題。	無差異
	公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	√		本公司已委任專業股務代理機構一統一綜合證券股務代理部處理股東會及股務相關事務。	無差異
資訊公開	公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	√		本公司已於公司網站(https://www.gpmcorp.com.tw/index.php)，揭露財務業務及公司治理等相關資訊。	無差異
	公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	√		1.財務資訊揭露情形 本公司網站設有(https://www.gpmcorp.com.tw/investors_finance.php)中、英語之投資人關係專區，定期更新公司財務資訊供投資人參考。 2.業務資訊揭露 本公司網站設有中、英語之公司簡介、產品介紹及核心競爭力提供即時之各項產品業務訊息，並隨時更新最新業務活動訊息供大眾參考。 3.公司治理揭露情形 本公司已將內部稽核之組織及運作、公司章程、取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序、資金貸與他	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			人作業程序、審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程等公司重要內規於公司網站揭露，並已落實發言人制度，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，依規定需公告之資訊揭露。
公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		本公司於民國115年2月26日公告並申報114年年度財務報告，及於規定期限前申報季度財務報告及營運情形。有關前述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		<p>員工權益及僱員關懷 本公司重視員工之權益及未來發展，訂定各項福利計畫，設有職工福利委員會，設立多元員工福利措施，另訂有「教育訓練品質手冊」，提供員工各項訓練及技能培訓及「工作場所性騷擾防治措施辦法」，並注重員工溝通與生活平衡，辦理多樣化之身心活動。請參考本公司網站之「生活職涯」專區：https://www.gpmcorp.com.tw/workplace_welfare.php</p> <p>投資者關係 請參考本公司網站之「投資人專區」。</p> <p>供應商關係 本公司訂有「供應商管理程序」及「承攬商管理辦法」來約束供應商與公司的商業行為，避免損害雙方商譽及利益，並於供應商經審核完成後，雙方簽署「保密合約」(NDA)以保障雙方之權利與義務。並宣導均豪公司在品質提升、降低成本、確保交貨、永續表現等四大面向的永續理念及目標。本公司針對承攬商定期召開協議組織會議，進行雙向溝通協調，並與承攬商簽訂「承攬商安全衛生環保暨資訊安全承諾書」，保障及規範承攬商於客戶端及廠區端施工安全。請參考本公司網站之「企業永續－永續供應鏈」專區。</p> <p>利害關係人之權利 本公司針對各類利害關係人提供多元之溝通管道，定期於內部討論利害關係人回饋並改善，並訂有「合約審查程序」，以保障公司之利益及兼顧合約之合理性，另會向董事會報告與各利害關係人之溝通結果。請參考本公司網站之「企業永續－利害關係人專區」。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√	<p>董事進修情形 本公司董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」持續進修，其進修情形，已依規定於公開資訊觀測站公告並揭露於附表一。</p> <p>風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 請參閱本年報111頁。</p> <p>客戶政策之執行情形 本公司平時與客戶皆保持密切聯繫，並建構專業的客服團隊及完善售服體系提供全方位優質服務，協助客戶提升競爭力並創造更高附加價值自許。</p> <p>為董事購買責任險之情形 本公司已為全體董事購買董監事及經理人責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失之行為而造成公司及股東重大損害之風險，並已於公開資訊觀測站公告。於民國115年2月26日向董事會報告投保情形。</p> <p>智慧財產管理計畫及執行情形 為提昇及保護公司技術能量，以利公司有效整合技術能力及厚植提昇市場競爭力，已制訂專利管理辦法並建置專利管理系統。專利截至114年度累計近200件。</p> <p>營業秘密除納入法律及實務受訓課程及新人訓課程內容，並每季於員工大會進行宣導，114年度新進人員教育訓練及法律實務課程上課人數為384人次，共384小時。</p> <p>智慧財產及營業秘密等相關執行情形，已於民國114年12月10日向董事會報告。</p> <p>請參考本公司網站「智慧財產管理」專區。</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
<p>請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>本公司第十一屆治理評鑑經臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心評鑑為上櫃公司6%~20%。</p> <p>本公司秉持永續經營理念，將企業永續經營、與客戶及社會群體建立長期夥伴關係、善盡企業公民責任，於民國105年成立企業永續委員會，負責推動企業社會責任及誠信經營相關事宜，每年向董事會報告執行情形及結果。</p> <p>本公司針對公司治理評鑑結果加強事項與措施如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶本公司訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告。 ▶本公司編製之永續報告書取得第三方驗證。 ▶本公司揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量。 ▶本公司制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫，並揭露內容及其實施情形。 ▶本公司定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫。 ▶本公司制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形。 			

附表一：民國 114 年度本公司董事及獨立董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
董事長	陳政興	114/03/25	ESG 世界公民數位治理基金會	公司治理發展及評量暨法遵案例實務	3	6
		114/08/22	社團法人中華公司治理協會	薪資報酬委員會運作與董事、經理人績效薪酬制度	3	
副董事長	梁又文	114/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	6
		114/10/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
董事	許鴻銘	114/03/25	ESG 世界公民數位治理基金會	公司治理發展及評量暨法遵案例實務	3	6
		114/07/04	社團法人中華公司治理協會	永續傳承與 AI 應用轉型之路	3	
獨立董事	曾國華	114/10/29	財團法人中華公司治理協會	淨零路徑與碳管理策略布局	3	6
		114/10/29	財團法人中華公司治理協會	劃時代的 AI 發展與商業應用	3	
獨立董事	馬堅勇	114/10/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「AI 人工智慧世代」應用實戰與風險分析	3	6
		114/10/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業永續發展與法令遵循實務_內線交易篇	3	
獨立董事	羅偉	114/01/16-114/01/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	24

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
		114/02/20-114/02/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	
獨立董事	陳依梅	114/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	6
		114/12/05	財團法人中華公司治理協會	永續資訊揭露不實(漂綠)的法律責任分析	3	

附表二：民國 114 年度本公司公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
公司治理主管	黃盛宏	114/03/18	證券櫃檯買賣中心	韌性台灣_櫃買永續債暨 ETF 論壇	3	21
		114/05/28~114/05/29	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露實作研習	9	
		114/06/30	證券櫃檯買賣中心	投資人關係經營分享會	3	
		114/07/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6	

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

一、薪資報酬委員會成員資料

115 年 3 月 31 日

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事	曾國華 (召集人)	本公司薪酬委員會由全體 4 位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本報「董事會成員簡介」(第 7-11 頁)。	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒定之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」相關規定 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	2	
獨立董事	陳依梅			0	
獨立董事	羅偉			0	
獨立董事	馬堅勇			1	

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

1.本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

2.本屆委員任期：民國 112 年 6 月 29 日至 115 年 6 月 18 日，最近年度薪資報酬委員會開會五次（A），委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	曾國華	5	0	100%	
委員	陳依梅	5	0	100%	
委員	羅偉	4	0	80%	
委員	馬堅勇	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):本公司薪資報酬委員會之討論事項與決議結果，及公司對於成員意見之處理，如下附表一。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

附表一：薪資報酬委員會之討論事項與決議結果，及公司對於成員意見之處理

114 年薪資報酬委員會開會屆次	議案內容及後續處理
第五屆第七次	1.擬提請審議本公司新任執行長薪酬案。
	決議結果：除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。
第五屆第八次	1.民國 113 年員工酬勞及董事酬勞分派提請審議案。
	決議結果：除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。
第五屆第九次	1.擬提請審議本公司民國 113 年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。
	決議結果：除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。
第五屆第十次	1.擬提請審議本公司經理人李洪明資深協理退休金申請追認案。
	2.擬提請審議本公司民國 114 年經理人調薪案。
	決議結果：案 1 與案 2 除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
第五屆第十一次	1.擬提請審議本公司民國 114 年經理人年終獎金分配案。
	2.擬提請審議本公司民國 114 年限制員工權利新股第一次配發予董事及經理人案。
	3.擬提請審議本公司經理人退休金申請追認案。
	決議結果：案 1、案 2 與案 3 除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會討論後，經全體出席董事同意通過。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
		是	否		摘要說明
公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		√		<p>本公司設置「企業永續委員會」作為推動企業永續專職單位，由陳政興董事長擔任永續長，於底下設置公司治理委員會、風險管理委員會、環境永續委員會、永續供應鏈委員會及社會共融委員會，並將誠信經營委員會之職責納入公司治理委員會，以及將資訊安全委員會納入風險管理委員會中。每年向董事會報告執行情形及結果一次，並予以檢討，民國114年度執行情形已於民國114年12月10日董事會進行報告。企業永續委員會相關資訊請參考本公司網站之「企業永續－永續管理」專區。</p>	無差異
公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		√		<p>本公司設置「企業永續委員會」作為推動企業永續專職單位，其風險評估邊界涵蓋均豪精密竹科廠、中科廠及臺南辦事處及高雄辦事處之據點。依據重大性原則選出9項重大性主題，含公司治理、能源管理及勞雇關係等。另外針對各重大性主題進行風險評估，並提出改善措施。於本公司網站「企業永續－永續管理」揭露於董事會針對永續發展之管理方針及策略目標督導情形。</p>	無差異
環境議題	公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		<p>落實綠色供應鏈管理，提升能源使用效率，並減少營運過程中對環境造成的危害，製程產生之廢水設有廢水處理設施並妥善處理，符合主管機關放流水標準。</p> <p>本公司以「垃圾減量、資源回收」為目標，使用之包裝材以資源回收為優先處理方式，提高廢棄物的管理效益，減少廢棄物處理時對環境造成的影響。其餘廢棄物考量其性質選擇焚化處理，並委由合格廠商清除與處理或資源回收，對於一般事業廢棄物及有害事業廢棄物之廠商則為簽訂合約時或視情況進行法規符合度的稽核。</p>	無差異
環境議題	公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		<p>本公司於機台設計時，選用較小動力傳動元件讓機台輕量化或選用高效率交換器之電源供應元件，以達節能；水循環系統規劃冷卻水來源配置，並設計多台共用過濾機，重複使用水源結合前後製程，有效將清洗機使用後之廢水再過濾，後水前送，省水比例可達60%。</p>	無差異

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
		是	否		摘要說明
環境議題	公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		<p>隨著極端氣候的議題逐漸浮現，溫室氣體議題逐漸受到重視，也是全人類必須共同合作降低的議題。為避免走入極端氣候的風險，本公司於民國110年起接受ISO14064-1:2018溫室氣體盤查的輔導，民國111年正式導入ISO14064-1:2018進行溫室氣體盤查，訂定低碳政策，優先進行減量並以淨零排放為最終目標。並於民國111~114年通過溫室氣體盤查外部查證；預計於民國115年通過GHG Protocol外部查證。請參考本公司網站之「節能減碳－溫室氣體」專區。</p> <p>本公司因應氣候變遷帶來的衝擊，落實綠色供應鏈管理，提升能源使用效率，並減少營運過程中對環境造成的危害，積極推行廠房內外之綠化植栽。致力於製程使用之化學品、水電資源等之有效利用，製程產生之廢水設有廢水處理設施妥善處理，符合主管機關放流水標準。產生之廢棄經由完善的污染防治設備處理後合法排放。</p>	無差異

<p>環境議題</p>	<p>公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>√</p>	<p>面對氣候變遷，本公司於民國110年起接受ISO14064-1:2018溫室氣體盤查的輔導，並於民國111年正式導入ISO14064-1:2018並通過溫室氣體盤查外部查證，後續將於每年進行溫室氣體盤查，並針對盤查結果進行檢討及改善。盤查之溫室氣體包含二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亞氮（N₂O）、三氟化氮（NF₃）、六氟化硫（SF₆）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs），盤查類別屬範疇一、範疇二及範疇三，基準年訂為民國110年。另外，本公司設立節能效率提升方案，如：照明管理、能源管理、水資源管理及廢棄物管理等，每月進行用電量及用水量之檢討，並實施改善措施，同時於官網公布近3年之用水量、用電量、及廢棄物量。請參考「年報一伍、營運概況一五.勞資關係資訊一履行企業永續」及公司網站之「節能減碳一溫室氣體」專區。</p> <p>民國114年8月開始接受GHG Protocol溫室氣體盤查的輔導，預計民國115年通過GHG Protocol溫室氣體外部查證。盤查類別範疇一、範疇二及範疇三，其中針對範疇三15大類別做更詳細盤查。但針對範疇三之14、15類別因公司無此項目，故無做細部盤查。</p> <p>減碳方案</p> <p>對於節能減碳管理，公司致力於節能燈具汰換，以減少石化燃料之消耗。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 民國114年外購電力總度數為2,772,343度，CO₂排放量為1,314,091公斤，柴油(直接能源)消耗量4.38GJ，佔總能源消耗量0.04%，外購電力(間接能源)消耗量9,982.71GJ，佔總能源消耗量99.96%。 ● 民國113年外購電力總度數為2,616,195度，CO₂排放量為1,240,076公斤，柴油(直接能源)消耗量4.37GJ，佔總能源消耗量0.05%，外購電力(間接能源)消耗量9,420.44GJ，佔總能源消耗量99.95%。 ● 民國114年較113年增加用電156,148度。 ● 民國114年投入約210萬元進行空調系統節能改善工程，總共減少系統用電55,357度，CO₂排放量為26,239.218公斤。 	<p>無差異</p>
-------------	--	----------	--	------------

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
				<p>廢棄物管理</p> <p>均豪一直以來於節能減碳及廢棄物減量著手，持續在永續領域努力，本公司以「垃圾減量、資源回收」為目標，廢棄物以可回收再利用作為優先選擇，提高廢棄物的管理效益，減少廢棄物處理時對環境造成的影響。民國114年一般事業廢棄物產生25.03噸；有害事業廢棄物產生2.35噸廢棄物產生量。本公司於公司網站揭露相關執行及處理情形。</p>

<p>社會議題</p>	<p>公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>本公司皆確實遵守相關勞動法規並尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及履行公平無差別待遇之雇用政策，並已制訂適當之管理制度，以監督管理。民國114年於之新進人員教育訓練中針對各項人權政策進行宣導，共計31人次，使各同仁瞭解自身的人權權益。</p> <p>本公司認同並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國鶻季勞動組織」等國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重所有同仁。</p> <p>適用範圍包含自身營運據點、供應商，包含全體員工和整體營運活動。</p> <p>企業永續委員為人權治理組織最高單位，其中社會共融小組為權責單位，負責統籌人權相關管理事務，根據專案需求召開會議，討論議題包含勞動人權、人才招聘、人才培育、員工健康與安全等，並依據實際情況修訂策略方向與行動方案，定期呈報企業永續委員會，請參考本公司網站之「人權管理」專區。</p> <p>本公司以歐盟「企業永續盡職調查指令」及OECD「責任商業行為盡職調查指南」為基礎，訂定人權盡職調查流程，透過人權議題風險辨識與評估，提出補救措施與風險減緩，進行改善與後續追蹤，以利有效降低人權風險之影響與衝擊。</p> <p>調查範疇 涵蓋自身營運及供應商。</p> <p>調查流程</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 議題風險鑑別：建立人權議題清單。 (2) 評估議題風險：發放問卷進行評估。 (3) 辨識高關注議題：鑑別高風險議題。 (4) 制定減緩與補救措施：終止或預防風險。 (5) 揭露與追蹤：公開及追蹤執行情況。 <p>針對員工部分，本公司於民國114年度鑑別出兩項人權議題：多元性與平等機會、不歧視。</p> <p>針對供應商部分，本公司於民國114年度鑑別出一項人權議題：人權評估。</p> <p>人權議題參考國內外之人權相關國際準則、同業及其他標竿企業所關注之人權議題，彙整出人權議題清單，發放問卷於本公司員工及供應商進行調查，並辨識關注/重視程度以及風險程度，作為盡職調查議題順序依據，優先處理重視程</p>	<p>無差異</p>
-------------	--	--	------------

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
				<p>度高且風險程度高之議題。</p> <p>減緩及補救措施</p> <p>本公司於民國114年度評估員工及供應商相關人權議題風險，就衝擊程度排序後，調查結果納入相關職能和流程，並針對重要人權議題提出減緩及補救措施，以降低人權的風險。</p> <p>員工人權議題</p> <p>(1)多元性與平等機會</p> <p>補救措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本公司已完成簽署多元、公平與共融宣言。 • 提供申訴專線電話、反霸凌信箱及員工意見箱等申訴管道。 <p>風險減緩：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 推動多元平等文化課程與活動，提升整體員工對多元、公平與共融的認知。 <p>(2)不歧視</p> <p>補救措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本公司已完成簽署職場不法侵害零容忍聲明書。 • 提供申訴專線電話、反霸凌信箱及員工意見箱等申訴管道。 <p>風險減緩：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 開設無意識偏見教育訓練課程，宣導不歧視、職場不法侵害零容忍的就業環境。 • 加強招募管道資訊審核。 <p>供應商人權議題</p> <p>(1)人權評估</p> <p>補救措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 供應商評鑑之永續自評問卷，納入人權面向自評。 <p>風險減緩：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 定期稽核供應商人權管理制度與執行情形。

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
		是	否		摘要說明
社會議題	公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	√		<p>員工薪酬 本公司遵循勞動基準法及相關法令訂定員工各項薪資福利措施,並訂定具競爭力之薪資報酬政策,將留住優秀人才視為公司重要的人力資源策略。每年均會進行同業市場薪資調查,以制定合理且具競爭力的薪酬制度,亦會依營運績效及員工實質貢獻度,給予員工差異化分配獎金,並訂有員工激勵措施,如創新研究獎金、提案改善獎金、特殊表現優秀團隊獎金、優秀員工獎金以激發員工工作熱忱與團隊合作精神,使員工得以分享努力工作的成果。</p> <p>經營績效反映於員工薪酬 本公司依公司章程第三十條之一規定,以當年度獲利狀況彌補累積虧損後,以不低於百分之一且不高於百分之十二分派員工酬勞(獲利狀況為當年度員工酬勞及董事酬勞分配前之稅前利益),員工酬勞發放對象包含一定條件之從屬員工。</p> <p>其他休假及福利措施請參考「本年報第95頁勞資關係資訊—員工福利措施」。</p>	無差異

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
社會議題	公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√	<ul style="list-style-type: none"> • 本公司提供符合職業安全衛生法且舒適安心的工作場所，導入並取得 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證，證書有效日期為 2024/01/02 至 2027/01/01。公司每年進行危害鑑別風險評估，並進行持續改善，降低環境風險，同時，辦理職安衛教育訓練課程與健康促進活動。 • 本公司每年定期舉辦安全衛生在職教育訓練、主題式緊急應變演練（如：緊急應變、消防綜合演練、化學品洩漏應變、CPR 急救包紮救護課程等）、健康講座及一系列健康促進、身心紓壓活動活動，共同推動及維持健康、安全優質的工作環境。 • 提供優質工作環境： (1) 持續改善工作環境，提供友善職場： 為提升廠區環境之安全，進行 <ul style="list-style-type: none"> • 全廠區電力盤附鎖改善工程，增加用電安全。 • 廠區梯間燈具改善，改用 LED 筒型燈具，以延長桿更換光源，減少人員高空作業風險。 (2) 工作環境方面：持續進行每 6 個月實施作業環境監測，評估個人暴露情形，作為工作場所環境改善之依據。 <ul style="list-style-type: none"> • 本公司民國 114 年度員工及承攬商無失能傷害事故發生；員工於客戶端死亡事故 1 件，綜合傷害指數為 5.34%。 • 本公司民國 114 年度無火災意外發生，故無人員死傷情形。 請參考「本年報第 99 頁勞資關係資訊－員工工作安全及健康」及本公司網站之「企業永續－人權管理－職業安全衛生」專區。 	無差異
社會議題	公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√	<p>本公司已為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫，本公司教育訓練執行情形，請參考「本年報第 97 頁勞資關係資訊－進修、訓練制度」。</p>	無差異

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
社會議題	針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√	<p>本公司對產品與服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞客戶信任、損壞客戶權益之行為。</p> <p>均豪多年來秉持「品質第一、顧客至上、精益求精、創造價值」之品質政策，建構專業的客服團隊及完善售服體系，成立 24 小時快速回應 on call 專線 0800-387-387，並設置業務中心及客服中心專用信箱揭露於公司網站，提供客戶優質服務，就產品與服務提供透明且有效之客戶申訴程序，並依本公司「個人資料管理辦法」及相關法規，保護客戶提供之個人資料，確實尊重客戶之隱私權。</p> <p>本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理，不從事任何形式不公平的商業行為。其研發、採購、生產、作業及服務流程，應確保產品及服務資訊之透明性及安全性，制定且公開本公司客戶權益政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全，協助客戶提升競爭力並創造更高附加價值。</p> <p>本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理，不從事任何形式不公平的商業行為。其研發、採購、生產、作業及服務流程，應確保產品及服務資訊之透明性及安全性，制定且公開本公司客戶權益政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全，協助客戶提升競爭力並創造更高附加價值。</p>	無差異

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
		是	否		摘要說明
社會議題	公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		<p>遵循規範</p> <p>本公司致力驅動產業與供應鏈的正向循環，積極與供應商合作，投入供應鏈永續發展，確認供應鏈具備安全工作環境、有尊嚴勞工關係、遵守道德規範的營運，並致力於促進環境保護。訂定「供應商管理程序」，供應商必須遵從並簽屬「供應商社會責任暨誠信廉潔承諾書」為執行標準，承諾書包含人權(含勞動條件)、道德(含智慧財產與資訊安全)、職業安全及環境，其中針對環境有以下規範：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對廢棄物管理的程序和標準，化學品和其他有害物質(包括事業廢棄物)的處理和清除，都必須符合或高於最低法定要求，以確保這些物質得到安全的處理、運輸、儲存、使用、回收或重用和處置，並對清理承攬商須設定妥善評估標準。 2. 製造操作過程中應盡量減少對環境和自然資源造成的不利影響，同時保護公眾的健康和安全。應制定充分且有效的計劃，確保有害物質管制作為採購與製造流程的正式要求的一部分。 3. 應符合噪音管制區內的有關法規。並有效監測水排放並控制污染。 4. 供應商應施行具成本效益的方法，提高能源效率並最大限度地減少能源消耗及所有相關溫室氣體(GHG)排放。 <p>實施情形</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國114年度簽屬承諾書計113家，供應商評鑑計33家。 2. 執行民國114年度供應商人權盡職調查，並於永續自評問券納入人權、道德、智慧財產、資訊安全及環境項目。 3. 不定期邀請供應商，針對提升供應商職場安全、碳盤查、氣候變遷、法規風險與從業道德倡議宣導等進行雙向溝通計6家。 4. 稽核結果分級管理，依「供應商品質等級通知函」連同不良率及不良資料通知該供應商品質狀況，並派員稽核要求品質改善，進行後續追蹤管理。 	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√		<p>本公司發行之永續報告書主要依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)於民國110年公布之GRI通用準則 2021(GRI Standards 2021)進行編製。報告書於發行前取得董事會核准，並委託資誠聯合會計師事務所依中華民國確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」針對所選定指標執行獨立有限確信(limited assurance)，確信報告附於本公司永續報告書附錄。</p> <p>無差異</p>
<p>公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂有「企業社會責任規範」，與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」並無重大差異，可至本公司公司網站或公開資訊觀測站下載；有關企業社會執行情形，請參閱本年報或本公司公司網站。</p>			

其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一)環境永續

- 廠內一般生活用水設備採用節水器具，以降低水資源之浪費，逐批更換廠內省電燈具，減少 CO₂ 排放。
- 空調系統節能改善工程，總共減少系統用電 55,357 度，CO₂ 排放量為 26,239.218 公斤。
- 持續推行辦公室綠化及各廠區綠植覆蓋率。

(二)社會共榮

- 公益關懷
- 共贊助五所學校：桃山國小/花園國小/五峰國中/尖石國中/富光國中，國小成績達標者每位補助 600 元，國中成績達標者每位補助 1,000 元，190 名，進步幅度最大但學期成績未達標者進步獎，共 18 名，總計新台幣 170,400 元。
- 舉辦【捐發票助公益】活動將所得發票全數捐助給【創世基金會】，照顧植物人。
- 捐助「愛無國界關懷協會」，加入資助西非布吉納貧童教育計畫，關懷弱勢兒的「愛霖新種子贊助計畫」，認養二名孩童，共投入新台幣 36,000 元。
- 贊助「ESG 世界公民數位治理基金會」，協助上市櫃公司進行董事養成與培訓，並提供 ESG、氣候變遷、國際計畫理念及活動之宣傳，以提升各企業於 ESG 領域之概念，共投入新台幣 200,000 元。
- 支持「ESG 世界公民數位治理基金會-百萬學童-世界公民素養教育計畫」透過推動世界公民理念、K12 學童的素養教育，加強台灣人從自我連結到世界公民的認同感。共投入新台幣 80,000 元。
- 均豪同仁自發性捐出咖啡物料及包裝等所需器材，由其它同仁擔任志工進行分袋/包裝成耳掛咖啡，並上架及義賣，讓均豪同仁可以一邊享受咖啡的香醇，一邊做公益，所得之收入將捐助給需要幫助的人，民國 114 年計義賣約 1,035 包。
- 鼓勵同仁持續加入志工行列，於民國 114 年舉辦 3 梯次志工活動(含清潔維護計畫、協助農收等)，共投入 75 人次。
- 民國 114 年 9 月 23 日，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰決引發泥流，重創光復鄉市區。均豪秉持人飢己飢精神，員工自發捐助新台幣 205,800 元，均愛社咖啡基金挹注 50,000 元，公司再加碼 244,200 元，三筆合計新台幣 500,000 元，以實際行動支援災後救助，展現企業與同仁攜手關懷社會的力量。
- 培育平台
- 贊助「中平國小棒球隊」，推動品格棒球，培養台灣球壇後進新秀，推展五年長期贊助計畫，每年贊助新台幣 20,000 元。
- 捐助「臺大醫院代訓印尼醫師經費計畫」，以優質的醫術軟實力與人脈網絡，擴大我國影響力，為合作發展重大醫療技術的合作夥伴，加深兩國醫界的關係，共捐助新台幣 583,000 元。
- 支持在地體育發展，贊助新成軍的「洋基工程籃球隊」，於民國 114-115 年度球季給予支持，展現支持體育與公益之企業精神，於民國 114 年贊助新台幣 1,000,000 元。
- 舉辦跨國文化/節慶活動交流課程，促進員工拓展國際視野，培養多元文化素養，落實公司職場多元包容理念。兩場次共投入新台幣 10,000 元。
- 舉辦半導體產業電影—《造山者：世紀的賭注》，以科技文化活動形式促進員工理解產業歷史脈絡與文化，提升產業視野。兩場次共投入新台幣 77,890 元。
- 產學合作
- 為鼓勵國內頂尖教授持續精進學術，捐助臺灣大學工學院「學術勵進獎」及「院長獎」，同時也建立起教師與企業研發的連結，共捐助新台幣 320,000 元。
- 為強化延攬及留任國內外頂尖人才，捐助工學院「學術勵進青年講座」，同時也建立起新進教師與企業研發的連結，化解大學的人才危機，捐助新台幣 300,000 元。
- 為獎勵臺灣大學僑生持續學習，培育良好學習的態度，捐助「優秀僑生獎學金」，落實產學接軌，履行企業永續，共捐助新台幣 600,000 元。
- 加入 GOLF 學用接軌聯盟，透過雲端學習平台，啟動實習培訓推動，藉由線上專業課程先修、線下企業實習參訪，以產學合作方式促進學生提早與產業接軌，共投入新台幣 50,000 元。
- 與 G2C+聯盟共同辦理清華大學 DIT Robotics 機器人暑期營隊，透過舉辦科技主題的夏令營，進而吸引有興趣的同仁子女，將他們培養成企業未來需求的人才，共花費新台幣 486,370 元。
- 贊助第 22 屆自動化技術國際會議，探索學術和工業領域科學和技術的前沿進展，投入

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>共計新台幣 40,000 元。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 贊助中原大學 113 學年度專題實作競賽作業，共計新台幣 20,000 元。 ● 希望透過零組件捐贈，為學生提供更多實踐機會，幫助他們更加理解所學知識的實際應用；期望學生們能更早熟悉實際的工業應用，一起為培養優秀的人才、推動知識與實踐的結合而努力。捐贈國立清華大學儀科中心、成功大學、中興大學及清華大學等，共計 341 項零組件，市值約 4,723,176 元。 ● 提供實習機會給在校學生，運用年輕人的特質與能力增加組織的活力與創意，同時短期補充企業人力藉以發掘未來人才，共計 7 名。 ● 受理外部團體參訪共 1 梯次，安排專人進行產業概況與智慧製造相關內容介紹，協助社會團體了解半導體設備產業發展現況，落實企業社會責任及永續發展理念。 ● 為鼓勵國內大專院校學生投入智動化跨領域設計、實作，並傳承原教育部產業先進設備人才培育計畫之精神，由本公司主辦智動化創作獎，協助大專青年投入智慧製造領域，為國家培育優秀的智慧製造人才及設計能量，提升產業競爭力，共投入新台幣 1,574,743 元。 <p>(三) 獲獎事蹟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第 21 屆臺灣金根獎 ● 114 年新竹市政府 ESG 卓越媒合表揚 ● 114 年企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比績優企業 ● 114 年職場健康促進自主評核制度通過審查，並取得「合格」資格 			

上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	均豪氣候治理之最高單位為董事會，除負責訂定公司之氣候相關策略方向，定期針對關鍵氣候風險提出整體對應策略、目標，並委派企業永續委員會進行各項行動方案之推展，透過每年 1 次於董事會進行之永續執行成效報告，落實永續發展及氣候治理之監督。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	由企業永續委員會召集相關執行單位，評估出 4 項關鍵氣候風險與機會，分別為降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化、客戶行為改變、低碳技術轉型的成本、開發和/或擴大低碳商品與服務。

面向	氣候風險機會	影響期程	財務衝擊	因應策略與管理措施
實體風險	降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	中期（3-10年內）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 原物料價格上漲，導致營運成本增加 ■ 用電量上升，導致營運費用增加 ■ 員工無法出勤、供水供電不足、缺料…等致使營運中斷，造成營收減少 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因應乾旱，定期舉行廠區聯合會，檢討供水優先順序，降低產線影響。 2. 未來擬將太陽能電廠發電自發自用，一方面開發第二電力來源，降低因氣候影響之停、跳電狀況，提高廠區用電供應穩定。；一方面能達成節能減碳目標。 3. 調整供應鏈佈局及開發替代原物料 <ul style="list-style-type: none"> • 加工件：若遇中區限水，啟動備用合作供應鏈，移往北區執行加工。 • 市購件：開發替代原物料，可採購海外供應鏈或其他在地品牌替換合作，以避免缺料導致營運中斷之風險。 4. 因應停電事故，短期以調班的方式處理，降低出貨/交期的影響。
轉型風險	客戶行為改變	中期（3-10年內）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 無法滿足客戶要求，導致市場銷售降低，造成營收減少 ■ 投入研發導致營運成本增加 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於產品設備開發時，除預估成本外，對於能資源（水與電）之消耗量皆審慎評估，以提升產品競爭力與市佔率優勢。 2. 建立與客戶之雙向溝通管道，提供客戶回饋程序，以即時了解客戶對產品規格的需求，配合客戶需求進行設計。 3. 透過異業合作的方式，提升技術、改善產品，提高產品及服務品質。 4. 透過 G2C+聯盟業務面相互提攜、提供完整的產品和服務，提高接單能力，進一步擴大營收。
轉型風險	低碳技術轉型的成本	中期（3-10年內）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 投入研發之原物料及人力資源，導致營運成本增加 ■ 轉型失敗將造成訂單流失、市佔率下降，導致營收減少 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 導入智慧製造與自動化降低產品碳排：機械設備經由數位化、智慧化，導入 IDMS 設備健康診斷、故障排除…等，提高節能效率。 2. 透過定期的研發會議，朝下列目標進行專案開發： <ul style="list-style-type: none"> • 改善製程加工方式提升效率 • 設備功能高度複合化 • 提高設備機台能源使用效率 • 智慧化運作控制，透過自動偵錯，減少待機時間，減少損耗浪費 <p>均豪於近年已完成之開發項目包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 設備冷卻水循環使用：冷卻水雙系統供給系統透過集水箱加入冷卻原液混合使用，收集研磨廢液後，進行冷卻水過濾循環使用，來達到節水。 ➢ Green Idle 管制：當設備於非生產時段自動降頻節能。 3. 產品設計源頭 3R 概念，物料採購條件納入可回收/可循環材料的要求、生產過程中的副產品再利用等。

機會	開發和/或擴大低碳商品與服務	中期(3-10年內)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 提供低碳產品增加競爭力、市佔率，進而提升營業收入 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對原物料進行以下管控措施，以降低產品碳足跡。包含： <ul style="list-style-type: none"> • 原物料採購以國內生產製造(本土化)為優先 • 整合均豪專屬之設計，將經常使用之材料編整成冊並隨時監控原物料水位，降低採購所發生的運輸碳排 2. IDMS 智能監控:生產單位於機台測試期間，採 IDMS+電表，取得設備之耗能數據，研發單位在設計時得以採用相關數據應用、參考。 3. 積極尋求節能減碳或能兼具儲能之原物料，能夠優化製程或達成低碳產品開發。將陸續辦理接洽空壓元件/馬達元件/變頻器元件...等知名供應商至廠內分享節能減碳產品。 4. 建立良好供應鏈合作關係，雙方資訊透明、共享，為綠色供應鏈目標，共營商機。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。			均豪針對氣候變遷風險與機會評估發生期程、綜合考量氣候風險與機會發生之可能性及對公司之影響程度，鑑別出關鍵氣候變遷風險與機會，並分析對公司潛在之營運與財務衝擊，財務衝擊影響請詳上第 2 點說明。	
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。			均豪風險管理委員會每年定期依循 TCFD 指引、同業報告書及國際趨勢蒐整均豪相關氣候議題，並向各相關廠區與部門單位蒐整年度因應氣候風險情況，透過訪談各氣候議題相關單位對議題之衝擊程度與發生可能性看法，以彙整並鑑別均豪年度關鍵氣候風險與機會，及設立降低風險的因應措施，以上執行過程與結果向上提報企業永續委員會，且每年度向董事會報告一次。	
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。			規劃中	
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。			規劃中	
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。			規劃中	
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再			規劃中	

生能源憑證 (RECs) 數量。	
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫	(另填於 1-1 及 1-2)

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

<u>敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。</u>		
均豪自 110 年起已依照國際標準組織 (ISO) 發布之 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準建立溫室氣體盤查機制，每年定期盤查本公司個體之溫室氣體排放量，並取得第三方查證。均豪個體最近兩年度之溫室氣體排放量、密集度及資料涵蓋範圍，請詳下表：		
	113 年度(ISO 14064-1)	114 年度(GHG Protocol)
範疇一排放量(噸 CO ₂ e)	95.08	156.39
範疇二排放量(噸 CO ₂ e)	1,234.02	1,313.58
總計	1,329.10	1,469.97
營業額(新臺幣百萬元)	1,854	1,963
密集度(噸 CO ₂ e/新臺幣百萬元)	0.71	0.74
資料涵蓋範圍	均豪個體公司 100%	均豪個體公司 100%

1-1-2 溫室氣體確信資訊

<u>敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。</u>
截至年報刊印日，本公司個體已取具 BSI 英國標準協會依照國際標準組織 (ISO) 發布之 ISO 14064-3:2018 執行民國 113 年度合理保證程度之確信意見。民國 114 年度改進行 GHG Protocol 溫室氣體盤查，已完成內部稽核，並預計於民國 114 年 5 月經 BSI 英國標準協會進行查證，完整查證資訊將於永續報告書揭露。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

為規劃溫室氣體減量策略，均豪個體以首次完成盤查之民國 110 年作為溫室氣體排放減量基準年(範疇 1+2 合計：1,527.02 噸 CO₂e)，並訂定民國 115 年較基準年減量 5%、民國 117 年較基準年減量 10%及民國 139 年淨零排放之目標，並將持續推動各項節能措施及擬定太陽能發電自發自用計畫，逐步檢視公司的減量成果與目標達成情形，並完成減量目標。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
訂定誠信經營政策及方案	√		本公司於民國103年12月17日訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，藉以規範此所需遵循之企業及員工行為準則，並不定期向公司員工進行宣導，本年度業已於民國114年12月10日董事會報告民國114年度執行情況，其執行及處理情形揭露於本公司網站。	無差異
公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		本公司「誠信經營守則」，載明不誠信行為之防範措施，如：行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密及智慧財產權等。 本公司員工需簽署「保密切結暨電腦資料授權使用同意書」，以防範侵害營業秘密。本公司除訂定「誠信經營守則」外，尚訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易作業程序」等辦法。	無差異
公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並且每年定期於董事會報告相關執行事項。本年度業已於民國114年12月10日董事會報告民國114年度執行情況。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
落實誠信經營	公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√	本公司以公平與透明之方式從事商業活動，並於從事商業活動前，審慎評估往來對象，以避免與不誠信之對象進行交易。另與交易對象簽訂商業契約時，由法務單位審查簽立之合約條款，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，本公司舉辦誠信經營相關課程請參閱本年報54頁。本公司供應商需簽屬「供應商社會責任暨廉潔承諾書」，如違反道德方面承諾，需賠償行賄金額或所獲取不正當利益金額之懲罰性違約金，且本公司有權自行決定撤銷、終止或解除雙方交易。	無差異
	公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√	本公司由企業永續委員會負責推動企業誠信經營相關業務，另設置直轄於董事會之稽核室，負責稽核內、外部是否有違反誠信經營之情事。若屬重大違反誠信事宜，則依相關法令及作業程序提報董事會。每年(第四季)就相關執行狀況提報董事會。本年度業已於民國114年12月10日董事會報告民國114年度執行情況。	無差異
	公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√	本公司對內相關內部規章與員工公司工作守則均公佈於公司內部網站，並於修訂時函知全體同仁。對外於公司網站設置利害關係人專區(網址: https://www.gpmcorp.com.tw/enterprise_stakeholder_contact.php)。	無差異
落實誠信經營	公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√	本公司已訂有內部控制制度、內部稽核實施細則、會計制度及各項管理規章，且運作情形正常並落實誠信經營之要求，本公司內部稽核執行，依年度稽核計畫進行查核並製成稽核報告，報告完成次月底前交付予各獨立董事外，並定期於審計委員會與董事會報告稽核結果。	無差異
	公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	本公司定期辦理與誠信經營相關之教育訓練，於民國114年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規、法律實務、財務管理進階、內線交易及歸入權法規、會計制度及內部控制等課程)，共計436人次，合計616小時，並已將相關規範之作業程序及辦法置於本公司內部網站，以供員工隨時查閱。	無差異




評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
公司檢舉制度之運作情形	公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√	本公司訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」設有檢舉及申訴管道，如檢舉專線、電子郵件及相關懲戒措施，並不定期檢討修正，以達有效及充分意見溝通之管道，使問題發生時，得以快速及有效溝通解決，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。	無差異
	公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√	本公司設有檢舉辦法，且於公司網站設置「違反職業道德申訴管道」與檢舉信箱，對檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並以電子郵件方式回覆調查結果。	無差異
	公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√	本公司對於檢舉人負保密之責，避免檢舉人因檢舉而遭受不當之處置之措施。	無差異
加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√	本公司誠信經營守則已上傳至公開資訊觀測站，並揭露於本公司網站 https://www.gpmcorp.com.tw/enterprise_honesty.php	無差異	
公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司落實遵守國內法令，並要求員工遵循相關內部規章，依據「上市上櫃公司誠信經營守則」作為落實誠信經營之依據。				
其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： (一) 本公司訂有內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序，明定董事、經理人、依公司法第 27 條第 1 項規定受指定代表行使職務之自然人及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予不知悉之他人。 (二) 本公司簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所，該會計師並未擔任本公司董事，兼具專業及獨立性，本公司審計委員會及董事會每年皆會審查會計師之獨立性，並取具會計師「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」；會計師定期查核各大循環及內部控制，對本公司內部控制及會計處理事項建議。 (三) 本公司供應商需簽屬「供應商社會責任暨廉潔承諾書」，該承諾書規範供應商員工勞動條件、道德方面、環境方面之承諾，如：反歧視、禁用童工、秉持高廉潔道德標準、尊重與保護客戶資料及智慧財產權、承諾產品或零件之金屬未使用衝突金屬及廢棄物管理的程序和標準等，如違反承諾書，需賠償行賄金額或所獲取不正當利益金額之懲罰性違約金，且本公司有權自行決定撤銷、終止或解除雙方交易。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，並不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。本辦法亦於內部文件管理系統公告，供經理人及員工隨時查閱。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

 <p>均豪精密工業股份有限公司 內部控制制度聲明書</p> <p>日期：115 年 02 月 26 日</p> <p>本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：</p> <p>一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。</p> <p>二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。</p> <p>三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。</p> <p>四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。</p> <p>五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。</p> <p>六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。</p> <p>七、本聲明書業經本公司民國115年02月26日董事會通過，出席董事6人中，0人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。</p> <p style="text-align: center;">均豪精密工業股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">董事長兼總經理：陳政興  簽章</p> <p style="text-align: center;">副董事長兼執行長：梁又文  簽章</p>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

會議名稱	會議日期	重要決議暨執行情形
股東會	114.06.03	<p>重要決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認民國一百一十三年度盈餘分派議案。 3. 通過資本公積配發現金案。 4. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 5. 通過本公司「公司章程」修正案。 6. 通過發行限制員工權利新股予員工案。 7. 通過解除本公司董事及其代表人之競業限制案。 <p>執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 114 年 5 月 2 日董事會訂定民國 114 年 06 月 25 日為除息基準日，盈餘分配之現金股利(每股 1.8 元)及資本公積配發現金(每股 0.2 元)於民國 114 年 07 月 11 日發放予股東，分派金額與股東常會決議無差異。 2. 公司章程修訂於民國 114 年 6 月 6 日經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹商字第 1140017529 號函核准變更登記。

會議名稱	會議日期	重要決議
董事會	114.01.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司新任執行長委任及其薪酬案。 2.通過本公司取得有價證券購買價格案。
董事會	114.02.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國一百一十三年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 2.通過民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.通過本公司民國一百一十三年度財務報告案。 4.通過本公司民國一百一十三年度營業報告書案。 5.通過定義本公司基層員工及薪工循環修正案。 6.通過修正本公司「公司章程」案。 7.通過修正本公司 109 年第一次買回股份轉讓員工辦法。 8.通過修正本公司 113 年第一次買回股份轉讓員工辦法。 9.通過召開民國一百一十四年股東常會相關事宜、受理股東提案相關內容案。
董事會	114.04.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國一百一十三年度盈餘分派議案。 2.通過本公司資本公積配發現金案。 3.通過解除本公司董事及其代表人之競業限制案。 4.通過發行限制員工權利新股予員工案。 5.通過修訂召開民國一百一十四年股東常會相關事宜。
董事會	114.05.02	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 113 年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 2.通過本公司 109 年第一次買回普通股股份轉讓予員工案。 3.通過註銷 109 年第一次買回本公司股份暨訂定庫藏股減資註銷基準日案。 4.通過民國 114 年第一季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項。 5.通過訂定本公司民國 114 年現金紅利配息基準日相關事宜。
董事會	114.08.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 114 年經理人調薪案。 2.通過民國 114 年第二季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項。 3.通過本公司民國 113 年永續報告書。
董事會	114.11.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國 114 年第三季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項。 2.通過為轉投資公司「均碩國際股份有限公司」提供背書保證案。 3.通過新增「關係人相互間財務業務管理辦法」案。 4.通過新增「風險管理政策與程序」案。 5.通過修正民國 114 年度限制員工權利新股發行辦法。

會議名稱	會議日期	重要決議
董事會	114.12.10	1.通過本公司民國 114 年經理人年終獎金分配案。 2.通過本公司 114 年限制員工權利新股第一次配發予員工及發行新股案。 3.通過本公司民國 115 年稽核計畫。 4.通過會計師獨立性及適任性評估(含審計品質指標 AQIs)及委任案。
董事會	115.02.26	1.通過本公司民國一百一十四年度財務報告案。 2.通過本公司民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.通過本公司 113 年第一次買回普通股股份轉讓予員工案。 4.通過評估基層員工薪資水準及薪工循環修正案。 5.通過民國一百一十四年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 6.通過本公司民國一百一十四年度營業報告書案。 7.通過本公司民國一百一十四年度盈餘分派議案。 8.通過選舉本公司第十七屆董事改選案。 9.通過召開民國一百一十五年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名相關內容案。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四. 簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費(註 1)	非審計公費(註 2)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	吳偉豪	114.01.01~114.12.31	2,360	90	2,450	
	江采燕	114.01.01~114.12.31				

註 1：審計公費係指公司給付簽證會計師有關年度財務報表及各季合併報表查核簽證、IFRSs 附註揭露查核、營利事業所得稅查核簽證及複核移轉計價報告之公費。

註 2：非審計公費主要係複核非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表及其他資訊之閱讀與考量等。

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五. 更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更換日期	民國 112 年 1 月 1 日
更換原因及說明	配合資誠聯合會計師事務所內部職務輪調，自民國 112 年第一季起財務報告簽證／核閱會計師由李典易及江采燕會計師變更為吳偉豪及江采燕會計師。

說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師	委任人
	情 況		不適用	
	主動終止委任			
不再接受(繼續)委任				
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	最近兩年度出具無保留意見。			
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務	
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其 他	
	無	✓		
說明				
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無			

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	資誠聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	吳偉豪、江采燕
委 任 之 日 期	民國 112 年 1 月 1 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

- 六. 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。
- 七. 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：
- (1) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權變動情形

職稱	姓名	民國 114 年度		當年度截至 115 年 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨 總經理	駿朋投資(股)公司	0	0	0	0
	代表人：陳政興	115,000	0	(115,000)	0
董 事	志聖工業(股)公司	(36,000)	0	0	0
	代表人：梁又文	135,000	0	(135,000)	0
董 事	許鴻銘(註 3)	0	0	0	0
獨立董事	馬堅勇	0	0	0	0
獨立董事	羅偉	0	0	0	0
獨立董事	陳依梅	0	0	0	0
獨立董事	曾國華	0	0	0	0
資深協理	簡木發(註 3)	0	0	0	0
資深協理	李洪明(註 3)	(89,000)	0	0	0
協 理	徐鎮順	0	0	0	0
協 理	張書省(註 3)	30,000	0	0	0
財會主管	黃盛宏	1,000	0	0	0

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

註 3：許鴻銘董事於 114 年 08 月 11 日辭任；李洪明資深協理於 114 年 06 月 30 日退休；簡木發資深協理與張書省協理於 114 年 11 月 30 日退休。

(2) 股權移轉資訊：

姓名(註 2)	股權移轉原因 (註 3)	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董 事、監察人及持股比例超 過百分之十股東之關係	股 數	交易 價格
志聖工業 (股)公司	贈與	114.07.15	躍演	無	36,000	不適用 (註 1)

註 1：係於櫃檯買賣市場向非特定人為之，交易價格均為市價，故不適用。

註 2：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。

註 3：係填列取得或處分。

(3) 股權質押資訊：股權質押之相對人無關係人者。

八. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

民國 115 年 3 月 22 日(停止過戶日)

姓名(註 1)	本人 持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱 或姓名及關係。		備 註
	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	名稱	關係	
志聖工業股份有 限公司 代表人：梁茂生	44,697,827	27.13%	—	—	—	—	無	無	
	0	0%	—	—	—	—			
均豪精密工業股 份有限公司庫藏 股專戶	3,668,000	2.23%					無	無	

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
兆銀託管日商麥克尼克司株式會社投資專戶	2,712,000	1.65%	—	—	—	—	無	無	
元大證券股份有限公司	898,003	0.55%	—	—	—	—	無	無	
陳政興	786,146	0.48%	173,000	0.11%	500,000	0.3%	無	無	
大通託管J P 摩根證券有限公司投資專戶	760,000	0.46%	—	—	—	—	無	無	
花旗託管柏克萊資本證券有限公司投資專戶	747,000	0.45%	—	—	—	—	無	無	
卓一郎	712,000	0.43%	—	—	—	—	無	無	
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶	564,000	0.34%	—	—	—	—	無	無	
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶	500,000	0.30%	—	—	—	—	無	無	

註：係本公司最近一次停止過戶日(115年3月22日)之股東名簿記載資料。

九. 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

民國 115 年 03 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Gallant-Rapid Corporation Limited	13,560,000	100	0	0	13,560,000	100
均碩國際股份有限公司	6,600,000	100	0	0	6,600,000	100
均華精密工業股份有限公司	16,342,750	57.81	283,000	1.00	16,625,750	58.81
芯聖科技股份有限公司	12,500,000	25.46	0	0	12,500,000	25.46

註1：係公司採用權益法之投資。

參. 募資情形

一. 資本及股份

(一) 股本來源

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註	其他
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)		
84.11	10	30,000	300,000	27,000	270,000	盈餘轉增資 170,224,800 元 現金增資 28,064,800 元	註一
85.11	10	68,000	680,000	42,255	422,550	盈餘轉增資 108,000,000 元 現金增資 27,000,000 元 資本公積轉增資 17,550,000 元	註二
86.08	10	68,000	680,000	52,210	522,098	盈餘轉增資 74,195,000 元 資本公積轉增資 25,353,000 元	註三
87.08	10	68,000	680,000	67,500	675,000	盈餘轉增資 152,902,000 元	註四
88.08	10	106,000	1,060,000	74,075	740,750	盈餘轉增資 65,750,000 元	註五
89.07	10	106,000	1,060,000	79,800	798,000	盈餘轉增資 57,250,000 元	註六
90.01	10	106,000	1,060,000	94,002	940,023	換股權利證書 142,022,460 元	註七
90.08	10	200,000	2,000,000	106,590	1,065,900	盈餘轉增資 125,877,540 元	註八
91.10	10	200,000	2,000,000	145,163	1,451,634	合併增資 385,733,940 元	註九
95.04	10	200,000	2,000,000	172,163	1,721,634	合併增資 270,000,000 元	註十
95.08	10	250,000	2,500,000	188,608	1,886,080	盈餘轉增資 164,445,720 元	註十一
96.03	10	250,000	2,500,000	208,608	2,086,080	私募現金增資 200,000,000 元	註十二
96.08	10	250,000	2,500,000	210,979	2,109,792	合併增資 23,712,030 元	註十三
96.09	10	250,000	2,500,000	227,260	2,272,602	盈餘轉增資 162,810,110 元	註十四
99.04	10	250,000	2,500,000	228,493	2,284,932	員工認股權轉換 12,330,000	註十五
99.07	10	250,000	2,500,000	228,501	2,285,012	員工認股權轉換 80,000 元	註十六
99.11	10	250,000	2,500,000	227,760	2,277,602	庫藏股減資 7,410,000 元	註十七
100.04	10	250,000	2,500,000	227,786	2,277,862	員工認股權轉換 260,000 元	註十八
100.09	10	250,000	2,500,000	182,229	1,822,289	現金減資 455,572,360 元	註十九
101.01	10	250,000	2,500,000	178,776	1,787,761	減資 34,528,000 元	註二十
102.04	10	250,000	2,500,000	173,776	1,737,761	庫藏股減資 50,000,000 元	註二十一
102.08	10	250,000	2,500,000	173,136	1,731,361	庫藏股減資 6,400,000 元	註二十二
104.02	10	250,000	2,500,000	170,136	1,701,361	庫藏股減資 30,000,000 元	註二十三
104.06	10	250,000	2,500,000	165,136	1,651,361	庫藏股減資 50,000,000 元	註二十四
114.06	10	250,000	2,500,000	164,497	1,644,966	庫藏股減資 6,395,000 元	註二十五
114.12	10	250,000	2,500,000	164,747	1,647,466	限制員工權利新股 2,500,000 元	註二十六

註一：經財政部證券管理委員會 84 年 7 月 13 日 (84) 台財證 (一) 第 39334 號函核准增資及補辦公開發行。

註二：經財政部證券管理委員會 85 年 7 月 3 日 (85) 台財證 (一) 第 41830 號函核准增資。

註三：經財政部證券暨期貨管理委員會 86 年 7 月 12 日 (86) 台財證 (一) 第 52638 號函核准增資。

註四：經財政部證券暨期貨管理委員會 87 年 6 月 8 日 (87) 台財證 (一) 第 49989 號函核准增資。

註五：經財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 7 月 8 日 (88) 台財證 (一) 第 62316 號函核准增資。

註六：經財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 5 月 31 日 (89) 台財證 (一) 第 47177 號函核准增資。

註七：89-1 換股權利證書換發普通股，並無財政部證券暨期貨管理委員會之核准函。

註八：經財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 6 月 12 日 (90) 台財證 (一) 第 137372 號函核准增資。

註九：經財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 8 月 27 日台財證一字第 0910146148 號函核准增資。

註十：經行政院金融監督管理委員會 95 年 1 月 17 日金管證一字第 0940161757 號函核准增資。

註十一：經行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 26 日金管證一字第 0950126381 號函核准增資。

註十二：經科學工業園區管理局 96 年 3 月 12 日園商字第 0960006417 號函核准增資登記，並於 100 年 6 月 10 日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000026692 號函核准補辦公開發行。

註十三：經科學工業園區管理局 96 年 8 月 30 日園商字第 0960023694 號函核准增資登記。

註十四：經科學工業園區管理局 96 年 9 月 29 日園商字第 0960026199 號函核准增資登記。

註十五：經科學工業園區管理局 99 年 4 月 15 日園商字第 0990009641 號函核准增資登記。

註十六：經科學工業園區管理局 99 年 7 月 15 日園商字第 0990020795 號函核准增資登記。

註十七：經科學工業園區管理局 99 年 11 月 15 日園商字第 0990033346 號函核准減資登記。

註十八：經科學工業園區管理局 100 年 4 月 19 日園商字第 1000010552 號函核准增資登記。

註十九：經科學工業園區管理局 100 年 9 月 02 日園商字第 1000026167 號函核准減資登記。

註二十：經科學工業園區管理局 101 年 1 月 02 日園商字第 1010000129 號函核准減資登記。

註二十一：經科學工業園區管理局 102 年 4 月 09 日園商字第 1020010022 號函核准減資登記。

註二十二：經科學工業園區管理局 102 年 8 月 29 日園商字第 1020026071 號函核准減資登記。
 註二十三：經科學工業園區管理局 104 年 2 月 6 日園商字第 1040003786 號函核准減資登記。
 註二十四：經科學工業園區管理局 104 年 6 月 29 日園商字第 1040022199 號函核准減資登記。
 註二十五：經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 114 年 6 月 6 日竹商字第 1140017529 號函核准減資登記。
 註二十六：經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 114 年 12 月 24 日竹商字第 1140041001 號函核准增資登記。

截至民國 115 年 3 月 31 日止；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
上櫃普通股	164,746,644	85,253,356	250,000,000	流通在外股份皆為上櫃股票

總括申報制度相關資訊：(不適用)

(二)主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

持股基準日：115 年 3 月 22 日

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例 (%)
志聖工業股份有限公司		44,697,827	27.13%
均豪精密工業股份有限公司庫藏股專戶		3,668,000	2.23%
兆銀託管日商麥克尼克司株式會社投資專戶		2,712,000	1.65%
元大證券股份有限公司		898,003	0.55%
陳政興		786,146	0.48%
大通託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶		760,000	0.46%
花旗託管柏克萊資本證券有限公司投資專戶		747,000	0.45%
卓一郎		712,000	0.43%
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶		564,000	0.34%
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶		500,000	0.30%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

公司章程第三十條之一：

本公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一且不高於百分之十二分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

前述員工酬勞中以不低於20%提撥為分派予基層員工之酬勞。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

公司章程第三十一條：

本公司當年度決算後如有盈餘，應依法繳納稅捐、彌補以往年度虧損，次提百分之十法定盈餘公積，惟法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時不在此限。另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘加計以往累積未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

股利分派時其中現金股利分配之比例以不低於股利總額百分之十。

公司章程第三十一條之一：

本公司董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部分以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司章程雖未明訂股東股利之分派比例，惟考量公司資金需求、長期財務規劃等因素，及兼顧股東利益，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分配之。

本公司股東股利之提撥，以發放現金股利且股利分配以不低於當年度本期稅後淨利之百分之十為原則。

本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司於民國一百一十五年二月二十六日董事會中通過之民國一百一十四年度盈餘分配案發放盈餘分配每股現金股利2.2元，總金額為354,373仟元，依相關規定辦理。

2.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無此情形。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：本年度無配發無償配股，故不適用。

(五)員工、董事酬勞：

1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

依公司章程第三十條之一規定：

本公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一且不高於百分之十二分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

前述員工酬勞中以不低於20%提撥為分派予基層員工之酬勞。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

2.本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本年度以當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損為基礎，依公司章程所定之成數範圍內，估列員工酬勞及董事酬勞，並列報為營業成本或營業費用，其中員工酬勞以股票發放者，係依董事會決議前一日之普通股收盤價計算配發股數。如上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

項目	董事會決議(民國 115 年 2 月 26 日)
	金額 (新台幣元)
董事酬勞(現金)	9,572,145
員工酬勞(現金)	37,544,770
合計	47,116,915

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：民國 114 年未以股票分派之員工酬勞，故不適用。

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

	實 際 發 放 數	估 計 數	差 異 數
董事酬勞(現金)	6,557,935	6,557,935	0
員工酬勞(現金)	22,682,647	22,682,647	0
合計	29,240,582	29,240,582	0

(六)公司買回本公司股份情形：

115 年 3 月 31 日

買 回 期 次	第 14 次(期)
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	113/11/08~113/12/27
買 回 區 間 價 格	114.16~133.69 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 3,668,000 股
已 買 回 股 份 金 額	新台幣 462,609 仟元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	85
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 0 股
累積持有本公司股份數量	普通股 3,668,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	2.23

二. 公司債辦理情形：無。

三. 特別股之辦理情形：無。

四. 海外存託憑證之辦理情形：無。

五. 員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：本公司未有尚未屆期之員工認股權憑證之情形，故不適用。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：不適用。

六. 限制員工權利新股辦理情形：

(一)凡尚未全數達既得條件之之限制員工權利新股應揭露至年報至刊印日止辦理情形及對股東權利之影響：

115年03月31日

限制員工權利新股種類	114年第一次 限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	114.10.23/1,000,000股
發行日期	114.12.15
已發行限制員工權利新股股數	250,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	750,000股
發行價格	無
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.15%
員工限制權利新股之既得條件	自給與日起算滿一年仍在 本公司任職者，既得100% 股份
員工限制權利新股之受限制權利	1. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2. 既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。 3. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 4. 未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。

員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	對於本公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	0股
已解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股之股數	250,000股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.15%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(二) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：

115年03月31日

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已解除限制權利			未解除限制權利				
					已解除限制之股數	認股價格	認股金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	認股價格	認股金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	董事長兼總經理	陳政興	250,000	0.15%	0	0	0	0	250,000	0	0	0.15%
	副董事長兼執行長	梁又文										

註1：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註2：已執行之員工認股權認股價格，應揭露執行時認股價格。

註3：未執行之員工認股權認股價格，應揭露依發行辦法計算調整後之認股價格。

七. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露下列事項：

1. 股票已在證券交易所上市之公司或股票已依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第三條或第三條之一規定，核准在證券商營業處所買賣之公司，應揭露最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。
2. 除前目規定之公司外，應揭露最近一季執行情況，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計劃：無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者之執行情形及基本資料：無。

八. 資金運用計畫執行情形應記載下列事項：

- (一)計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：無。
- (二)執行情形：就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫。前款之各次計畫內容如屬下列各目者，另應揭露下列事項：無。

肆. 營運概況

一. 業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務主要內容：

- CQ01010 模具製造業（限園區外經營）
- F106030 模具批發業（限園區外經營）
- F113010 機械批發業（限園區外經營）
- CC01080 電子零組件製造業（限園區外經營）
- F401010 國際貿易業
- CB01010 機械設備製造業
- CE01010 一般儀器製造業
- CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- CF01011 醫療器材製造業
- F208031 醫療器材零售業
- F108031 醫療器材批發業
- D101060 再生能源自用發電設備業
- E601010 電器承裝業
- E601020 電器安裝業
- EZ05010 儀器、儀表安裝工程業

研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：

- (1) IC 封裝前段設備(IC Packaging Front-end Equipment)：IC 黏晶機(IC Bonding Machine)、IC 鐳線機 (IC Wire Bonder)
- (2) 覆晶接合製程設備(Flip Chip Process Equipment)：覆晶接合機(Flip Chip Bonder)、塗膠機(Glue Spreading Machine)、晶粒選別機(Die Sorter)
- (3) 半導體封裝製程及檢測設備(Semiconductor Packaging Process and Testing Equipment)
- (4) 半導體失效分析測試設備(Semiconductor Failure Analysis Testing Equipment)
- (5) 平面顯示器製程及檢測設備(FPD Processing and Testing Equipment)
- (6) 智慧製造解決方案及設備(Intelligent Total Solutions and Equipment)
- (7) 兼營與本公司產品業務相關之進出口貿易業務

2. 公司所營產品之營業比重如下：（民國 114 年度）

產 品	營業比重 (%)
顯示器製程設備	10.20%
半導體製程設備	78.83%
智能自動化設備	0.16%
其他	10.81%
合計	100.00%

3. 目前之商品（服務）項目

(1) 半導體製程設備(Semiconductor Process Equipment)：

A.精密加工及相關精密模具(Precision Machining and Precision Mold)

- (A)沖切成型機(Trim / Form System)
- (B)自動封膠機 (Auto Molding System)
- (C) FPC Trim / Form 沖切成型機(Trim / Form System)
- (D)基板沖孔成型機(IC Substrate Punch System)
- (E)自動封膠機用模具(Mold for Auto Sealing Machine)
- (F)沖切成型機用模具與精密元件(Die Set /kit for Trim / Form System)
- (G)全自動板材模壓機(Fully Auto Panel Molding System)
- (H)覆晶凸塊壓平設備(FC Bump Coin Lamination Equipment)

B.精密取放(Precision Pick and Place)

- (A)Consumer/Driver IC 晶粒挑檢機(Grain Pick / Place Machine)
- (B)IC 黏晶機(IC Bonding Machine)
- (C)IC 晶粒多面檢查挑檢機(IC Die Multi-face Inspection and Sorting Machine)
- (D)散熱片上蓋機(Heat Sink Covering Machine)

C.光電雷射(Laser)

- (A)雷射刻印機(Laser Marking Machine)

D.量測/檢測設備(Semiconductor Inspection Equipment)

- (A)晶圓表面瑕疵檢查機 (Wafer Surface Defect Inspection machine)
- (B)晶圓三維形貌及關鍵尺寸白光干涉量測系統 (White Light Interference Measurement System for Wafer 3D Topography and Size)

E. 精密研磨(Precision Grinding)

- (A)載板研磨機(Substrate Grinder)
- (B) Strip 研磨機(Strip Grinder)
- (C) Panel 研磨機(Panel Grinder)

F.濕式化學製程(Wet Chemical Process)

- (A)Batch 式蝕刻機(Batch Etcher)
- (B)Batch 式剝膜機(Batch Striper)
- (C)Batch 式顯影機(Batch Developer)
- (D)Batch 式清洗機(Batch Cleaner)

G. 半導體失效分析測試設備 (Semiconductor Failure Analysis Testing Equipment):

- (A).高敏度皮秒 IC 分析儀器設備(Picosecond Image for Circuit Analysis Equipment)

(2) 平面顯示器製程設備 TFT-LCD / OLED / Flexible OLED Equipments:

A. Array 製程設備

- TEG Prober
- Array Tester

- Array Cleaner
- Array Wet etching
- B. Cell 製程設備
 - Edge Grinding Machine
 - Cell Tester
 - Polarizer Attachment machine
 - In- process Cleaner
 - 薄化玻璃表面缺陷檢查設備(Glasses Thinner Process Defect Inspection Machine)
- C. Inspection 製程設備
 - Panel Surface Inspection
 - Burr Checker System
- D. Automation 設備
 - G4.5 / G5 / G6 / G7.5 / G8.5/G10.5 Cassette Station
 - Loader / Unloader & Automation for Cell Area
 - Dense Packer / Unpacker C/V, Buffer etc.
 - Automation for Production Line

(3) 智能製造解決方案及設備(Intelligent Manufacture Total Solutions and Equipment)

- A. 智慧物流系統(Intelligent Logistics System)
- B. 製程自動化設備(Process Automation Equipment)
- C. 太陽能電池自動取放系統 Solar Cell Automation Handling System
- D. 鋰鐵電池蕊封焊、疊片設備(Lithium Iron Battery Core Seal Welding and Lamination Device)
- E. 智慧診斷與預防維護系統(Intelligent Diagnosis and Preventive Maintenance System)
- F. 機器人搬運/加工系統(Robot Handling and Machining System)
- G. 智慧工廠整合服務(Intelligent Factory Integration Service)

4. 計劃開發之新產品(服務)

本集團未來計畫研發之新產品(服務)：

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	● Co-Packaged Optics Test Equipment Development (共同封裝光學測試機台開發)
	● Panel Polisher (基板拋光設備)
	● Development of Digital Twin for Process Equipment (製程設備數位孿生開發)

	● Panel to Wafer Chip Sorter with 6S AOI (方板至圓板晶粒外觀檢查挑揀機)
	● CPO Chip Sorter (矽光子元件挑揀機)
	● Hybrid Die Bonder (3D IC 黏晶機)
	● Chip Sorter with 6S AOI for Probe Tester inline (與電性測試設備串接之外觀檢查挑揀機)
	● CPO Module Sorter (共封光學元件挑揀機)
	● High-Precision Die Bonder (Face Up) (高精度盲打固晶機)
	● Ultra High-Precision Die Shift Measurement Machine for 1um Die Bonder (1um 固晶量測應用之 IR 固晶精度量測機)
	● Sorter with High Resolution 6S Inspection (高精度六面外觀檢查機)
	● Thermo-Compression Die Bonder (熱壓合黏晶機)

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展：本公司為電子產業之製程、檢測及自動化設備製造商，2026 年主要仍將以半導體設備產業、FPD 設備產業及智能自動化產業為主，產業之現況與發展說明如下：

(1) 半導體設備產業

根據世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 預測，2025 年全球半導體產值預計將達 7,720 億美元，年成長 22.5%；展望 2026 年將成長至 9,750 億美元，年成長 26.3%，反映市場強勁表現。

在人工智慧 (AI) 應用加速滲透及終端產品換機需求的雙重驅動下，臺灣半導體產業迎來強勁成長，受惠於 AI 資料中心、邊緣運算及供應鏈積極備貨需求，預測 2025 年台灣半導體產業產值預計將達新臺幣 6.5 兆元，年成長 22%；動能延續，2026 年產值預計達新臺幣 7.1 兆元，年成長 10%，持續創新高。

根據全球市場研究機構 TrendForce 2026 年十大科技趨勢，指出半導體 2nm GAAFET 量產與 2.5D/3D 封裝的異質整合引領下世代突破，隨著 2nm 進入量產，在先進製程商業競逐中，形成了向內追求更高電晶體密度、向外追求更大封裝尺寸的趨勢，同時強調異質整合 (Heterogeneous Integration) 能力，透過不同功能的多晶片堆疊與

不同技術節點的結合，滿足高效能運算與人工智慧應用需求。在追求更高電晶體密度的部分，半導體晶圓製造正式由 FinFET 轉進 GAAFET，透過 Gate-Oxide 完整包覆矽通道，在追逐高強度算力同時實現更高效的電流控制。向外部分，2.5D 與 3D 封裝技術提供多重晶片堆疊的高密度封裝解決方案，使晶片間互連更快速、功耗更低，為下一代資料中心及高性能運算領域帶來突破。隨著各家 2nm GAAFET 進入量產，台積電、Intel 與 Samsung 則分別推出 CoWoS/SoIC、EMIB/FOVEROS、I-Cube/X-Cube 等 2.5D/3D 封裝技術，提供前後段整合代工服務。如何在產能利用率、可靠性、成本與良率間取得平衡與商業優勢，將是各大晶圓代工與封裝廠的核心挑戰。

TrendForce 觀察先進封裝 CoWoS 市場發展態勢，AI HPC (高效能運算) 對異質整合的需求仰賴先進封裝達成，其中的關鍵技術即是台積電的 CoWoS 解決方案。CoWoS 方案將主運算邏輯晶片、記憶體、I/O 等不同功能的晶片，以中介層 (Interposer) 方式連結，並固定在基板上，目前已發展出 CoWoS-S、CoWoS-R 與 CoWoS-L 等技術。隨著 NVIDIA Blackwell 平台 2025 年進入規模量產，目前市場需求已高度傾向內嵌矽中介層的 CoWoS-L，NVIDIA 下世代的 Rubin 亦將採用。

AI 與高效能運算 (HPC) 應用需求不斷攀升，台灣半導體設備產業正快速成長。國際半導體產業協會 (SEMI) 估計，在 AI 算力、資料中心及智慧駕駛的強勁需求驅動下，2025 年全球半導體設備銷售額預計達 1330 億美元，較去年同期成長 13.7%，刷新歷史紀錄。2026 年市場成長動能聚焦兩大領域。一是作為 AI 算力基石的 GPU，該領域持續高速擴張，2026 年全球 AI 晶片資本開支預期上調；二是記憶體晶片，AI 應用爆發式成長拉動記憶體需求激增，單顆 GPU 搭載的 HBM、DRAM 及 SSD 容量已超越晶片本身價值，記憶體佔 AI 資本開支比重顯著提升。

台積電的先進封裝技術正朝向多元化發展，除了 CoWoS 的強勁需求，SoIC (System-on-Integrated-Chips) 技術已獲得 AMD MI300 等產品應用，NVIDIA、Broadcom 預計在 2027 年後導入。此外，蘋果的 A20 晶片預計將導入 WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module)，用於 iPhone 18/ 摺疊手機。台積電的先進封裝廠區廣泛分布，包括龍潭 (AP3)、台中 (AP5)、竹南 (AP6)、嘉義 (AP7)、

台南 (AP8) 等。其中，AP8 的擴產加速主要用於滿足 CoWoS-L 的需求，而嘉義的 AP7 則專注於 SoIC 和 WMCM。在美國亞利桑那州 (Arizona) 的 AP9 和 AP10 廠區，未來規劃亦將包含 CoWoS、SoIC 及 CoPoS 技術。台積電引領 CoWoS 產能躍升，本公司留意相關設備需求，掌握相關商機。

美國「川普政府」以「對等關稅」為策略，促使台灣半導體與伺服器業者積極赴美設廠。這股趨勢不僅改變產業分布，也將為半導體設備製造商帶來外銷契機。國際半導體產業協會 (SEMI) 報告指出，2025 年美國將啟動 18 座新晶圓廠建設計畫，其中多為 300 mm 先進製程，預計 2026 - 2027 年投產。GlobalNewsWire 預估全球半導體製造設備市場於 2024 年估值 935 億美元，預計 2033 年增至 2,244 億美元，年複合成長率 (CAGR) 為 10.3%。HBM、CoWoS 等高階封裝技術對台灣設備廠是機會，台灣設備廠具有成本與技術相對優勢，可競逐這波設備需求浪潮，本公司留意相關設備需求，掌握相關商機。

台積電赴美設廠是全球半導體供應鏈重組的重要事件，原因包括地緣政治壓力及供應鏈風險分散。台積電在亞利桑那州陸續投資先進製程與先進封裝半導體廠，此舉將使美國成為全球先進製程的重要據點，改變過去以亞洲為核心的產業分布。台積電赴美設廠將帶動整體供應鏈西移，設備、材料、零組件廠商需跟進設立當地服務據點，以滿足即時支援需求。對台灣設備商而言，這是重大機會：美國廠區採用先進製程，對高精度設備、檢測儀器、封裝技術需求強烈，尤其 EUV 曝光機、先進封裝 (CoWoS、InFO)、HBM 測試設備等領域。台灣設備商具備成本優勢、技術成熟度，若能克服跨國營運挑戰 (法規、物流、人才)，有望取得更多訂單，本公司留意相關設備需求，掌握相關商機。

(2) FPD 設備產業

經濟部產業技術司指出，Micro LED 為全球顯示領域重點發展項目近年來全球顯示領域的熱門發展項目，Micro LED 從 2000 年初發展至今，在經多年發展後，在面板的基本性質，如尺寸和解析度等，都已跟現有技術 (如 OLED、TFT-LCD 等) 達到相近的規格，但因其技術本身的特性 (LED 直接顯示，非背光模組)，將可在如亮度、對比、能耗、輕薄、耐候性等顯示效能上有更好的呈現，但目前因各段製程皆在發展之中，仍有不成熟之處，面板製造成本仍高，故

商業化的進展緩慢。整個 Micro LED 的製程大致可分為 Micro LED 晶片製作、巨量轉移至基板、檢測/修補、全彩化、封裝/模組等。巨量轉移被視為是 Micro LED 實現量產的關鍵技術，也是影響製程良率的重要因素，已有多家廠商投入開發，主要會分成 Stamp Transfer、Laser Transfer 兩種模式，目前多數廠商選擇 Stamp 的方式，藉由壓印頭在晶片上施壓，利用凡得瓦力讓晶片附著在壓印頭上後，移至基板的特定位置後，壓印頭連同晶片壓向基板，使晶片插入背板接觸墊即完成轉移，此技術相對成熟，設備成本較低，但 Stamp 轉移的效率還是太慢。

工研院產業科技國際策略發展所指出，Micro LED 目前各段製程皆持續發展之中，面板製造成本仍高，未來若要成功推進成本下降，晶片、巨量轉移設備製程、背板技術的發展可說是至關重要，目前各段製程皆持續在進步發展之中。臺灣已是為全球 Micro LED 發展重鎮，尤其是藉由友達、群創、富采、銓創建立的 Micro LED Ecosystem 共同推動，日前甫上市的全球第一款 Micro LED 智慧手錶，代表終於 Micro LED 進入消費電子市場機會出現，而走入手錶可能只是開始，為了向市場推廣這個技術並演練從研發走向量產的能力，最終目標則是為了“上車”，因為車載應用毛利率更高規模也更大，也是當前臺灣顯示產業發展的重中之重。

根據全球市場研究機構 TrendForce 2026 年十大科技趨勢，指出 OLED 顯示迎來跨世代的轉折時刻。中、韓面板廠的高世代(8.6代) AMOLED 產線持續擴產，隨著成本結構與良率持續改善，OLED 顯示技術正加速覆蓋從小到大的全尺寸產品，同步帶動相關供應鏈如驅動 IC、TCON、觸控模組與散熱設計等高階零組件平均單價(ASP)與供應商議價能力。OLED 以自發光、高對比、輕薄化與可變刷新率等特性，突破 LCD 在厚度與能耗的物理瓶頸，符合 Apple 對影像精度與能源效率的雙重要求。Apple 預計 2026 年正式將 OLED 面板導入 MacBook Pro，將帶動高階筆電顯示規格由 mini-LED 轉向 OLED，預估 2025 年 OLED 筆電滲透率可望來到 5%，2026 年之後，在 Apple 帶動下，2027 - 2028 年可望提升至 9 - 12%。另外，隨著 Apple 有機會於 2026 下半年至 2027 年間正式進入折疊手機市場，將以軟硬整合、品牌信任與供應鏈協同優勢重新定義折疊手機價值，推動市場焦點由「外觀炫技」轉向「生產力與體驗深化」，預估將帶動全球折疊手機出貨量於 2027 年突破 3,000 萬支。目前折疊手機仍面臨邁向主流的最後障礙—鉸鏈可靠度、柔性面板封裝、良率與成

本控制。Apple 對產品驗證與品質的謹慎，反映其對進場時機與使用體驗的重視，也凸顯折疊手機要真正跨入成熟期，仍需時間與實力跨越鴻溝。

經濟部產業技術司指出，臺灣面板廠因在 AMOLED 投資相對保守，無法與中韓進行產能競爭，轉而將技術的發展聚焦在 Micro LED 技術上，目前 Micro LED 技術臺廠仍有領先性，尤其是磊晶、玻璃基板、巨量轉移、全彩化等，例如三星電子 Micro LED TV 關鍵的晶片和玻璃基板就分別來自鐸創和友達，友達也將率先量產智慧手錶面板，未來的觀察重點還是如何藉由提升轉移速度、晶片有效微縮化等技術，使得生產成本得以有效下降。對臺灣面板廠而言，AMOLED 的資本額巨大，如建置一條 6 代的生產線，就需要 2,000 億新臺幣左右，而 Micro LED 因前段製程，例如 TFT 玻璃基板，與現有的 TFT-LCD 製程有極高的關聯性，其他製程也與臺灣的強項，半導體產業中有所相似，故因此投資金額將不至於太大，很適合臺灣顯示產業發展的現狀，再換個角度想，臺灣的優勢也許就是沒有 OLED 的包袱，例如雖然中國大陸顯示產業資金雄厚，但已在 OLED 投入很多資源，當下中韓正於 OLED 強烈競爭，故強化 Micro LED 發展，將是本公司未來一大機會所在。

(3) 智能自動化產業

因應全球少量多樣的生產趨勢、全球供應鏈重組及減碳需求下，為提升產業競爭優勢並接軌國際，全球製造業開始加速採用各種 ICT 技術，推動智慧化和自動化，以更好地管理產線、產品和品質。在這一趨勢中，AI 技術成為備受關注的議題。通過 AI，企業可以優化生產、降低能耗，推動工廠綠色能源轉型，並穩定產能規劃，靈活應對供應鏈變化，快速評估交貨期。工業占全球能源的最大量使用，同時也是碳排放的主要來源之一，隨著生產線效率的提升，停機和重工機會減少，自然而然實現了節能減碳的目標。

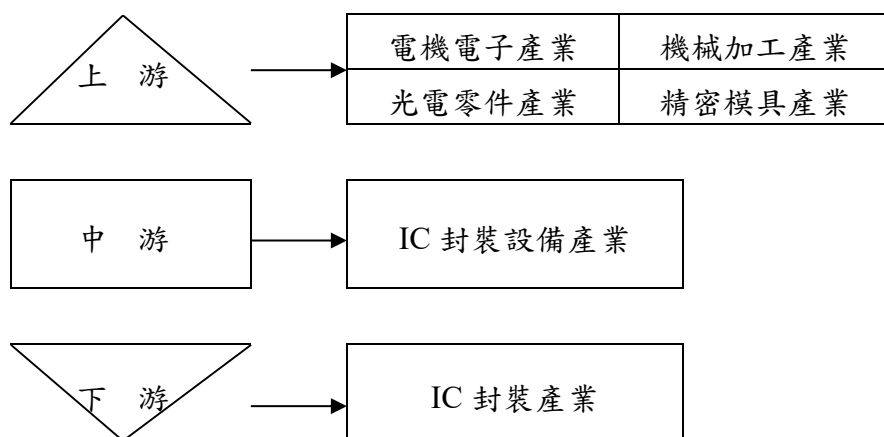
因應全球供應鏈重組、生產基地遷移趨勢，製造業需借助雲端服務、資安防護及遠距協同工程以快速進行海外產線建置，以及對應的生產管理、自動化系統、製程規劃、製程診斷軟體系統安裝調適，達成高效率數位製造暨營運管理，而這些海外產線建置及軟體系統安裝調適，包括開發產線智慧化系統技術，透過組合式智慧製造服務平台、沉浸式遠距協同工程與零信任資安防護等技術。

面對 AI 浪潮來襲，AI 將成為 2030 年改變產業發展的關鍵推手，加上當前 Chat GPT 爆發式的商業應用，面對疫後缺工與專精人力斷層問題，應著重應用生成式人工智慧(Generative AI, GAI)，協助企業降低人力成本並改善生產效率，促使智慧機械產業 AI 化再創新興的藍海價值，將是本公司未來一大機會所在。

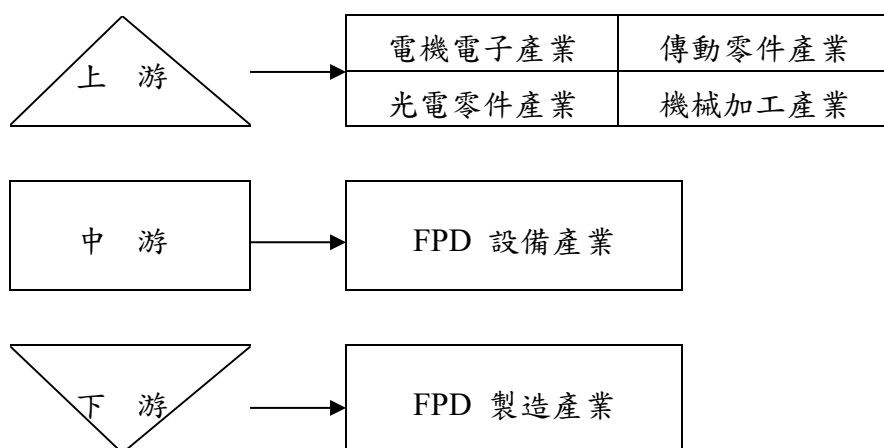
根據全球市場研究機構 TrendForce 2026 年十大科技趨勢，指出 2026 年人型機器人出貨成長逾 700%，聚焦 AI 自適應與場景應用性。2026 年將是人型機器人邁向商用化的關鍵一年，全球出貨量預估年增逾七倍、突破 5 萬台，市場動能聚焦於兩大主軸：AI 自適應 (AI Adaptivity) 技術與場景應用導向。AI 自適應技術結合高效 AI 晶片、感測融合與大型語言模型 (LLM) 的進化，使機器人能在非結構化環境中即時學習與動態決策，展現「謀定而後動」的行為能力。於此背景下，2026 年的人型機器人新品將不再以規格或靈活度為唯一賣點，而是自設計階段即鎖定特定場景價值，從預期最早切入之製造搬運、倉儲分揀到檢測輔助等，皆能支援場域完整任務。2026 年將是人型機器人正式進入以 AI 為驅動、以應用為核心之產業新階段。在半導體製造業場景應用，將是本公司未來機會所在。

2. 產業上、中、下游之關聯性

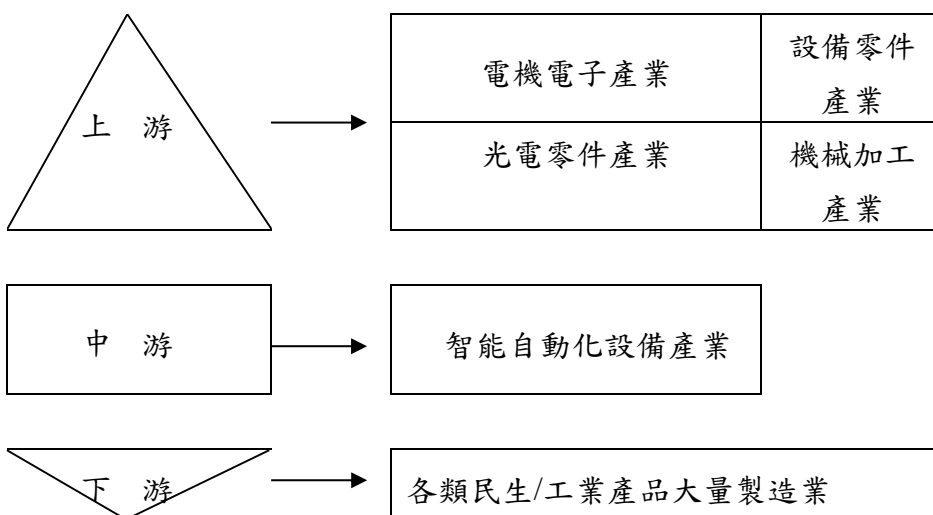
(1) 半導體 IC 封裝設備產業



(2) FPD 設備產業



(3) 智能自動化設備產業



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 半導體設備產業

依據 DIGITIMES Research 預估，2025 年全球晶圓代工營收將達 1,994 億美元，年增逾 25%；展望 2026 年，全球營收可望持續受惠於 AI 應用擴大，將再成長 17%，突破 2,300 億美元；至 2030 年，全球晶圓代工營收將挑戰 3,900 億美元。因應 AI 晶片需求暢旺，未來 5 年晶圓代工廠將大舉擴建先進製程產能，成熟製程投資則來自中國政策因素驅動。AI 應用雖帶動晶圓代工產業加速發展，然而，

AI 基礎建設投資有泡沫隱憂，加上地緣政治風險未解除，產業發展雖然可期，但仍面臨諸多挑戰。

晶圓代工 2 奈米製程之爭於 2025 年開打。台積電 2 奈米 (N2) 製程技術如期於 2025 年第四季開始量產，首度採用奈米片 (Nanosheet) 電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求，2026 年起，包含蘋果 (Apple)、高通 (Qualcomm)、聯發科、博通 (Broadcom)、NVIDIA 等，皆將採用台積電 N2 製程。在 2 奈米製程，英特爾 (Intel) 和三星電子 (Samsung Electronics) 正急起直追，英特爾已於 2025 年底前交付首批 18A 產品，而首個採用 Intel 18A 製程為自家的 Panther Lake CPU，但仍待外部客戶驗證；三星在 2025 年第 3 季財報會議上指出，第一代 2 奈米 GAA 製程已量產，而第二代 2 奈米 GAA 製程研發，正按計畫進行，規劃 2026 年進入量產，預計透過 2 奈米和 4 奈米 GAA 製程，擴大高效能運算和行動應用訂單。

先進製程競賽延續 台積電、三星將穩步推進 英特爾與Rapidus仍待市場驗證

2025~2030年主要晶圓代工業者先進製程藍圖

業者	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
台積電	N3P/N3X	N3A					
	N2	N2P/N2X/A16		A14	A14P(暫名)		
三星電子	SF3						
	SF2	SF2P/SF2X	SF2A/SF2Z				
英特爾	Intel 3T/Intel 3-E		SF1.4	遞延 →		SF1.4	SF1.4P(暫名)
	Intel 18A	Intel 18A-P		Intel 18AP-T			
Rapidus			2nm				
中芯國際	持續推動7奈米以下先進製程技術開發						

7 資料來源：各業者、DIGITIMES · 2025/11

DIGITIMES

2025~2030 年主要晶圓代工業者先進製程藍圖

(資料來源：DIGITIMES Research，2025/11)

DIGITIMES 預估，2025 年底台積電 CoWoS 月產能將達 7.5 萬片，較 2024 年底倍增。DIGITIMES 供應鏈調查顯示，在 AI 晶片對 CoWoS 產能需求持續強勁下，台積電已上修 2026 年 CoWoS 產能規模，2026 年底月產能將由原預估的 9 萬片上修至 11 萬片。台積電 2026 年雖已排定擴產計畫，但 CoWoS 產能仍供不應求。

CoWoS 是 AI 與高效能運算時代的核心封裝技術，市場需求爆發，技術門檻高，均豪在精密設備與自動化檢測領域具備優勢，深耕檢量磨拋四大核心技術，將是本公司未來一大機會所在。

依據 DIGITIMES Research 預估，先進封裝技術成為晶圓代工產業新高機布局重點，晶圓代工業者僅台積電與三星電子有布局扇外型(Fanout)封裝技術。晶圓代工業者量產扇外型晶圓級封裝(Fan Out Wafer Level Package；FOWLP)技術僅有台積電，目前僅蘋果(Apple)手機應用處理器採用。三星電子為首個布局扇外型面板級封裝(Fan Out Panel Level Package；FOPLP)的晶圓代工業者，三星智慧手錶應用處理器即採用 FOPLP 封裝技術。

先進封裝技術		台積電	三星電子	英特爾	聯電	力積電	格羅方德
Fan Out	FOWLP	●	●				
	FOPLP	●	●				
2.5D	RDL	●	●				
	Si Interposer	●	●				
	Si Bridge Chip	●	●	●			
3D	TSV+μbump	●	●	●			
	Hybrid bonding	●	●	●	●	●	●
Co-Packaged Optical		●	●	●			

主要晶圓代工業者先進封裝布局概況

(資料來源：DIGITIMES Research，2024/9)

2.5D 封裝部分，台積電、三星與英特爾布局略有差異，其中，英特爾僅布局矽橋(Si bridge)方案，台積電與三星則有重布線層(Redistributed Layer；RDL)方案及矽中介層(Si Interposer)方案。現行主流雲端高階 GPU 加速器主要採用台積電 CoWoS-S 製程，未來將會轉向 CoWoS-L。

3D 混合鍵合為晶圓代工產業重點布局 3D 封裝技術。台積電 SoIC-X、三星 X-Cube (Hybrid Copper Bonding；HCB)及英特爾 Foveros Direct 皆為混合鍵合技術。

超微(AMD)為首家採用台積電 SoIC-X 技術的 HPC 晶片業者。聯電、力積電與格羅方德皆有布局混合鍵合技術。聯電推出晶圓對晶圓(Wafer to Wafer；W2W)混合鍵合技術，運用於通訊射頻元件整

合。在 55 奈米 RFSOI 製程平台上使用矽堆疊技術，在不損耗射頻效能下，可將晶片尺寸縮小 45% 以上，更有效率整合更多射頻元件，以滿足 5G 更大的頻寬需求。力積電開發以邏輯晶片與記憶體進行垂直堆疊的 W2W 技術，亦採用混合鍵合技術。

共同封裝光學 (Co-Package Optical; CPO) 成為台積電、三星與英特爾在晶圓代工產業競爭的重要布局策略。HPC 晶片因應性能提升需要更快的傳輸速率，將從銅線路轉向光路，以光子取代電子進行傳輸，需要將光子引擎 (optical engine) 與運算模組進行整合。CPO 需要高精度的光電對位、散熱管理、先進封裝 (如 Chiplet 整合、矽光技術)，這正是均豪在半導體設備與精密製程的強項，將是本公司未來一大機會所在。

為增加資源循環效益，讓報廢晶圓回收再製封裝材料，台積電資材供應鏈管理組織聯合先進封裝技術委員會，於 2024 年攜手供應商共同投入前段製程報廢晶圓的回收再生研究，並開發出一套嚴謹的篩選、研磨、洗淨與檢驗流程，確保回收晶圓品質符合 CoWoS 技術使用的 Dummy Die 製作規格，達到資源永續利用與綠色創新的雙重目標，估計 1 年可減碳 1 萬 205 公噸，創造新台幣 7.46 億元綠色效益。台積電未來將持續致力擴大資源循環的應用範疇，除於 CoWoS 技術中實現回收晶圓再利用，亦評估將其應用於整合型扇出 (InFO) 封裝技術中的 Dummy Die 製作，積極實踐「廢棄物產出最小化、資源循環使用最大化、廠商管理最優化」的永續目標。製程報廢晶圓的回收再生研究，將是本公司未來一大機會所在。

(2) FPD 設備產業

工研院產業科技國際策略發展所指出，Micro LED 面板預估於 2026 年進入車載應用市場，出貨量預估逐年大幅成長，2029 年可達 40 萬片。隨著 Micro LED 成本之下降，預期車載市場將會是 Micro LED 很大的應用領域。Micro LED 之低功耗特性，對於電動車廠極具吸引力高穿透性之透明顯示特性也是目前車載應用中最具優勢之技術，一旦達成具量產效益之製程開發，未來應用成長將不容小覷。車載面板為各應用面板中，成長性最高之應用市場，預估 2026 年車載面板產值將突破百億美元。

Micro LED 顯示技術之優異特性，在亮度、色域、反應時間及

壽命方面較 OLED 更勝一籌，可望在車載顯示、透明顯示及穿戴裝置等高成長性利基市場，成為主流之應用技術。然而良率低、成本高為 Micro LED 商業化量產進程需要持續克服之挑戰。Epitaxy 製程和 LED 晶片製程、巨量轉移、全彩顯示和顯示驅動，對於 Micro LED 產業化成本及應用產品可靠度之影響至為關鍵。檢測修補為提升良率之必要手段，設備廠商透過人工智慧之高速算力，以加速 Micro LED 之量產進程，克服目前在良率提升之瓶頸。

Micro LED 顯示技術在車載應用市場受到矚目期待的一項為高穿透性之透明顯示智慧車窗應用，因此 Micro LED 可說是最適合用於透明顯示的技術。透明顯示為高度成長之應用市場，預估 2022~2026 年市場規模之年複合成長率可達 29%。透明顯示應用範圍從原本的零售資訊看板，朝向智慧移動、智慧建材、智慧居家等發展。同時加入更多互動功能，朝向虛實融合場景應用，更為多元化及生活化。目前的商用戶外看板以 LED 技術為主，但解析度低，觀看效果不佳。目前高階的透明顯示以 OLED 技術為主流。但 OLED 之透明度小於 50%，仍不及 Micro LED 之 60% 以上的穿透度。但仍回歸到 Micro LED 之成本與量產問題。台灣業者協力加速整合產業能量，從面板、材料到設備，推動完整產業鏈之建立，使台灣成為全球 Micro LED 產業重要基地。面對顯示品質要求愈來愈高的終端市場，面板廠商仍然持續不斷地加緊腳步投入。

Micro LED 技術面臨的挑戰需要整個產業鏈的共同努力來克服，隨著技術的不斷進步，Micro LED 有望在未來幾年內實現更廣泛的應用。人工智慧 (AI) 高速算力技術的崛起加速 Micro LED 之量產進程，克服目前在良率提升之瓶頸。AI 技術目前在 Micro LED 之應用主要為檢測項目，聚焦於提升檢測效率、精準度及自動化程度。由於 Micro LED 晶片尺寸極小，製造過程複雜繁瑣，運用 AI 技術以有效提升產品品質和生產效率。AI 技術在 Micro LED 產業的應用，主要解決在晶片製造過程及巨量轉移過程中所存在的傳統檢測方法之品質穩定性、均勻性及效率的問題，此項新的解決方案，將可望推動 Micro LED 技術的發展和應用。隨著 AI 和機器學習技術的大幅進步，預計未來在 Micro LED 製造和檢測中的應用將更加廣泛和深入。

面板大廠友達光電在 CES 2026 以「Together, We Drive The New Era」為主題，展現 Micro LED 技術的多元應用與創新潛力，從智慧座艙到商業展示，再到穿戴裝置，皆體現其在顯示技術領域的領

先地位。友達將 Micro LED 引入車載顯示，更延伸至商業展示、運動場域及穿戴裝置，展現其多元應用與市場潛力。智慧座艙中的 Micro LED 創新，友達推出全球首款 Aero Module 透明 Micro LED 顯示模組，具備 50% 透明度與高達 3000 nits 的亮度，支援多模組拼接與動態部署，打造沉浸式車艙體驗。結合抗反光技術 ART，提升強光下的顯示清晰度，確保駕駛安全。Micro LED 技術也被應用於大型透明顯示看板，如 54 吋 Transparent Micro LED Signage，適合車展與旗艦店，營造科技氛圍。運動場域則有 64 吋 Sports AR Solution，結合 AR 技術，讓觀眾即時查看比賽數據與球員資訊。另有 30 吋 Interactive AR Box，提供非接觸式商品展示，以及 42 吋 Multilingual AI Ordering System，支援多語言互動，提升商業場景的便利性。Micro LED 應用於 AR 穿戴裝置，推出超小型光導引顯示模組，亮度高達 350,000 nits，解析度 720×720，重量僅 0.21 克，功耗低至 200 mW，適用於下一代 AR 眼鏡，兼具高亮度與低能耗。

(3) 智能自動化設備產業

根據國際研調機構 Industryresearch 預測，2026 年全球智慧製造（Smart Manufacturing）市場規模 2,600 億美元，2026 - 2035 年 CAGR 為 9.9%。IDC 預測 2026 年起，超過 40% 的生產排程系統將導入 AI，至 2029 年將有 30% 工廠採用「軟體定義工廠」架構。AI 將跨越輔助角色，進入主動操控制造流程的階段，成為智慧工廠的「代理人」，能即時調整產線、排程與庫存。透過數位孿生模擬生產場景，包括流程、維護和佈局優化，可在實廠未動手前測試策略，降低風險與停機率。AI 化的製程自動化、IIoT、數位孿生、協作機器與永續導向，正共同推動工業體系的下一波轉型。

因應全球少量多樣的生產趨勢、全球供應鏈重組及減碳需求下，為提升產業競爭優勢並接軌國際，全球製造業開始加速採用各種 ICT 技術，推動智慧化和自動化，以更好地管理產線、產品和品質。在這一趨勢中，AI 技術成為備受關注的議題。通過 AI，企業可以優化生產、降低能耗，推動工廠綠色能源轉型，並穩定產能規劃，靈活應對供應鏈變化，快速評估交貨期。工業占全球能源的最大量使用，同時也是碳排放的主要來源之一，隨著生產線效率的提升，停機和重工機會減少，自然而然實現了節能減碳的目標。

因應全球供應鏈重組、生產基地遷移趨勢，製造業需借助雲端服務、資安防護及遠距協同工程以快速進行海外產線建置，以及對

應的生產管理、自動化系統、製程規劃、製程診斷軟體系統安裝調適，達成高效率數位製造暨營運管理，而這些海外產線建置及軟體系統安裝調適，包括開發產線智慧化系統技術，透過組合式智慧製造服務平台、沉浸式遠距協同工程與零信任資安防護等技術。

面對 AI 浪潮來襲，AI 將成為 2030 年改變產業發展的關鍵推手，加上當前 Chat GPT 爆發式的商業應用，面對疫後缺工與專精人力斷層問題，應著重應用生成式人工智慧(Generative AI, GAI)，協助企業降低人力成本並改善生產效率，促使智慧機械產業 AI 化再創新的藍海價值，將是本公司未來一大機會所在。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止之研發費用

單位：新台幣千元

年度	民國 114 年度	民國 115 年度 3 月 31 日
研發費用	427,642	88,675
占營業淨額之比例	9.16%	8.62%

2.本集團最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術及產品

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	● High Speed 3D Metrology for Advanced Package (先進封裝高速 3D 形貌量測機)
	● Glass Substrate Grinder (玻璃基板研磨設備)
	● Intelligent Quality Prediction System for Grinder Process Control(研磨品質智慧預測系統)
	● Die Bonder with Laser Assisted (晶片雷射接合機)
	● Panel Level Face Down Die Bonder (面板級面朝下黏晶機)
	● High Accuracy & Cleanliness Chip Sorter 高精度&高潔淨晶片挑檢機
	● Wafer to Wafer Chip Sorter with STLP (具多料盒晶圓至晶圓挑檢機)
	● Wafer to Wafer Chip Sorter with 6S AOI for Large Die (大晶片晶粒外觀檢查挑揀機)
	● High-Precision Die Shift Measurement Machine for 3um Die Bond (3um 固晶量測應用之 IR 固晶精度量測機)
● High-Precision Die Bonder (Face Down) (高精度覆晶固晶機)	

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期計畫

- (1) 精進暨有半導體領域之產品性能，以深化產品線及擴大客戶群。
- (2) 透過技術引進/合作，配合夥伴客戶需求，強力切入高附加價值之半導體前段先進檢測技術開發、及中後段封裝製程之檢測與研磨等製程設備。
- (3) 配合國外技術合作，強化及深耕 FPD 次世代高附加價值設備，驅使公司多元化永續經營，以拓展未來在顯示產業不斷創新與進步，慎選合理毛利商機，獲利為先。
- (4) 繼續 2026 年智能自動化拓展成果，集中資源提供重點產業代表性客戶之智能自動化整合方案，實現其智慧製造目標。
- (5) 持續拓展與世界性一流公司合作，成為其長期夥伴，確保穩定發展之業務來源。

2.長期計畫

- (1) 以創新轉型，觸角延伸，永續發展為發展策略指導原則。
- (2) 營業面向
 - 半導體產業、顯示器產業及智能自動化產業深化推廣。
 - 延伸相關產品至其他國外市場業務推展。
 - 加強台商回流與國際大廠分散生產之商機。
 - 深耕設備及零組件售後服務市場，與客戶共同合作成長。
- (3) 產品面向
 - 核心技術(設備&製程)深根發展。
 - 擴展核心技術於跨域產品整合應用發展。
- (4) 多元人才培育的國際化策略。
- (5) 與合作夥伴公司策略結盟，合力共創，服務增值，產生最大綜效。

二. 市場及產銷概況

(一)市場分析

1.公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區及市場佔有率

本公司的產品以亞洲為主要的市場。茲將最近二年全集團內外銷之銷售比率列示如下：

單位：新台幣仟元

項目	年度	民國 113 年度		民國 114 年度	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
內銷之營業收入淨額		2,914,775	65.72%	3,632,617	77.79%
外銷之營業收入淨額		1,520,153	34.28%	1,037,210	22.21%
合計		4,434,928	100.00%	4,669,827	100.00%
市場佔有率		不適用		不適用	

2.市場未來之供需狀況與成長性

根據台灣綜合研究院「2026年台灣經濟展望」，回顧台灣2025年的經濟表現，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮持續擴散，資通訊與電子相關產品需求強勁，帶動外需出口表現明顯優於原先預期。在內需方面，國內企業同樣受到AI與新興科技應用需求帶動，持續擴充產能並加碼投資，使民間投資維持穩健成長。台灣作為全球半導體、伺服器與AI硬體供應鏈的關鍵節點，國際貿易環境的變動及地緣政治風險，均將直接影響我國出口結構與產業發展方向。展望2026年，台灣能否延續以AI科技與半導體出口為核心、並由民間投資承接的成長模式，將面臨挑戰與機會並存的關鍵轉折，主要產業景氣走向及整體經濟動能是否能持續改善，仍需密切關注。本公司在近年來，透過不斷積極研發與夥伴公司合力共創，預期今年在半導體產業、顯示器產業及智動化產業仍將有所斬獲，面對這一波的變化，順勢加大本公司在高科技設備的成長發展，擔任起客戶設備供應鏈的重要角色。

配合公司的策略，將持續深耕核心技術，擴展應用於半導體、顯示器及智能自動化等產業領域。

(1) 半導體產業

依據DIGITIMES Research預估，2024~2029年全球晶圓代工業營收複合年均成長率(CAGR)將達11.5%，上看2,700億美元，AI/HPC應用帶動先進製程與先進封裝需求強勁，是推升圓代工產業營收成長主要動能；另一方面，為滿足客戶中長期需求，2024年起，業者先進製程與成熟製程產能陸續開出，但地緣政治風險仍將是未來5年影響產業發展的不確定因子，因此，重新定義晶圓代工業務範疇、多地生產布局都將是業者因應的策略方向。於3D/2.5D IC/Fan-out等先進封裝已然成為趨勢，但因各大廠的製程方法不同，市場上並無單一標準設備可以對應，因此各家大廠皆有需要能快速反應，配合製程開發的設備以強化其競爭力，這也為國內設備業者創造良好的發展契機。

本公司長年專注經營半導體封裝設備事業，有多項產品在市場上被一線大廠客戶認同，具接近客戶的優勢及多年的強大的技術基礎，再輔以彈性靈活的特性以配合客製需求，能夠提供客戶長期滿意的服務。在先進封裝技術方面，更積極投入多項前瞻技術設備發展，全力為未來新製程設備展開佈局。目前已有多項新製程設

備已成功導入世界大廠。基於市場需求力道的升溫，2026 年展望應屬審慎樂觀。

DIGITIMES Research 報導，台積電因擴廠所釋出的訂單成為全球供應鏈重要成長動能，不只是 ASML 等國際設備大廠，台供應鏈中，不少業者的台積電訂單佔營收比重相當高。隨著台積電市佔與產能持續擴大，在先進製程比重更是絕對領先，對於台積電的依賴將只增不減，不過，由於單一公司訂單比重過高，營運風險也隨之拉升。

值得注意的是，台積電成熟與先進製程生產與勢力快速壯大，加上台灣、美國、日本與中國全面建置新廠或進一步擴產與升級設備，所釋出的訂單已成為全球設備、材料相關供應鏈積極爭取標的。如台積電的日本、美國新廠，涵蓋廠房建設、晶圓製造、封裝、測試、曝光機、蝕刻、PVD、CVD、量測與拋光等設備材料，再加上量產後所需，直接或間接為全球數千家半導體業者注入活水。

(2) 顯示器產業

工研院產業科技國際策略發展所指出，隨著 Micro LED 成本之下降，預期車載市場將會是 Micro LED 很大的應用領域，預估 2026 年車載面板產值將突破百億美元。Micro LED 之低功耗特性，對於電動車廠極具吸引力高穿透性之透明顯示特性也是目前車載應用中最具優勢之技術，一旦達成具量產效益之製程開發，未來應用成長將不容小覷。

Micro LED 面板預估於 2026 年進入車載應用市場，出貨量預估逐年大幅成長，2029 年可達 40 萬片。Micro LED 技術面臨的挑戰需要整個產業鏈的共同努力來克服，隨著技術的不斷進步，Micro LED 有望在未來幾年內實現更廣泛的應用。人工智慧 (AI) 高速算力技術的崛起加速 Micro LED 之量產進程，克服目前在良率提升之瓶頸。AI 技術目前在 Micro LED 之應用主要為檢測項目，聚焦於提升檢測效率、精準度及自動化程度。由於 Micro LED 晶片尺寸極小，製造過程複雜繁瑣，運用 AI 技術以有效提升產品品質和生產效率。AI 技術在 Micro LED 產業的應用，主要解決在晶片製造過程及巨量轉移過程中所存在的傳統檢測方法之品質穩定性、均勻性及效率的問題，此項新的解決方案，將可望推動 Micro

LED 技術的發展和應用。隨著 AI 和機器學習技術的大幅進步，預計未來在 Micro LED 製造和檢測中的應用將更加廣泛和深入。

本公司有多項主力產品已陸續成功切入 FPD 及 Micro LED 主要客戶，配合公司在 G8.5/G10.5 設備、車用面板相關設備以及 Micro/Mini LED 的設備強力研發及推展，預期將使本公司未來顯示器設備將可取得後續台灣業者擴廠商機的成果。

(3) 智能自動化設備產業

面對 AI 浪潮來襲，AI 將成為 2030 年改變產業發展的關鍵推手，加上當前 Chat GPT 爆發式的商業應用，面對疫後缺工與專精人力斷層問題，應著重應用生成式人工智慧 (Generative AI, GAI)，協助企業降低人力成本並改善生產效率，促使智慧機械產業 AI 化再創新興的藍海價值。

本公司智慧設備主要著力於無人搬運車系統及智慧診斷與預防維護系統等解決方案。系統整合能力是本公司的優勢，在半導體/面板/太陽能/PCB 等高科技產業均有設備建置的實績，累積厚實生產及製造的硬功夫及系統整合的軟實力，在國內外業界接獲得非常高的評價與屢屢獲獎肯定。近年來因應工業 4.0 與智慧機械的發展趨勢，提供智慧製造製解決方案，加速製造業在智慧製造方案的推展。

3. 競爭利基及發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1) 有利因素

2026 年 1 月美國拉斯維加斯舉行 CES 展，不僅聚焦於人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT) 與元宇宙的實際應用，更以半導體技術為核心，推出自駕車、人形機器人等最新應用。2025 年全球電子產業主軸於先進製程、先進封裝、AI 伺服器、光通訊、網通等產業，而這些市場衍生許多新設備的需求，半導體產業正值浪頭，半導體先進封裝已然成為趨勢，但因各大廠的製程方法不同，市場上並無單一標準設備可以對應，因此各家大廠皆有需要能快速反應，配合製程開發的設備以強化其競爭力，本公司具有接近客戶的優勢與多年的技術基礎，以及彈性靈活的特性以配合客製需求，加上政府及台灣指標性大廠對設備國產化的支持，正是切入市場掌握趨勢的好時機，也具備了正向發展條件。

在顯示器領域，經技轉日本高附加價值 Array 段 PROBER 及濕製程蝕刻等設備技術，成功發展 Array 及 Cell 段的主力製程產

品，並有效擴展應用於主要客戶，使公司在顯示器領域的營運更形完備、健康。

智能自動化市場需求爆發，本公司已取得不同領域之重量級企業青睞進行大規模的結盟合作，榮景可期。

A. 研究發展：

本公司不斷致力於創新及多元化產品之研發，並與法人研究機構和學術機構合作開發先進的製程設備，不斷提升本身的技術能力，研發能力深受產官學研各界肯定。

除已累積完整之核心技術及整合應用能力，可做為公司持續擴展之有力後盾外，近年來更陸續完成多次國際大廠技術合作案，藉由引進世界級的技術，更將進一步幫助公司進行國際化市場布局與轉型。

B. 完整之品質系統

公司具完整之 Q(品質)D(交期) T(技術)C(成本)S(服務)S(安全)品質系統，可提供全方位服務，有利於吸引世界級客戶形成策略夥伴之合作。目前在「策略合作/跨域合作，聯盟並進」之公司策略上已獲相當進展。

C. 強大後勤支援系統

本公司歷史悠久，信用狀況良好，與外包及材料供應商經過多年往來，雙方已建立良好供需及合作夥伴關係，有利於產能之擴展及穩定之材料供應。

(2) 不利因素及因應對策

A. 面臨大陸面板產業的崛起及擴張，大陸政府積極推動其設備國產化，公司逐漸面臨當地本土設備強力競爭。中國大陸對半導體產業更大力扶持，也帶動當地設備業的迅速發展，當地設備業者以低價競爭爭取市場，產生彼此競爭關係。因應對策：

(A)持續強化自有產品技術，強化智權專利申請，配合國外先進技術引進，以提昇產品層次擺脫低價競爭。增強大陸在地化營運資源，提升大陸子公司設計與製造能力，以擴展大陸市場競爭能力。部份設備發展在地化，整合在地資源以控制成本，並強化在大陸當地的服務。

(B)與大陸當地設備廠結盟，除鞏固暨有產品商機外，並合作推動高附加價產品於大陸客戶。

(C)活用大陸當地設備供應鏈，並整合公司擅長之 QDTCSS 能

量，提供客戶更加值服務，創造雙贏。

(D)貼近客戶及快速反應為我們有效切入客戶新製程開發之關鍵因子，在此前提下可持續創新，跟隨客戶一同成長，然於有限資源及市場演變迅速之狀況，成熟產品及新研發設備在資金及人力上，須慎重抉擇。

(E)以核心技術為基底，配合產業趨勢，投入新品研發，擴展產業應用，包括記憶體、5G、AI、Mini/MicroLED 等等，以擴大市場供應面市場需求。

B. FPD 產業發展榮景恐難以長期持續

因應對策：

(A)切入 FPD 產業高附加價值前段洗淨、濕蝕刻、及檢測設備設備。

(B)把握 FPD 客戶既有設備改造商機，擴大整合推展 After market 加值服務。

(C)開拓半導體、智能製造等不同產業，並佈局新東向與新南向市場。

(D)持續進行策略聯盟、技術移轉合作、跨域整合的創新營運。

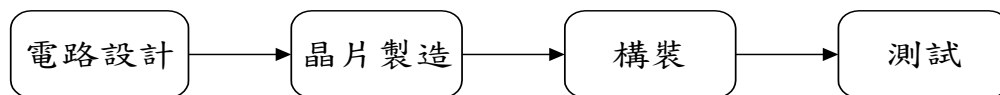
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要用途

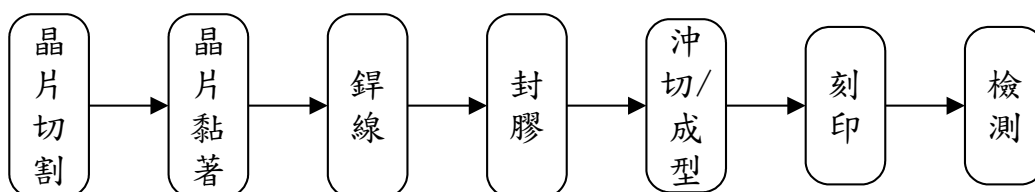
本公司專營設計、製造及銷售半導體產業、FPD 產業及智能自動化等設備。茲將產業製程及本公司提供之設備相關性，圖示如下：

(1) 半導體設備產業：

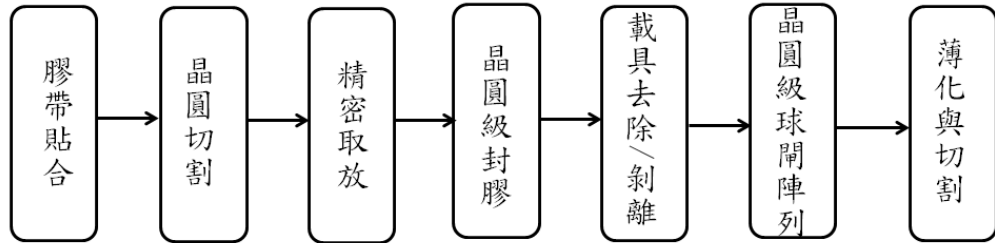
半導體生產製程主要步驟如下：



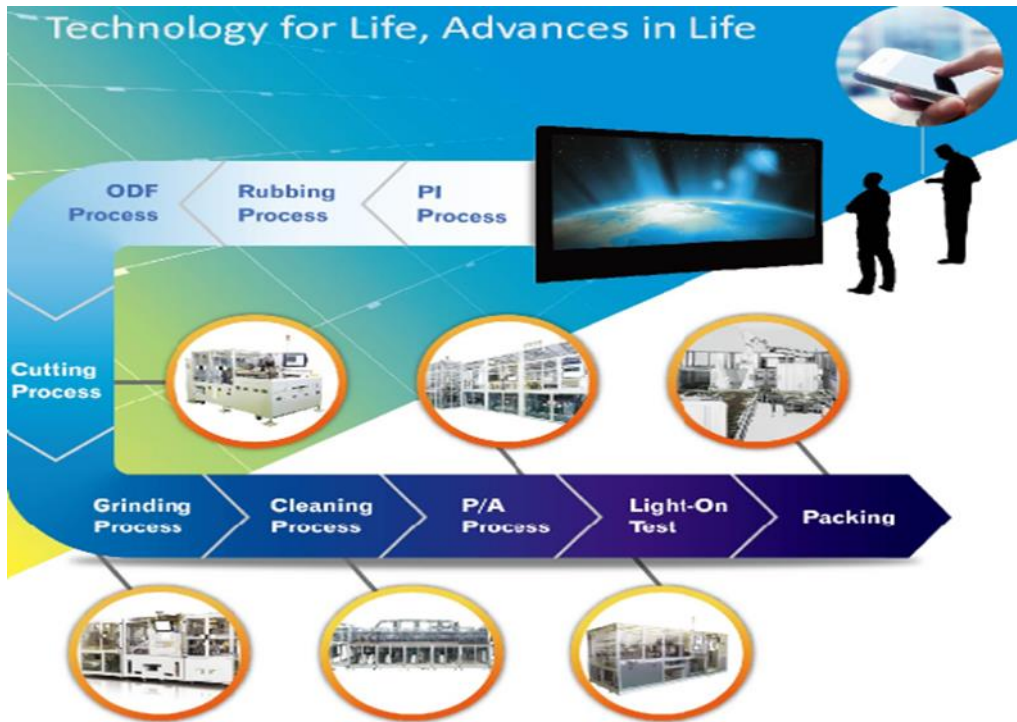
而半導體構裝又細分為：



而近年興起的半導體先進封構裝製程又細分為：



(2) FPD 製程與設備



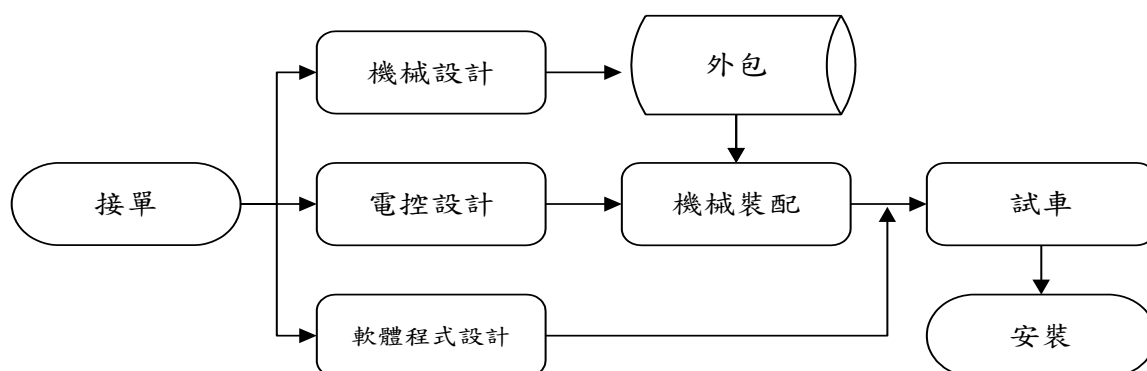
(3) 智能自動化設備用途說明

本公司目前已與數家不同重點產業之重要龍頭公司合作，正朝向成為其長期的異質結盟夥伴邁進。因此類設備均有某種程度之客戶製程專用性，可因應不同產業之智能製造需求。

2. 本公司產製過程分述如下：

本公司對所有新產品之研發工作設有嚴謹之「C 流程設計開發管制程序」以管制計畫之研發，C 流程含「C0 市場評估」、「C1 技術及產品規劃」、「C2 設計階段」、「C3 製作組裝階段」、「C4 測試驗證階段」及「C5 成果確認階段」。

研發之成果以「S 流程」管制其商品化之推展，計分成「S1 進料檢驗」、「S2 機構模組機組裝」、「S3 電控配管及整機調整」、「S4 Cold Run Test」及「S5 Hot Run Test」。



(三)主要原料之供應狀況

本公司產製之半導體構裝設備及 TFT LCD 設備，其主要原料及來源分述如下：

►機械結構部份

(1) 功能機構件

由機械設計人員依所需功能繪製工程圖後，由工程部門依圖製作或交由協力廠商製作，其主要原料為鋼、鐵和鋁等金屬材料。

(2) 標準機械零組件

舉凡培林、伺服馬達、傳動皮帶、彈簧、沖模、導柱及緩衝器等一般零組件則由機械設計人員依功能需求就現有市售零組件之型錄規格加以評估並選定規格，透過貿易商或國內市場取得。

(3) 電腦、人機介面等硬體

舉凡工業電腦、人機介面等，由電控設計人員依各項功能需求，參考市售各廠牌產品規格型錄加以測試評估後選定規格，透過貿易商或國內市場取得。

(4) 各種訊號傳遞、控制元件

舉凡感知器、電磁閥、伺服控制器、觸控開關等元件，由電控設計人員依各項功能需求，參考市售各廠牌產品規格型錄加以測試評估後選定規格，經由貿易商購入。

(5) 電氣及傳動元件

舉凡氣缸、風扇、照明燈、變壓器、供電器等組件，由電控設計人員依各項功能需求，參考市售各廠牌產品規格型錄加以測試評估後選定規格，透過貿易商或國內市場取得。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額 10%以上之客戶名稱、進(銷)貨金額、比例並說明增減變動原因

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額 10%以上之進貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	民國 113 年度				民國 114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
	其他	2,439,616	100.00%	無	其他	2,541,281	100.00%	無
	進貨淨額	2,439,616	100.00%		進貨淨額	2,541,281	100.00%	

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額 10%以上之銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	N 客戶	1,082,391	24.41%	無	N 客戶	1,171,437	25.09%	無
2	B 客戶	775,490	17.49%	無	S 客戶	714,815	15.31%	無
3	S 客戶	304,479	6.87%	無	V 客戶	666,845	14.28%	無
4	U 客戶	281,166	6.34%	無	B 客戶	446,600	9.56%	無
	其他	1,991,402			其他	1,670,130		
	銷貨淨額	4,434,928			銷貨淨額	4,669,827		

三. 從業員工最近兩年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡與學歷分布比率

年度		民國 113 年度	民國 114 年度	民國 115 年 3 月 31 日
員工人數(人)	間接人員	335	477	493
	直接人員	464	310	310
	合計	799	787	803
平均年齡(歲)		42.38	41.75	41.58
平均服務年資(年)		10.29	10.22	10.17
學歷分布比率 (%)	博士	0.50%	0.76%	1.00%
	碩士	24.40%	27.83%	28.02%
	大專	64.08%	61.63%	61.51%
	高中	9.64%	8.64%	8.47%
	高中以下	1.38%	1.14%	1.00%

四. 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償)及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司廠內相關環保事務一切皆依國家法令規範執行，無因污染環境所受損失(包括賠償)及處分。同時，本公司積極投入環保污染預防工作，總計投入新台幣 1,404 仟元，每年均投入大量經費於污染防治設備之增設改善，更不斷更新製程，達成污染減量、資源回收與再利用，亦積極推動各項環安衛管理措施，且定期依法實施全廠各項環境檢測、加強全員危害辨識安全教育、預防災變訓練、員工健康檢查與促進，以期達到生產零污染與職場零事故之目標。對於環境氣候之影響方面，更戮力於減低溫室氣體之排放及能源有效利用。

並且除了遵守本國法令之外，對於歐盟環保指令 (RoHS) 之相關規範及國際公約之遵守，亦努力務求達成，以期除了在汲汲於業績成長外，對環境保護與工作安全，付出一己之力。

五. 勞資關係資訊

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施

本公司認為員工為最重要資產，除了提供適切的工作內容，同時給予優質的薪酬與福利。本公司也鼓勵員工投入家庭、追求興趣、關懷社會，並營造舒適的生活。

(1) 薪酬及給假

- 薪資獎金：除基本月薪資外，另提供端午、中秋、春節獎金等年節獎金，另為了獎勵員工優秀的績效表現，公司依照營運目標達成率、獲利程度及員工個人績效提供季績效獎金、年終獎金及員工酬勞，其員工酬勞依公司章程規定提撥之。
- 優於勞動基準法的休假及彈性出勤制度。
- 優於勞動基準法之產假、產檢假、陪產檢及陪產假、病假。
- 為重視員工家庭生活，提供活力假、生日假、小一新生開學假。
- 為鼓勵同仁投入志工服務貢獻社會，提供志工假。
- 彈性上下班制度。

(2) 生活及激勵補助

- 提供婚喪、生育、年節(端午節、中秋節)、住院慰問金及年節禮品。

- 提供 0~1 歲生育獎勵金，每月補助 2000 元、第三名子女托育與教育津貼，每月補助 3,000~6,000 元等育兒措施。
- 為了鼓勵員工創新，公司提供創新研究獎金、提案改善獎金、特殊表現優秀團隊獎金、模範員工獎金...等，以激發員工工作熱忱與團隊合作精神。
- 為獎勵員工自我提升，推行英日語證照獎金、優良內部訓練講師、訓練學積分等措施。
- 停車位費用補助。
- 員工自行辦理戶外聯誼活動，公司將提供戶外聯誼補助，每人每次 300 元。
- 在職進修費用補助。
- 英文學習與證照補助。
- 提供員工購置車輛預支薪資措施，員工得視自身財務狀況預支 150,000~300,000 元，提升員工的生活機能。
- 提供員工購置房屋預支薪資措施，員工得視自身財務狀況預支 360,000~1,500,000 元，降低員工的生活壓力。

(3) 紓壓環境

- 設置舒適的女性員工哺乳室。
- 各廠區設置員工餐廳，並提供員工用餐補助。
- 設立圖書室，藉由吧檯式擺設，達到紓壓效果。
- 各廠區設置健身中心。
- 咖啡機及零食販賣機擺設。
- 各廠區圖書室設置「樂齡眼鏡」。
- 活化公共區域，營造舒適休憩環境。

(4) 軟性活動

- 舉辦音樂會、共識營、家庭日、志工活動等系列親子活動，讓員工達到工作與生活平衡。
- 跨國文化交流課程與體驗活動。
- 產業電影觀賞科技文化素養活動。
- 於不同節日辦理團康與趣味競賽活動。
- 每年辦理尾牙/春酒活動。

(5) 餐點享用

- 免費咖啡/茶包/下午茶點心。

(6) 眷屬同享

- 提供員工眷屬團體保險優惠。
- 提供員工眷屬健康檢查優惠。

(7) 特殊特約

- 與心理諮商所(新竹：2 間；臺中：2 間)簽訂特約，提供同仁壓力釋放管道。
- 與幼稚園簽訂特約。

(8) 其它措施

- 提供每年度免費健康檢查。
- 模範員工及資深員工獎勵制度。
- 提供心理諮詢專線預約服務。
- 各主管依績效指標展開方案，為了達成公司、部門及個人目標，每半年定期進行全體同仁之績效考核進行指導及回饋，人資單位提供訓練，使主管了解、內化考核的重要性，同時教導主管執行考核評估及績效面談作業，以提昇公司同仁工作績效，並提供員工職涯規劃，並制定合理的獎懲回饋機制，考核結果做為核發獎金、調薪、酬勞、升遷、人才培訓及發展計劃之依據。
- 實施廠區交通車接駁(減少通勤車流量與總排氣量，降低環境負荷)。
- 為保障員工的安全與健康，公司提供了多項保險，包括員工團體保險、團體海外商務旅行平安保險、雇主意外責任險及雇主補償責任險，以保障同仁的工作及生活安全。

(9) 福委會福利措施：

- 提供國小至研究所之子女與員工教育獎助學金。
- 福委特約商店折扣。
- 提供婚喪、生育、年節(母親節、父親節、端午節、勞動節、中秋節及聖誕節)、生日禮金(Pay Easy 點數)。
- 社團活動(社團性質以運動、公益、紓壓等類別共計 11 個社團)。
- 不定期文康活動(年節禮品、聖誕節 Party、節慶活動)。

2. 進修、訓練制度

本公司認為人才發展為公司成長的基石，透過訓練發掘更多潛能，我們提供充分的資源，協助同仁創造自我，創造企業的價值及核心競爭力，同時促成企業發展與員工成長，共創雙贏。

- (1) 本公司訂定「教育訓練品質手冊」，以資供同仁遵循，公司每年提供教育訓練補助經費，提升組織內人員的知識技能，培養儲備人力資源，以達成組織績效，提升公司競爭力。內容概述如下：

- A. 教育訓練體系：均豪制訂完善的訓練發展體系，訂定明確的教育訓練規劃流程，根據職等及職稱規劃不同課程，用以達成願景及年度策略目標，並培養人才。
 - a. 階層別訓練課程：依照各階層別主管規劃階層別地圖，針對管理知能進行訓練，以確認各主管具備管理知識，分為培育基層主管、基層主管、中階主管及高階主管學習地圖。
 - b. 專業別訓練課程：針對各單位所需具備之技術，設計專業別訓練地圖，例如研發設計訓練地圖、客服職能

訓練地圖等，以確保員工在崗位上具有足夠的知識技術。

- c. 新進人員訓練課程：說明公司概況、發展歷程、管理規章、資訊安全、職業安全/衛生及職安衛管理系統觀念。
- d. 內部講師培訓課程：人資單位依實際需求舉辦內部講師培訓班，以評鑑學有專長、具有教學熱忱之同仁，研習授課教學技巧。
- e. 自我啟發訓練課程：美學、藝術、醫療、養生、文學等心靈成長課程。
- f. 軟性課程：含身體保健、家庭關係、心理紓壓及保險理財課程。

B. 師徒制：為每位新進同仁搭配一位師傅，提供工作上之建議，並可以加快新進同仁適應工作環境。

C. 本集團 114 年有關員工之進修及教育訓練統計及支出如下：

教育訓練	內部訓練	外部訓練	總計
訓練梯次	246	379	625
受訓人次	7,502	406	7,908
受訓人時數	13,034	3,025	16,059
經費支出 (單位:新台幣仟元)	\$1,566	\$849	\$2,415

3. 退休制度與其他實施情形，分為舊制及新制二種：

- (1) 舊制：本公司依照勞動基準法之規定對正式聘僱員工訂有退休辦法，依該辦法規定，退休金之支付係按服務年資及退休時前六個月之平均工資計算，本公司每月依規定提撥退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會管理，並以該委員會名義存入臺灣銀行專戶，並依國際會計準則第 19 號公報之規定，委請精算師對於勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告。
- (2) 新制：適用於民國 94 年 7 月 1 日之後到職員工，一律採用新制退休金，以及選擇新制之民國 94 年 7 月 1 日以前加入之員工。公司依員工工資，每月提繳工資 6% 至員工個人退休金專戶中。員工亦得依個人意願於每月提繳工資 0%~6% 至個人退休金專戶，並由公司按月於員工之工資中代扣其提繳數額。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司重視勞資關係，並遵照勞基法及相關法令規定，多年以來已建立極為和諧的勞資關係，無勞資糾紛之情形。

本公司重視員工之權益及未來發展，設有職工福利委員會，提供各項員工福利措施。另訂有「教育訓練品質手冊」，鼓勵員工參與各項訓練及技能培訓，同時亦建立勞資溝通管道，並於公司網站

揭露福利措施、學習發展、員工溝通與平衡生活。當公司營運發生重大變化而影響勞工權益時，會立即透過正式之溝通管道，與員工進行溝通協調，且本公司定期與員工召開員工大會、勞資會議等會議公告重要訊息及了解勞方想法，另訂有「工作場所性騷擾防治措施」，同時提供「總經理信箱」、「反霸凌信箱」、「模範員工餐會」及「員工意見調查」等溝通管道收集改善意見，並於收集後進行紀錄及提出改善提案，建立確實的勞資溝通環境。

- 設置「總經理室信箱」，由專人彙整及回覆。
- 每季舉辦「員工大會」，提供員工表達意見的機會，作為公司改進之參考。
- 每季舉辦「勞資會議」，為促進和諧的勞資關係，定期召開勞資會議，傾聽員工的建議。
- 每年選出模範員工，並辦理「模範員工餐會」，聽取模範員工給予公司的建議。
- 每廠區皆有員工關係負責同仁，可提供面對面的協助及傾聽同仁心聲。
- 不定期舉辦「員工座談會」，由董事長親自座談了解傾聽員工的想法。
- 定期提供「員工意見調查」，提供同仁對於公司建議的管道。

5. 員工工作安全及健康

(1) 工作安全環境

- 成立職業安全衛生委員會，每季定期召開會議討論、安全衛生相關事項。
- 每6個月實施作業環境監測，評估個人暴露情形，作為工作場所環境改善之依據。
- 訂定之緊急應變計畫，包括對於事故發生之快速反應、災害復原以及對於潛在災害建立應變程序。
- 已取得職業安全衛生管理系統(ISO45001:2018)驗證通過。
- 定期舉辦全員消防綜合演練、緊急應變演練及CPR急救包紮救護課程。
- 訂定職業安全衛生政策及各級主管權責劃分、委員會召開及研議。
- 打造無菸辦公室環境。
- 公務車裝設胎壓偵測器及定期檢測胎紋。

(2) 員工身心靈健康

- 每年提供在職勞工實施定期健康檢查(優於法規規定之健檢項目與頻率)，對於新進員工實施體格檢查，針對特別危害健康作業勞工，實施特殊項目之健康檢查。
- 健康分級管理制度，依照同仁健檢結果，進行健康分級管理。

- 臨場醫護服務，擁有更方便的身體健康諮詢，並追蹤同仁的健檢複檢狀況。
- 每年例行舉辦健康促進活動(民國 114 年「減重 1+1 齊力拿獎金」活動年共減重 131.8 公斤，其中維持健康體態不復胖人數 18 人；民國 114 年「體能挑戰賽 快樂運動三級跳」活動總共 82 人達標。
- 自聘諮商心理師與外部心理諮商所特約，提供同仁心靈方面的協助。
- 邀請同仁填寫身心靈健康問卷，並於後續搭配諮商心理師進行心理狀態追蹤。
- 舉辦健康促進與身心紓壓課程。

6. 履行企業永續

誠信治理、綠色環境與社會關懷，均豪以積極的行動踏入永續的議題，在永續的道路上，均豪將跟著世界共同成長，與生態環境共存共榮。

(1) 公司治理

- 本公司確立有效的公司治理架構，秉持誠信經營原則，依循法規，設立董事會及各法定委員會，並訂有公司重要內規，實行公司治理實務。
- 公司資訊定期公告於官網及公開資訊觀測站，實施公開、透明的資訊揭露，並重視各類利害關係人之雙向溝通，定期將溝通結果呈報於董事會。

(2) 社會共融

- 本公司皆確實遵守相關勞動法規並尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及履行公平無差別待遇之雇用政策，並已制訂適當之管理制度，以監督管理，並於民國 113 年由陳政興董事長簽署多元、平等與共融宣言。本公司為所有員工投保壽險、健保、疾病癌症傷殘險相關保險及提供退休準備金等。
- 本公司認為員工為最重要資產，除了依照業務需求，提供員工適切的工作內容，同時給予安全舒適的工作環境，並設立優質的薪酬與福利。本公司也鼓勵員工投入家庭、追求興趣、關懷社會，並營造舒適的生活。
- 本公司積極投入社會參與，希望將善意遠播，提升社會的共同生活品質，縮短貧富差距及不平等問題。本公司之社會參與活動分為公益關懷、產學合作、培育平台，公益平台針對社會弱勢團體提供支持與資金協助，產學合作則針對學校機構提供實習職缺及設立研發合作案，培育平台為提供偏鄉國中小學展示所長之平台，發揚地方文化特色等。

(3) 環境永續

- 氣候變遷深切影響著人們的生活，隨著極端氣候的議題逐漸浮現，均豪於民國 110 年起接受 ISO14064-1:2018 溫室氣體盤查的輔導，民國 111 年正式導入 ISO14064-1:2018 進行溫室氣體盤查，訂定低碳排政策，優先進行減量並以淨零排放為最終目標；民國 111~114 年通過溫室氣體盤查外部查證；預計民國 115 年通過 GHG Protocol 外部查證。
- 本公司一直以來皆每月固定檢討用水量及用電量，瞭解使用情形，並協調改善方案。同時，製程方面也設計用水量下降之機台，不僅是合乎客戶需求，同時也達到環境保護的目標。

(4) 獲獎事蹟

- 第 21 屆臺灣金根獎
- 114 年新竹市政府 ESG 卓越媒合表揚
- 114 年企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比績優企業
- 114 年職場健康促進自主評核制度通過審查，並取得「合格」資格

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

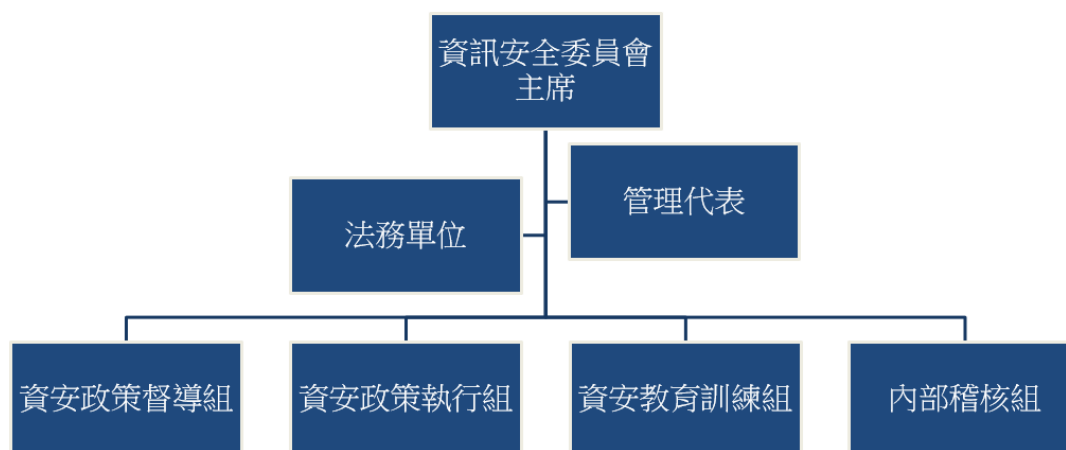
六. 資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構

➤ 資訊安全委員會組織

本公司為維護並強化資訊安全管理，確保各項資訊資產之機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity) 及可用性 (Availability)，於 109 年 10 月 26 日 成立「資訊安全委員會」。資訊安全委員會依其職掌，負責統籌執行資訊安全治理、政策規劃、督導及推動相關措施，並定期召開管理審查會議，依據風險評估結果、相關法令規範，以及技術與業務發展趨勢，適時檢討與修訂資訊安全管理制度，以確保各項控管措施符合實際營運需求，資訊安全委員會每年定期向董事會報告資訊安全風險管理執行情形，以落實公司治理及強化資安風險監督機制。



2. 資通安全政策

本公司歷年來持續致力於強化資訊安全管理，透過改善內部各項資訊安全管理機制、定期辦理資訊安全宣導活動及員工資訊安全教育訓練，全面提升組織之資訊安全防護能力。同時，持續深化資訊安全治理，建立「資訊安全，人人有責」之核心觀念，確保客戶及同仁於資料處理過程中之機密性、完整性與可用性，務使各項資料處理流程皆能獲得妥善且安全之保護，進而提供安全、穩定且高效率之資訊服務。

➤ 通過 ISO/IEC 27001:2022 ISMS 資訊安全管理系統

本公司於 113 年 10 月取得 ISO/IEC 27001:2022 ISMS 資訊安全管理系統國際認證 (認證機構：亞瑞仕國際認證有限公司，證書號碼：ARES/TW/I2410047I)。依據 ISMS 資訊安全管理系統要求，持續執行資訊安全政策，訂定並落實資訊安全目標，並於 114 年 10 月順利完成追查驗證作業，各項資訊安全控管措施均持續執行中，並定期辦理營運持續與資安應變演練，以確保公司重要系統與資料之機密性、完整性與可用性。

CERTIFICATE



The Governing Board of
ARES International Certification Co., Ltd.
Hereby Grants To:

Gallant Precision Machining Co., Ltd

No.5-1, Innovation 1st Rd., Science-Based Industrial Park, HsinChu
County, Taiwan

No.28, Keya W.Rd., Central Taiwan Science Park, Taichung City, Taiwan

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of
standard detailed below

ISO/IEC 27001:2022

Scope

**EPDM & ERP application system development, maintenance
and information room operation**

SOA Version- V1.3

Issue Date- 2024/07/30

Certificate No.: ARES/TW/I2410047I

Certificate Issue Date: 2024-10-15

Registration Expiration Date: 2027-10-14



The time interval between each surveillance audit and the last on-site audit shall not exceed 12 months,
and the organization must obtain "surveillance audit approval notification" issued by ARES to ensure the
validity of the certificate.



Authorized by :



亞瑞仕國際驗證
ARES International Certification

Surveillance Audit Approval Letter

監督審核通過證明

證書編號：ARES/TW/I2410047I

This is to certify Gallant Precision Machining Co., Ltd has been performed ISO/IEC 27001 : 2022 the first surveillance audits, and has confirmed that Management System continued to function effectively, we agreed to continue to maintain certification qualification certificate sustained and effective. Your Certification has been recommended till 14, October, 2026.

茲證明 均豪精密工業股份有限公司 ISO/IEC 27001 : 2022 資訊安全管理系統已進行第1次監督審核，並已確認貴公司之管理系統持續有效運作，同意繼續保持驗證註冊資格，證書持續有效。
本通過證明有效期限至 14/10/2026。



2025 年 10 月 28 日

ARES INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD.

Period of validity : 1 year
此證明文件有效期限 1 年

►文件系統化管理

為提升資訊安全管理，本公司各項資訊安全政策、治理制度及相關規範，均採行文件系統化管理方式。資訊安全相關程序文件由資訊單位統一提報內部電子簽呈，經各單位一級主管及總經理審核核准後，由資訊單位透過內部電子文件系統提出申請，並經文管中心依既有流程審理後，正式發佈為全公司適用之文件公告，以確保文件之完整性、一致性及可追溯性。

電子簽呈系統流程



電子文件系統流程



3. 具體管理方案

本公司為保護機密文件及客戶資料安全，於 113 年完成 ISO/IEC 27001:2022 ISMS 資訊安全管理系統驗證，並同步強化各項資安防禦設備與資安監控及檢測能力，以提升整體資訊安全防護水準。每年定期辦理資訊安全宣導與教育說明活動，內容涵蓋《營業秘密保護法》相關條款、公司資訊安全政策，以及客戶 PIP 資安規範等，並要求新進人員於到職時簽署資訊安全政策同意書，以確保資訊安全政策有效佈達並落實於全體同仁。

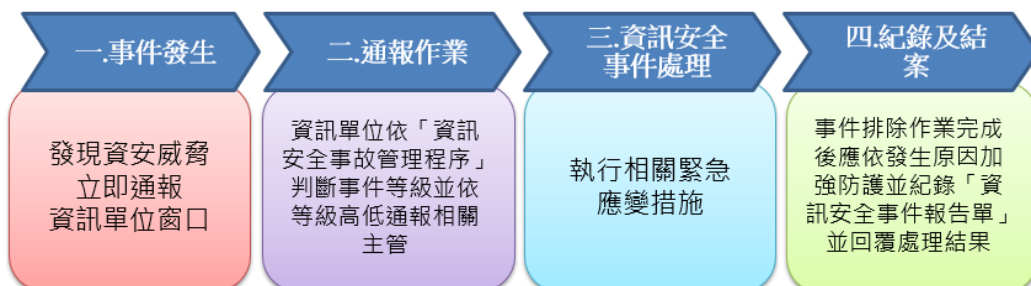
本公司每年定期執行核心系統災害復原演練，並透過 DR 備援機制進行異地機房系統還原作業，以確保核心系統於突發事件發生時仍可維持正常運作。

在實體與網路安全管理方面，建置完善之內、外部防火牆機制，並設置 DMZ 網路隔離區及安全區，有效區隔內外部服務之伺服器主機，同時搭配網路流量異常偵測與分析系統等資安設備，以確保網路實體環境之安全。

於資料存取與保護管理方面，透過 DLP 系統與防毒系統部署於用戶端電腦，強化電腦資料安全及行動儲存裝置 (USB) 之管控，並依員工業務需求及職務職能分別賦予相對應之存取權限。此外，建置完善之資料備份與還原機制，以確保資料安全性，提升對內、外部攻擊之防禦與復原能力，妥善維護客戶資料及整體資訊安全。

本公司已加入 SP-ISAC 科學園區資安資訊分享與分析中心及 TWCERT/CC 台灣電腦網路危機處理暨協調中心，透過資安情資共享機制，持續掌握國內外資安威脅與弱點資訊，以利即時管理及提前因應潛在風險。

➤ 資安事件通報流程



4. 投入資通安全管理之資源

➤ 資訊安全教育訓練

每年於竹科與中科廠區辦理員工資訊安全教育訓練，邀請外部資訊安全講師到廠宣導最新資安觀念，期望提升全員資安意識，以減少資安事件產生，保障公司權益。

➤ 多因子驗證機制

隨著網路攻擊事件日益增加，攻擊手法多以竊取使用者身分資訊，進而登入各類網路應用服務，僅以帳號及密碼作為防護已不足以因應現行資安威脅。為強化身分驗證安全，本公司自民國 110 年起導入多因子驗證機制 (Multi-Factor Authentication, MFA) 相關資安產品，並持續訂閱與應用相關服務。公司使用者進行遠端登入時，須通過兩項以上之身分驗證機制，始得連線至公司內部系統與服務，以確認連線使用者為公司同仁本人，有效降低帳號遭盜用之風險，並防範外部駭客未授權連線入侵，進而保障公司資訊資產與資料安全。

➤ 持續訂閱 EDR(端點偵測與回應)、MDR 提供應變服務

隨著駭客入侵手法日益多元且隱蔽，常透過看似正常之管理連線行為或指令編碼方式，規避傳統資安防護工具之偵測，為強化端點防護與事件應變能力本公司已導入並部署 EDR (Endpoint Detection and Response) 產品，透過系統化整合機制，主動且即時進行資安事件之早期偵測，並於事件發生時採取有效之抑制與應變處置，以降低影響範圍。此外，本公司持續訂閱專業資安業者提供之 MDR (Managed Detection and Response) 服務，由專責 MDR 資安團隊協助分析 EDR 所偵測之各類資訊安全事件，加速事件研判與問題定位，縮短應變處理時間，進而有效降低整體資安風險。

➤ 近年投入費用說明

為保障公司權益，阻絕被駭客入侵風險，本公司近年投入資安費用均有顯著成長。



(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無

七. 重要契約

截至年報刊印日止，本公司目前仍有效存續及最近年度到期之重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術移轉合約	MICRONICS JAPAN CO.,LTD.	104/03/12 起	技術移轉	技術移轉相關資料不得再授權或轉讓予第三方
技術合作合約	Sumitomo Precision Products CO.,LTD.	105/09/09 起 10 年	技術合作	如期滿未提出終止，則合約續約
技術授權及共同開發合約	International Business Machines Corporation.	105/11/03 起	技術授權及共同開發	未有違約情事，合約永久有效
租約	中部科學工業園區管理局	114/01/01~133/12/31	中科廠房租約	無
租約	竹科科學工業園區管理局	105/08/01~125/07/31	竹科廠房租約	無
長期借款	台北富邦商業銀行	113/06/05~115/06/05	中科廠房抵押借款	無
長期借款	國泰世華銀行	113/03/31~116/03/31	竹科廠房抵押借款	無
長期借款	第一銀行	113/12/16~115/12/16	台元廠房抵押借款	無

伍. 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一. 財務狀況：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	民國 114 年度	民國 113 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		4,609,198	4,379,276	229,922	5.25
不動產、廠房及設備		1,423,189	1,306,777	116,412	8.91
無形資產		29,379	20,068	9,311	46.40
其他資產		10,717,050	7,773,796	2,943,254	37.86
資產總額		16,778,816	13,479,917	3,298,899	24.47
流動負債		4,494,686	4,100,830	393,856	9.60
非流動負債		2,390,492	1,864,597	525,895	28.20
負債總額		6,885,178	5,965,427	919,751	15.42
股 本		1,647,466	1,651,361	(3,895)	(0.24)
資本公積		267,981	298,984	(31,003)	(10.37)
保留盈餘		790,131	749,267	40,864	5.45
其他權益		6,554,738	4,537,041	2,017,697	44.47
庫藏股票		(462,609)	(476,776)	14,167	(2.97)
歸屬於母公司業主之權益		8,797,707	6,759,877	2,037,830	30.15
非控制權益		1,095,931	754,613	341,318	45.23
權益總額		9,893,638	7,514,490	2,379,148	31.66

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響：

1. 無形資產增加，主要係子公司購買無形資產所致。
2. 其他資產、資產總額增加，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動與預付投資款較上期增加所致。
3. 非流動負債、負債總額增加，主要係長期借款較上期增加所致。
4. 資本公積減少，主要係 113 年股利分派資本公積每普通股配發現金新台幣 0.20 元所致。
5. 其他權益、歸屬於母公司業主之權益、權益總額增加，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價較上期增加所致。
6. 非控制權益增加，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加所致。

二. 財務績效：

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		增 (減) 金額	變 動 比 例 (%)
	民國 114 年度	民國 113 年度		
	金 額	金 額		
營業收入	4,669,827	4,434,928	234,899	5.30
營業毛利	1,638,657	1,185,487	453,170	38.23
營業損益	480,542	332,628	147,914	44.47
營業外收入及支出	163,154	262,670	(99,516)	(37.89)
稅前淨利	643,696	595,298	48,398	8.13
繼續營業單位本期淨利	525,391	473,296	52,095	11.01
停業單位損失	----	----	----	----
本期淨利 (損)	525,391	473,296	52,095	11.01
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	2,367,788	4,063,699	(1,695,911)	(41.73)
本期綜合損益總額	2,893,179	4,536,995	(1,643,816)	(36.23)
淨利歸屬於母公司業主	416,948	296,749	120,199	40.51
淨利歸屬於非控制權益	108,443	176,547	(68,104)	(38.58)
綜合損益總額歸屬於母 公司業主	2,458,762	4,230,041	(1,771,279)	(41.87)
綜合損益總額歸屬於非 控制權益	434,417	306,954	127,463	41.53
每股盈餘	2.59	1.82	0.77	42.31

最近二年度營業收入、營業損益及稅前純益重大變動之主要原因：

- 營業毛利、營業損益、淨利歸屬於母公司業主、每股盈餘增加：主要係民國 114 年較去年銷貨收入增加及成本管控得宜致營業毛利增加所致。
- 營業外收入及支出減少：主要係民國 114 年外幣兌換損失增加所致。
- 本期其他綜合損益 (稅後淨額)、本期綜合損益總額、綜合損益總額歸屬於母公司業主減少：主要係 114 年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益較上期減少所致。
- 淨利歸屬於非控制權益減少：主要係 114 年子公司淨利減少所致。
- 綜合損益總額歸屬於非控制權益增加：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價較上期增加所致。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

單位：套

主要產品	民國 115 年度預算
半導體製程設備	714
顯示器製程設備	14
智能自動化設備	-
其他設備	5

註：依據客戶對未來之預估及綜合市場情況做成預期資料，上述預估數量未包含其他及零件類。

三. 現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一)114 年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

年初現金餘額	營業活動之淨現金流入	投資活動之淨現金流出	籌資活動之淨現金流出	匯率影響數	年底現金餘額
1,076,461	488,828	(704,869)	257,216	17,912	1,135,548

1. 營業活動：因民國 114 年主要是本期稅前淨利、其他應付款、收取之股利增加，致 114 年營業活動之現金流入。

2. 投資活動：主要係取得透過其他綜合損益按公允價值之金融資產所致。

3. 籌資活動：主要係因舉債借款及發放現金股利所致。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無此情形，不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

1. 營業活動之現金流入為新台幣 248,119 仟元：主要係來自應收帳款收現沖抵應付帳款及營運費用所致。

2. 投資活動之現金流出為新台幣 280,408 仟元：主要係投資支出、發放員工酬勞及股利所致。

3. 籌資活動之現金流出為新台幣 75,000 仟元：主要係償還銀行借款所致。

四. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司無此情形，不適用。

五. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

(一)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫（投資金額超過實收資本額百分之五）：

單位：新台幣仟元

說明 項目	原始投資 金額	政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
GRC(BVI) 公司	459,050	轉投資大陸蘇州均強/均晟豪公司（均晟豪已於民國 113 年 12 月註銷）	受大陸整體環境影響，公司經營重點除就近提供大陸市場客戶之設備、售後服務外，也藉大陸客戶裝機數量優勢，掌握售後及節能減碳(ESG)市場商機，持續精進，提升競爭力。	1. 聚焦優質客戶，提供全面性整合服務。 2. 整合在地資源，降低成本，提升獲利能力。 3. 兩岸合作，GPM 多年整合服務經驗及技術傳承 GPI，爭取大陸服務商機。 4. 持續精進致力於提高大陸市場客戶之售後服務滿意度。
均華精密工 業(股)公司	467,249	精密模具及其他零件之生產及銷售	掌握半導體先進封裝發展趨勢，發展精密取放核心應用技術及具規模需求量的主製程設備，建立長期營運成長的基礎	配合主要客戶持續發展高階製程設備，擴大核心技術及產業應用領域

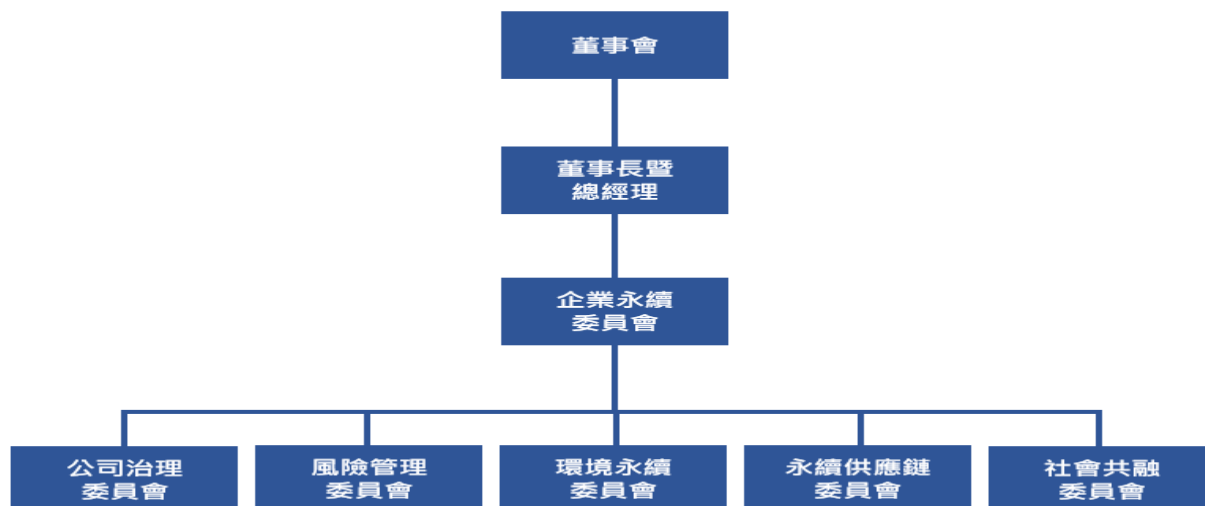
(二) 未來一年投資計畫：無單一投資計畫超過實收資本額百分之五情事。故此項分析不適用。

六. 風險管理分析評估事項

(一) 風險管理之組織架構：

為提升企業社會責任及使公司永續經營發展，本公司於民國 105 年成立企業永續委員會，負責推動企業社會責任、公司治理及誠信經營相關事宜，每年向董事會報告執行情形及結果。

本公司永續委員會組織圖如下：



(二) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 本集團民國 114 年度利息費用為 85,641 仟元，佔營業收入 1.83%。因此利率波動，對本公司並未造成重大之影響。
2. 本集團民國 114 年度兌換損失為 14,800 仟元，僅佔營業收入 0.32%，對本公司並未造成重大影響。
3. 最近年度通貨膨脹對本集團並未造成重大之影響。

(三) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

為審慎控管財務風險，本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資之交易。本公司操作之衍生性金融商品交易並非投機性操作，一切作業均依照「取得或處分資產處理程序」辦理，故對公司無重大風險。

本公司訂有「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」控管流程，至民國 115 年 3 月 31 日止對轉投資公司提供 61,995 仟元之背書保證，均未超過規定限額。

未來將視各子公司之營運狀況及需求，給予適當之支援。

(四) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本集團最近年度研發計畫請參閱第 72 頁，115 年將投入 128,341 仟元之研發經費，目前各項研發皆依預定之計畫進行當中。

(五) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

就目前政府公佈之重要政策及法律變動，對本集團財務業務尚無顯著之影響。且本集團之公司之經營係遵行國內外政府之法律規範，本公司及國外轉投資公司人員亦隨時收集相關政策及法律之變動資訊，提供管理階層參考。

(六)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本集團設有專職人員隨時注意相關產業之科技改變情形及產業之變化趨勢，並評估對公司未來發展及對財務業務之影響，而採取必要因應措施。惟最近年度並無因科技改變及產業變化對本公司財務業務有重大影響之情事。

(七)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司四十多年以來，秉持著「團隊、創新、責任、學習」及「以人為本」之企業精神，踏實穩健的經營，善盡企業之社會義務，建立並始終維持良好的企業形象。因此，並無因企業形象改變而對企業危機管理有重大影響之情事。

(八)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並無併購計畫。

(九)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並無擴充廠房計畫。

(十)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 本公司主要原料及外包廠商以國內企業為主，個別廠商並無不可取代性，供貨來源眾多。且本公司採分散採購原則，並與供應廠商皆維持長久穩定之合作關係，以避免因不可抗力之因素，而造成貨源不足之風險。因此，本公司尚無進貨集中之風險。
2. 本集團在 FPD 設備方面，過往主要銷售對象為國內少數面板廠商，而面板廠商之建廠資本支出時程集中且金額龐大，很容易導致設備製造商銷售集中之情形。但近年來國內大廠擴廠的腳步及規模已不若以往，加以本公司拓擴展大陸面板客戶有成，以及積極發展半導體與智能自動化設備，故 FPD 設備銷貨集中之風險已大幅降低。
3. 本集團除 FPD 領域外，正積極發展其它產業領域設備需求，包括半導體、載板及自動化設備…等產業等都是關注之重點，而發展的設備重點更涵蓋製程設備、光學檢測設備、智能自動化、及其整廠整線之整合等，故今後銷貨客戶群應可邁入合理分佈的局面。

(十一)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司內部人股權移轉情形皆按主管機關相關規定申報，以便投資人掌握相關訊息，此外，本公司隨時掌握董事及大股東股權之變動，以便降低相關風險並及時因應相關之變動，目前本公司之董事或持股超過百分之十之大股東之股權並無大量移轉或更換，對公司之營運及財務並無影響。

(十二)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司並無經營權改變之情事。

(十三)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：本公司無此情形。

(十四)他重要風險及因應措施：無。

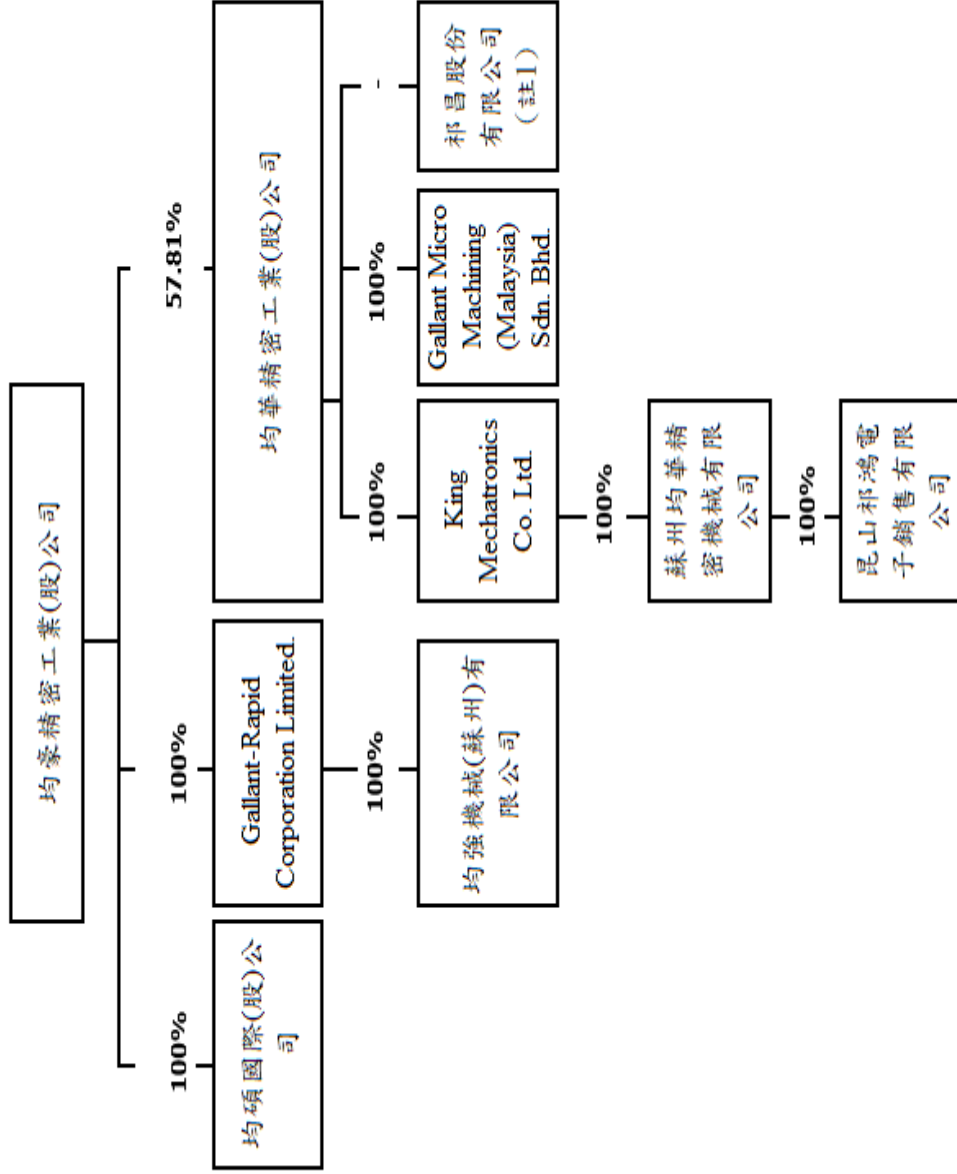
七. 其他重要事項：無。

陸. 特別記載事項

一. 關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書
關係企業組織圖

民國 114 年 12 月 31 日



註 1: 本集團之子公司祁昌股份有限公司於民國 114 年 12 月 26 日經股東會決議通過解散議案，並於同日清算人就任，本集團因而喪失對該公司之控制力。

1.各關係企業基本資料表

民國 114 年 12 月 31 日；單位：仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
均碩國際股份有限公司	2001/04/03	新竹縣竹北市台元一街八號二樓之 1	新台幣 66,000	機械設備及零件買賣
均華精密工業股份有限公司	2010/10/15	新北市土城區民生街 2 之 1 號	新台幣 282,765	精密模具及其他零件之生產及銷售
Gallant-Rapid Corporation Limited	2000/06/15	P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美金 13,560	轉投資大陸均強機械(蘇州)公司
King Mechatronics Co., Ltd.	2001/09/24	P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美金 2,781	轉投資大陸蘇州均華公司
均強機械(蘇州)有限公司	1995/04/19	中國江蘇省蘇州高新區嵩山路 56 號	美金 9,320	光電產品整機設備、機電一體化設備及其零配件生產
蘇州均華精密機械有限公司	2003/01/28	中國蘇州市吳中區木瀆鎮金橋開發區寶帶西路 5011 號	美金 4,550	精密模具及其他零件之生產與銷售
Gallant Micro Machining (Malaysia) Sdn. Bhd.	1996/10/08	B303-03-11, Krystal Point, Jalan Sultan Azlan Shah, 11900 Penang, Malaysia	馬幣 500	半導體構裝機器及相關零組件之進出口及買賣業務
昆山祁鴻電子銷售有限公司	2009/08/08	中國昆山市玉山鎮恒盛路 1369 號 5 號房	人民幣 1,000	電路板測試設備、電線電纜及半導體測試及製造

2. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

3. 整體關係企業經營業務所涵蓋行業及往來分工情形：

本公司專營設計、製造及銷售半導體封裝前段設備，及 FPD 生產製程之設備，屬半導體封裝設及 FPD 設備製造供應廠商。

整體關係企業所涵蓋之行業以半導體封裝設備、FPD 生產製程設備精密模具、智能自動化及零組件及精密構件之產銷及貿易行銷為主。

關係企業主要以產能分工、成本降低、售後服務、產品多樣化、投資控股及多角化經營等為目的，其業務互有關聯者，詳 2 關係企業基本資料表。

4. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

民國 114 年 12 月 31 日；單位：仟股；%

企業名稱	職 稱 (註 1)	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (仟股)	持股 比例%
均碩國際股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人	均豪精密工業(股)公司 法人代表：陳政興 均豪精密工業(股)公司 法人代表：黃盛宏 均豪精密工業(股)公司 法人代表：楊友財 均豪精密工業(股)公司 法人代表：陳美玲	6,600 (註 1)	100
均華精密工業股份有限公司	董事長 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 總經理	梁又文 均豪精密工業(股)公司 法人代表：陳美玲 石敦智 陳榮亮 施森豪 陳 正 陳君宇 譚至中 石敦智	283 16,343 (註 1) 221 272 0 0 0 0 221	0.99 57.81 0.77 0.95 0 0 0 0 0.77
Gallant-Rapid Corporation Limited	董事長	均豪精密工業(股)公司法人代表：陳政興	13,560 (註 1)	100
King Mechatronics Co., Ltd.	董事	均華精密工業(股)公司法人代表：陳榮亮	2,781 (註 1)	100
蘇州均華精密機械有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	陳榮亮 孫國寧 林宗諺 徐燕 孫國寧	(註 2)	100
均強機械(蘇州)有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	陳政興 鄭仁旭 曾嘉茹 陳美玲 陳政興	(註 2)	100
Gallant Micro Machining (Malaysia) Sdn. Bhd.	Director Director	均華精密工業(股)公司法人代表：鄧光榮 劉總璘	500 (註 1)	100
昆山祁鴻電子銷售有限公司	董事長 監察人	蘇州均華精密機械有限公司 法人代表：梁明凱 陳書華	(註 2)	100

註 1：為法人股東持股數。

註 2：非為股份有限公司。

5. 各關係企業營運概況

民國 114 年 12 月 31 日；新台幣仟元

企業名稱	實收資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)
Gallant-Rapid Corporation Limited	459,050	202,705	0	202,705	0	(320)	(3,028)	
均強機械(蘇州)有限公司	198,638	239,992	73,099	166,893	136,013	(3,883)	(2,658)	
均碩國際股份有限公司	66,000	79,685	452	79,233	2,669	(2,717)	(1,657)	(0.25)
均華精密工業股份有限公司	285,175	5,022,112	2,567,210	2,454,902	2,403,890	475,744	357,904	12.75
Gallant Micro Machining (Malaysia) S	3,992	3,323	28	3,295	57	(73)	79	
KING MECHATRONICS CO., LTD	93,144	1,216,658	188,991	1,027,667	105,864	(16,251)	6,685	
蘇州均華精密機械有限公司	143,007	675,491	120,393	555,098	385,632	34,917	21,242	
昆山祁鴻電子銷售有限公司	4,496	8,206	5,550	2,656	6,856	(5,950)	(3,886)	

註 1：關係企業如為外國公司，相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示【資產負債表日之兌換台幣率：美金 31.430；馬幣 7.4805；人民幣 4.4960，損益表日之兌換台幣率：美金 31.1797；馬幣 7.0131；人民幣 4.3334】

註 2：有限公司不適用每股盈餘計算。

(二)關係企業合併財務報表：請參閱第 118 頁。

(三)關係報告書：不適用。

二. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三. 其他必要補充說明事項：無。

柒.重大影響事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

均豪精密工業股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：均豪精密工業股份有限公司

負責人：陳政興



中華民國 115 年 2 月 26 日

均豪精密工業股份有限公司



董事長：

陳以錕



GPM

